

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	18
3. 자본금 변동사항.....	26
4. 주식의 총수 등	26
5. 의결권 현황.....	28
6. 배당에 관한 사항 등	28
II. 사업의 내용	30
III. 재무에 관한 사항	52
1. 요약재무정보	52
2. 연결재무제표	54
3. 연결재무제표 주식	57
4. 재무제표	112
5. 재무제표 주식	116
6. 기타 재무에 관한 사항.....	167
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	179
V. 감사인의 감사의견 등	180
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	182
1. 이사회에 관한 사항.....	182
2. 감사제도에 관한 사항.....	190
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	194
VII. 주주에 관한 사항.....	195
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	208
1. 임원 및 직원의 현황	208
2. 임원의 보수 등	218
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	221
X. 이해관계자와의 거래내용.....	241
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	242
【 전문가의 확인 】	247
1. 전문가의 확인	247
2. 전문가와의 이해관계	247

분기보고서

(제 72 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
 2019년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 희

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무/구매 담당 (성 명) 차 진 석

(전 화) 031-8093-4801~6

【 대표이사 등의 확인 】


확 인 서

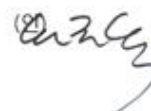
우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2019. 05. 15

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 이 석 희 

공시 책임자 차 진 석 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도 말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
에스케이하이이앤지㈜	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	건설공사 및 서비스	94,515	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
에스케이하이시스템㈜	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원 및 서비스	75,953	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
행복모아 ㈜	2016.10	충청북도 청주시 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스 일반산업단지 예프6-2	반도체 의료 제조 및 서비 스	15,428	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	2017.05	충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215(향정동)	반도체 제조 및 판매	550,323	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix America Inc.	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체 판매	3,013,637	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Deutschland GmbH	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체 판매	99,641	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Asia Pte.Ltd.	1991.09	8 Temasek Boulevard #11-03, Suntec City Tower3, Singapore 038988	반도체 판매	933,268	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	1995.04	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	반도체 판매	347,109	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix U.K. Ltd.	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK	반도체 판매	536,208	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	1996.07	Lite-On Technology Building 11F., No. 392, Ruiguang Road, NeiHu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C	반도체 판매	449,054	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Japan Inc.	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체 판매	837,362	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.	2001.08	19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan Road, Shanghai, 200051 China	반도체 판매	1,199,602	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Semiconductor India Private Limited	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체 판매	1,042	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체 판매	535,819	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	2005.04	Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)	반도체 제조	6,390,490	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원이 상, 지배회사 자산총액의 10% 이상)
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	2013.09	Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2- 4/02, Shapingba strict, Chongqing, China	반도체 제조	540,284	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Italy S.r.l.	2012.05	V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)	반도체 연구개발	4,421	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

SK hynix memory solutions America, Inc.	2012.08	3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체 연구개발	115,956	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.	2013.08	6F-1, Mo. 6, Talyuen 1st(Taiyuen Hi-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	반도체 연구개발	9,304	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	2014.06	Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073	반도체 연구개발	8,194	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK APTECH Ltd.	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외투자법인	368,505	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	2016.03	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	해외투자법인	61,181	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	2018.05	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외투자법인	13,027	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	2018.07	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외병원자산법인	3,591	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	2018.07	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외병원운영법인	142	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd	2018.08	Wuxi City New Wu District Hefeng road NO.26 Hui Rong Business square C building (Room no.302 of building no.3)	반도체 제조 및 판매	11,143	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
행복나래㈜	2000.07	89-31, Seosomun-ro, Jung-gu Seoul, 04516, Korea	산업자재 유통	185,177	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이 상)
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd	2013.01	Room 1103, 2, 88 Huachi Street, Suzhou, Industrial Park	해외 산업자재유통	9,310	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd	2015.01	Room 1301, No. 12 jinmaoshidai Blding 18 Qixia Road Qibesenter, Liangjiang New District, Chongqing, China	해외 산업자재유통	1,969	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SKhynix happy(wuxi)cleaning Ltd.	2018.09	K-7 plot, New District Free Trade Zone Wuxi, Jiangsu, China	기업 건물 관리 등	198	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SkyHigh Memory Limited	2018.12	SUITE 4401-02, 44/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS RD TAIKOO PLACE HONKONG	반도체 제조 및 판매	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

※ 주요 종속회사 판단기준 : 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

[연결대상회사의 변동현황]

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제72기 1분기	에스케이하이엔지㈜ 등 31개사	SkyHigh Memory Limited	-	-

제71기	에스케이하이엔지(주) 등 30개사	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. SK hynix system ic (wuxi) Co., Ltd HAPPYNARAE Co., Ltd. SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd SKhynix happy(wuxi)cleaning Ltd.	㈜실리콘화일 SK hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd	합병으로 인한 소멸
제70기	에스케이하이엔지(주) 등 24개사	SK hynix System ic Inc (SKHYSI)	-	-

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

-제72기 1분기 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	SkyHigh Memory Limited	신규 설립에 따른 종속기업 편입
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

[회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항]

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
상장	1996년 12월 26일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091
전화번호: 031-5185-4114

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

- (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
- (2) 기업집단에 소속된 회사 (2019. 03. 31 기준 계열사 : 107개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (18)	AJ렌터카(주)	110111-0577233
	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247

	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK(주)	110111-0769583
	SK케미칼(주)	131111-0501021
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	(주)드림어스컴퍼니	110111-1637383
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	(주)에스엠코어	110111-0128680
비상장사 (89)	11번가(주)	110111-6861490
	SK E&S(주)	110111-1632979
	SKC에코솔루션즈(주)	154311-0026200
	SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
	SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
	SK건설(주)	110111-0038805
	SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
	SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
	SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
	SK매직서비스(주)	134811-0039752
	SK매직(주)	110111-5125962
	SK모바일에너지(주)	161511-0076070
	SK바이오사이언스(주)	131111-0523736
	SK바이오텍(주)	160111-0395453
	SK바이오팜(주)	110111-4570720
	SK브로드밴드(주)	110111-1466659
	SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
	SK스토아(주)	110111-6585884
	SK신택(주)	131411-0232597
	SK실트론(주)	175311-0001348
	SK어드밴스드(주)	230111-0227982
	SK에너지(주)	110111-4505967
	SK에어가스(주)	230111-0134111
	SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
	SK와이번스(주)	120111-0217366

SK인천석유화학(주)	120111-0666464
SK인포섹(주)	110111-2007858
SK임업(주)	134811-0174045
SK종합화학(주)	110111-4505975
SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
SK텔레시스(주)	110111-1405897
SK텔링크(주)	110111-1533599
SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
SK트리캠(주)	164711-0060753
SK티엔에스(주)	110111-5833250
SK플라즈마(주)	131111-0401875
SK플래닛(주)	110111-4699794
SK핀크스(주)	224111-0003760
SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
SK하이텍(주)	134411-0037746
SK하이이엔지(주)	134411-0017540
강원도시가스(주)	140111-0002010
금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
나래에너지서비스(주)	135711-0092181
내트럭(주)	110111-3222570
네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
당진에코파워(주)	165011-0035072
디앤디인베스트먼트(주)	110111-6618263
라이프앤시큐리티홀딩스(주)	110111-5371408
목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
보령LNG터미널(주)	164511-0021527
비앤엠개발(주)	110111-5848712
서비스에이스(주)	110111-4368688
서비스탑(주)	160111-0281090
아이디퀀티크(유)	131114-0009566
에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
엔티스(주)	130111-0021658
여주에너지서비스(주)	110111-6897817
영남에너지서비스(주)	175311-0001570
울산아로마텍스(주)	110111-4499954
원스토어(주)	131111-0439131
위례에너지서비스(주)	110111-4926006

유베이스매뉴팩처링아시아주	230111-0168673
유빈스주	135111-0077367
유빈스홀딩스주	110111-5316694
이니츠주	230111-0212074
전남도시가스주	201311-0000503
전북에너지서비스주	214911-0004699
제주유나이티드FC주	224111-0015012
주대한송유관공사	110111-0671522
주DDISS280위탁관리부동산투자회사	110111-6896835
주ADT시큐리티	110111-2385585
주ADT캡스	110111-0072639
주에이앤티에스	110111-3066861
주제이에스아이	124611-0261880
주캡스텍	110111-3141663
충청에너지서비스주	150111-0006200
코원에너지서비스주	110111-0235617
파주에너지서비스주	110111-4629501
피아이유엔주	134111-0383195
피에스앤마케팅주	110111-4072338
한국백슬렌(유)	230114-0003328
행복나래주	110111-2016940
행복디딤주	110111-6984325
행복모아주	150111-0226204
행복키움주	110111-6984672
홈앤서비스주	110111-6420460

주1) '19.4.1일자로 디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사, 디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사 계열 편입

주2) 넷웍오앤에스주는 '19.4.19일자로 SK오앤에스(주)로 사명 변경

(*) 사명 변경 : SK주 (舊 SK C&C주), 엔티스주 (舊 SK사이텍주), SK인포섹주 (舊 인포섹주), 나래에너지서비스주 (舊 하남에너지서비스주), 비엔엠개발주 (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼엔드에스케이씨폴리우레탄주 (舊 에스엠피씨주), SK에어가스주 (舊 SKC에어가스주), SK바이오랜드주 (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스주 (舊 피엠피주), SK엠앤서비스주 (舊 엠앤서비스주), SK매직서비스주 (舊 매직서비스주), SK디스커버리주 (舊 SK케미칼주), SKC하이테크앤마케팅주 (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스주 (舊 카라이프서비스주), 라이프앤시큐리티홀딩스주 (舊 사이렌홀딩스코리아주), SKC에코솔루션즈주 (舊 SK더블유), (주)드림어스컴퍼니 (舊 (주)아이리버)

※ 해외계열사 현황

[2019년 3월 31일 기준]

No.	해외계열사명
1	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

2	SK USA, Inc.
3	SK E&P Company (구.SK Innovation Americas Inc.)
4	SK E&P America, Inc.
5	SK Plymouth, LLC
6	SK Permian, LLC
7	SK Battery Hungary Kft.
8	Blue Dragon Energy Co., Limited
9	SK E&P Operations America, LLC
10	SK Nemaha, LLC
11	SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD.
12	SK BATTERY AMERICA
13	SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O.
14	SK BATTERY MANUFACTURING KFT
15	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
16	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
17	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
18	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
19	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
20	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
21	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
22	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
23	Netruck Franz Co., Ltd.
24	Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
25	TAN CANG – SK ENERGY COMPANY Ltd.
26	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
27	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
28	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
29	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
30	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
31	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
32	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
33	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
34	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
35	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
36	SK Primacor Europe, S.L.U
37	SK Primacor Americas LLC
38	SK Saran Americas LLC
39	SK Global Chemical China Ltd.
40	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

41	SK GC Americas, Inc.
42	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
43	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
44	SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.
45	SK China Company, Ltd.
46	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
47	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
48	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
49	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
50	SK C&C Beijing Co., Ltd.
51	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
52	SKY Property Mgmt. Ltd.
53	SK C&C India Pvt., Ltd.
54	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
55	SK China Real Estate Co., Limited
56	SK Industrial Development China Co., Ltd.
57	SK GI Management
58	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
59	Gemini Partners Pte. Ltd
60	SKY Investment Co., Ltd
61	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
62	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
63	Sky Yunjian Investment Management Limited
64	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
65	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
66	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
67	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
68	SK C&C Chengdu Co., Ltd.
69	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
70	Solaris GEIF Investment
71	Prostar Capital Ltd.
72	Prostar Capital Management Ltd.
73	S&G Technology
74	Dogus SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.
75	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
76	CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.
77	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
78	SK Property Investment Management Company Limited
79	ESSENCORE Limited

80	SK China Investment Management Company Limited
81	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
82	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
83	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
84	Hermed Capital
85	Hermed Capital Health Care GP Ltd
86	SK BeiJing Investment Management Limited
87	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
88	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
89	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
90	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
91	Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
92	CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P.
93	Prostar APEIF GP Ltd.
94	CFC-SK Covipaci Colombia SAS
95	CFC-SK Malta Covipacifico Ltd.
96	CFC-SK Spain Covipacifico S.L.
97	Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd
98	CFC-SK Capital S.A.S.
99	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
100	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
101	SK Financial Leasing Co, Ltd.
102	SK Investment Management Co., Limited.
103	Prostar APEIF Management Ltd.
104	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
105	SK computer and communication L.L.C.
106	Hermeda Industrial Co. Ltd
107	Plutus Capital NY, Inc.
108	Hudson Energy NY, LLC
109	EM Holdings (Cayman) L.P.
110	EM Holdings (US) LLC
111	Plutus Fashion NY, Inc
112	Wonderland NY, LLC
113	SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
114	Hudson Energy NY II, LLC
115	Alchemy Acquisition Corp.
116	Abrasax Investment Inc.
117	Fine Chemicals Holdings Corp.
118	AMPAC Fine Chemicals, LLC

119	AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
120	AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
121	Solaris Partners Pte. Ltd
122	Atlas NY, LLC
123	SK Semiconductor Investments Co., Ltd
124	SL Capital Partners Limited
125	SLSF I GP Limited
126	SL Capital Management Limited
127	SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
128	SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
129	SK Siltron America, Inc.
130	SK Siltron Japan, Inc.
131	SK Materials Japan Co., Ltd.
132	SK Materials Taiwan Co., Ltd
133	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd
134	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
135	SK Biotek Ireland Limited
136	SK Biotek USA, Inc.
137	SK Life Science, Inc.
138	SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. (SK 생물의약품(상해) 유한공사)
139	SMC US, INC
140	PHILKO UBINS LTD. CORP.
141	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
142	PT. Patra SK
143	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
144	SK Lubricants Europe B.V.
145	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd
146	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
147	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
148	SK Lubricants Americas, Inc.
149	SK Energy International Pte, Ltd.
150	SK Energy Europe, Ltd.
151	SK Energy Americas Inc.
152	SK Terminal B.V.
153	Atlas Investment Ltd.
154	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
155	SK Healthcare Co.,Ltd.
156	SK Healthcare China Holding Co.
157	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited

158	SK telecom Japan Inc.
159	AI ALLIANCE, LLC
160	ID Quantique S.A.
161	Axess II Holdings
162	CYWORLD China Holdings
163	Global Opportunities Breakaway Fund
164	Global opportunities Fund, L.P
165	Immersive Capital, L.P.
166	Magic Tech Network Co., Ltd.
167	SK Latin America Investment S.A.
168	SK MENA Investment B.V.
169	SK Technology Innovation Company
170	SK Telecom Americas, Inc.
171	SK Telecom China Fund 1 L.P.
172	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
173	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
174	SK Telecom Venture Capital, LLC
175	SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
176	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
177	SKTA Innopartners, LLC
178	ULand Company Limited
179	Westly Capital Partners Fund II
180	YTK Investment Ltd.
181	SK Planet Inc.
182	SKP America LLC
183	SK Planet Japan K.K.
184	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
185	shopkick GmbH
186	shopkick management co.
187	shopkick Inc.
188	Celcom Planet Sdn Bhd
189	Dogus Planet Inc.
190	SK Telink Vietnam Co., Ltd.
191	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
192	CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
193	Iriver Enterprise Ltd.
194	Iriver Inc.
195	Groovers Japan Co.,Ltd
196	Iriver China Co., Ltd.

197	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd
198	LIFE DESIGN COMPANY Inc.
199	NanoenTek America Inc.
200	NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
201	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
202	SK Telecom TMT Investment Corp.
203	ID Quantique Ltd
204	SK BRASIL LTDA
205	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
206	SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
207	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
208	Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
209	SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
210	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
211	SK NETWORKS AMERICA, Inc.
212	SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
213	Networks Tejarat Pars
214	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
215	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
216	P.T. SK Networks Indonesia
217	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
218	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
219	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
220	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
221	SK Networks Deutschland GmbH
222	SK Networks HongKong Ltd.
223	SK Networks Japan Co., Ltd.
224	SK Networks Middle East FZE
225	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
226	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
227	SK Networks Resources Pty Ltd.
228	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
229	SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
230	Springvale SK Kores Pty Ltd.
231	SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD
232	SK Magic Vietnam company limited
233	SK hynix America Inc. (SKHYA)
234	SK hynix Deutschland GmbH (SKHYD)
235	SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS)

236	SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. (SKHYH)
237	SK hynix Japan Inc. (SKHYJ)
238	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT)
239	SK hynix Semiconductor(China) Ltd. (SKHYCL)
240	SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. (SKHYCS)
241	SK hynix Semiconductor India Private Ltd. (SKHYIS)
242	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
243	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. (SKHYCW)
244	SK hynix Italy S.r.l (SKHYIT)
245	SK hynix memory solutions America Inc. (SKHMS America)
246	SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. (SKHMS Taiwan)
247	SK APTECH Ltd. (SKAPTECH)
248	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL)
249	SK hynix U.K. Ltd. (SKHYU)
250	SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. (SKHMS Eastern Europe)
251	SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures)
252	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
253	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
254	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd
255	SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
256	SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd.
257	SK INVESTMENT VINA I Pte., Ltd.
258	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
259	SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd
260	SKYHIGH MEMORY LIMITED
261	SKC Europe GmbH
262	SKC, Inc.
263	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
264	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
265	SKC PU Specialty Co., Ltd.
266	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
267	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
268	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
269	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
270	SKC PVB Film Co., Limited
271	ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.
272	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co
273	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co
274	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.

275	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
276	MCNS Polyurethanes USA Inc.
277	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
278	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
279	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
280	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
281	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
282	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
283	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
284	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
285	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
286	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O
287	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
288	SK Telesys Corp.
289	TechDream Co. Limited
290	BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
291	SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD
292	SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
293	SOLMICS TAIWAN CO.,LTD.
294	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
295	Prism Energy International Pte., Ltd.
296	SK E&S Australia Pty Ltd.
297	SK E&S Americas, Inc.
298	SK E&S LNG, LLC
299	PT SK E&S Nusantara
300	DewBlaine Energy, LLC
301	CAILIP Gas Marketing, LLC
302	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
303	Fajar Energy International Pte., Ltd
304	SK E&S Dominicana S.R.L.
305	Prism Energy International Hong Kong Limited
306	SKEC(Thai) Limited
307	SK E&C BETEK Corp.
308	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
309	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
310	SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
311	SK E&C India Private Ltd.
312	BT RE Investments, LLC
313	Mesa Verde RE Ventures, LLC

314	SK E&C Saudi Company Limited
315	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
316	SKEC Anadolu LLC
317	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
318	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
319	Hi Vico Construction Company Limited
320	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
321	Sunlake Co., Ltd.
322	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
323	SK Holdco Pte. Ltd
324	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
325	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. (SK화공(청도))
326	SK Chemicals America
327	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd (SK화공(소주))
328	SK Chemicals GmbH
329	ST Green Energy Pte,Ltd
330	PT Sinar Timuran Green Energi
331	SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. (SK화공(상해))
332	SK Gas International Pte. Ltd.
333	SK Gas USA Inc.
334	SK Gas Trading LLC

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	한국기업평가	AA	2019.04.23
	한국신용평가	AA	2019.04.23
	NICE신용평가	AA	2019.04.24
해 외	Moody's	Baa2	2018.10.23
	S&P	BBB-	2018.11.15

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

1949. 10 국도건설 주식회사 설립

1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
1996. 12	기업공개 및 상장
1997. 03	대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임 이사 5인, 감사 1인 변경 선임
1999. 05	LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
1999. 07	LG반도체 대주주 지분 인수
1999. 10	현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2000. 03	박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
2000. 05	전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
2000. 08	모니터사업부문 "현대이미지케스트(주)"로 분사
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경 박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2001. 05	통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사 통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
2001. 07	통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
2001. 08	현대그룹으로부터 계열분리
2001. 10	채권금융기관 공동관리 시작
2001. 12	현대큐리텔, '팬택 컨소시엄'에 지분 매각
2002. 01	현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
2002. 05	시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결 박종섭 대표이사 사임
2002. 06	최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
2002. 07	우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2002. 12	현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
2003. 02	박상호 대표이사 사임
2003. 04	STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
2003. 06	환경/안전/보건 기술연구소 설립
2004. 06	매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
2004. 08	중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
2004. 10	비메모리 사업부문 영업양도
2004. 11	STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
2005. 03	황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임 박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
2005. 07	채권금융기관 공동관리 조기종료 현대이미지케스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
2005. 10	(주)현대오토넷 지분매각 완료 출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
2006. 03	권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임

2006. 04	중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 06	출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
2006. 09	300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
2007. 03	김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임 -. 이사 선임: 김종갑, 최진석 -. 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호 우의제 대표이사 임기만료 퇴임 이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
2007. 04	청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
2007. 07	공정거래 자율준수프로그램 도입
2007. 10	환경운동연합과 '환경경영인증위원회' 협약 체결
2007. 11	'일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
2008. 02	김경한 사외이사 중도 퇴임
2008. 03	사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈 사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
2008. 06	정홍원 사외이사 중도 퇴임
2009. 03	권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 권오철, 박성욱 -. 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
2009. 11	중국 후공정 합작사 HITECH 설립
2010. 03	최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사) 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주)) 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철 -. 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호
2010. 06	중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2010. 08	최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
2010. 10	최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
2011. 03	사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명
2011. 09	정상환 사외이사 중도 퇴임

2012. 02	최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주)) 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱 -. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
2012. 06	미 컨트롤러 업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수 본계약 체결
2012. 09	플래시 솔루션 디자인 센터 설립
2013. 03	김준호 사내이사 1인 신규 선임
2014. 03	이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임 -. 이사 선임: 임형규 -. 사외이사 선임: 최종원 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원
2014. 09	중국 충칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공 이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 박성욱 -. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
2015. 03	이사 2인(사내이사) 선임 -. 이사 선임: 김준호, 박정호
2016.03	이사 4인(감사위원회 위원 2인 포함) 선임 -. 이사 선임: 이석희 -. 기타비상무이사 선임: 박정호 -. 사외이사 선임: 최종원, 신창환 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원, 신창환
2017.03	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 공식 출범 이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임 -. 이사 선임: 박성욱 -. 사외이사 선임: 송호근, 조현재, 윤태화 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 윤태화
2017.07	이사 2인 선임 -. 이사 선임: 오종훈 -. 사외이사 선임: 하영구
2018.03	
2019.03	

(2) 종속회사의 주된 변동내용

1983. 03	미국 현지법인(HSA) 설립
1989. 03	독일 현지법인(HSD) 설립
1991. 08	싱가폴 현지법인(HSS) 설립
1995. 04	홍콩 현지법인(HSH) 설립
1995. 07	영국 현지법인(HSE) 설립 영국 현지판매법인(HSU) 설립
1995. 08	미국 생산법인(HSMA) 설립

1996. 07	대만 현지법인(HST) 설립
1996. 09	일본 현지법인(HSJ) 설립
2001. 05	사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
2001. 07	LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
2001. 08	중국 현지판매법인(HSCS) 설립
2001. 12	"에스알씨(주)" 분사
2002. 11	"(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
2005. 04	중국 합작법인(HSSL) 설립
	에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경
	(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
2006. 04	중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 10	중국 현지생산법인(HSMC) 준공
2007. 01	인도 현지법인(HSIS) 설립
2008. 03	(주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할
	(주)아스텍에서 (주)하이스텍으로 분할
	(주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할
	(주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
2010. 01	(주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
2010. 08	중국 현지판매법인(HSCW) 설립
2011. 09	"(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외
	"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외
2012. 06	낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideaflash S.r.l.) 인수,
	이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병
	(주)하이스텍, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경
	(주)하이스텍→에스케이하이스텍(주) 사명 변경
2013. 09	아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외
	중국 충칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 설립
2014. 04	에스케이하이이엔지(주) 에서 큐알티(주) 분할 설립
	주식교환으로 실리콘화일(주) 인수
2014. 06	벨라루스 소재 연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수
2014. 07	SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업 제외
2014. 09	큐알티(주) 지분 전량 매각
2016. 03	SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립
	Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업 제외
2016. 10	행복모아(주) 설립
2017. 05	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 설립
2018. 03	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

2018. 05	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 흡수합병
2018. 05	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립
2018. 07	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 중국 합작법인 설립
2018. 07	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 설립
2018. 07	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 설립
2018. 08	SK hynix system ic (wuxi) 설립
2018. 09	SKhynix happy(wuxi)cleaning.Ltd 설립
2018. 12	행복나래(주) 지분 100%를 에스케이텔레콤(주) 등으로부터 취득
2018. 12	SkyHigh Memory Limited 설립

나. 상호의 변경

1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
2012. 03	에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

1999. 10	현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2004. 10	비메모리 사업부문 영업양도
2011. 11	에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
2014. 01	(주)실리콘화일과 포괄적 주식교환계약
2016. 10	(주)실리콘화일과 CIS영업부문에 대한 영업양수
2017. 07	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

라. 생산설비의 변동

2006. 10	중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
2008. 07	미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
2008. 08	청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
2008. 09	이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
2008. 12	중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
2010. 06	중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2012. 06	청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공
2014. 09	중국 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공
2015. 08	이천 M14(300mm) 준공

2018. 10 청주 M15(300mm) 준공
 2019. 04 중국 우시 확장팩(C2F) 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
 2005. 01 대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔社 인증 획득
 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
 60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
 2007. 04 퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔社 인증 획득
 초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발
 이노베이티브 실리콘社와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
 2007. 09 초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
 2007. 10 오보닉스社와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
 2007. 11 1Gb GDDR5 개발
 50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
 실리콘화일社와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔社 인증 획득
 2008. 03 피델릭스社와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
 2008. 04 그란디스社와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
 2008. 05 프로모스社와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
 2008. 06 파이슨社와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
 실리콘화일社 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
 3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
 2008. 07 씨엔에스테크놀로지社와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
 2008. 08 뉴모닉스社와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
 16GB 서버용 모듈 개발
 2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발
 50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
 2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔社 인증 획득

2009. 02	40나노급 DDR3 DRAM 개발
2009. 05	뉴모닉스社 및 파이슨社와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
2009. 06	4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔社 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
2009. 07	대만 프로모스社와 전략적 제휴 협력계약 종결
2009. 08	50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社 인증 획득
2009. 10	2세대 1Gb DDR3 개발
2009. 12	40나노급 2Gb GDDR5 개발
2010. 01	40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
2010. 02	20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
2010. 09	휴렛팩커드(HP)社와 Re램 공동개발 계약 체결
2010. 12	30나노급 4Gb DDR3 개발
2011. 03	30나노급 2Gb DDR4 개발
2011. 07	도시바社와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
2012. 03	30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
2012. 04	스팬션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
2012. 06	IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
2012. 08	20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
2012. 09	20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
2013. 06	20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
2013. 07	삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
2013. 10	20나노급 6Gb LPDDR3 개발
2013. 12	20나노급 8Gb LPDDR4 개발
2014. 04	20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발
2014. 05	20나노급 모바일 DRAM 저탄소 제품 인증 획득
2014. 09	차세대 와이드 IO2 모바일 DRAM 개발
2014. 10	최대용량 비휘발성 하이브리드 DRAM 모듈 개발
2015. 02	도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결
2015. 02	사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득
2015. 08	샌디스크와 특허 라이선스 연장 및 공급 계약 체결
2017. 01	16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시
2017. 04	72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시 개발
2017. 04	20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발
2017. 07	20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발
2017. 09	도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 타법인 지분 출자 결의
2018. 01	20나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발
2018. 02	72단 3D 낸드 기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발

2018. 04 10나노급 16Gb DDR4 개발
 2018. 11 96단 512Gb TLC 4D 낸드플래시 개발
 2018. 11 2세대 10나노급 8Gb DDR4 개발
 2019. 05 96단 4D 낸드 기반 고성능 1Tb QLC 샘플 출하

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05
2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환
2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26
2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29
2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2019년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 684,001,795주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,721,980,209	-	5,721,980,209	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
	1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
	2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		728,002,365	-	728,002,365	-
Ⅴ. 자기주식수		44,000,570	-	44,000,570	2014.04.22 주식교환 및 2015.07.23~10.01 장내취득 2018.07.30~09.28 장내취득
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		684,001,795	-	684,001,795	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내	보통주	44,000,000	-	-	-	44,000,000	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외	보통주	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	소계(a)	보통주	44,000,000	-	-	-	44,000,000	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	570	-	-	-	570	주식교환
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	44,000,570	-	-	-	44,000,570	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	44,000,570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	684,001,795	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제72기 1분기	제71기	제70기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		1,102,753	15,540,111	10,641,512
(별도)당기순이익(백만원)		944,276	15,407,086	10,110,797
(연결)주당순이익(원)		1,612	22,255	15,073
현금배당금총액(백만원)		-	1,026,003	706,002
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	6.6	6.6
현금배당수익률(%)	-	-	2.5	1.3
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	1,500	1,000
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT 제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2019년 4월, 금액기준)에 따르면, 지난 2018년도 세계 반도체 시장규모는 US\$4,746억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US\$1,628억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 34% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 61%를 차지하는 US\$999억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$580억으로 36%, 기타 메모리가 US\$50억으로 3%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 20.9%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2018년 반도체 수출은 DRAM 시장 가격 상승 등으로 인해 전년 대비 29.4% 성장하였습니다.

[전체 수출 중 반도체 비중]

(단위: 백만USD,%)

구분	2018	2017	2016	2015	2014	2013
총수출	604,860	573,694	495,426	526,757	572,665	559,632
반도체	126,706	97,937	62,228	62,917	62,647	57,144
전년비 증감률	29.4%	57.4%	-1.1%	0.4%	9.6%	13.3%
비중	20.9%	17.1%	12.6%	11.9%	10.9%	10.2%

※ 출처: 한국무역협회, 2019년 4월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

(가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory), 휴대용 기기 구동을 위한 모바일 메모리 등으로 사용되고 있습니다. 한편, 2018년에는 클라우드 컴퓨팅을 중심으로한 CSP(Cloud Service Provider)의 성장에 따라 서버용 DRAM의 채용이 급증하였으며, IoT 및 자율주행차 등 차세대 기술에의 적용 또한 확대되고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근들어 범용 메모리 보다는 고객지향적인 플래시 메모리 수요가 늘고 있어, 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

(나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 됩니다. 자사는 현재 이미지 센서(CIS)를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)의 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 확대되고 있으며, 특히, CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿 PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

각종 디바이스의 모바일화, 스마트화로 우호적 반도체 업황이 지속되었으며, 최근에는 Big Data, AI, 5G 등 신기술 확대가 산업의 성장성에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 2017년 전체 반도체 시장은 21.6%, 메모리 반도체 시장은 61.8%의 높은 성장을 달성하였고, 2018년에도 전체 반도체 시장은 12.5%, 메모리 반도체 시장은 24.9%의 고성장을 이어갔습니다.

(Gartner, 2019년 4월, 금액기준)

메모리 반도체 시장의 생산(공급) 측면은 점진적 둔화가 예상됩니다. 공정 미세화 기술 난이도 및 생산/연구개발을 위한 투자 비용은 급증하는 반면, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 다양화, 고도화되고 있습니다. 이에, 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 무리한 공급 확대는 제한적일 전망이고 메모리 반도체 산업의 성장성은 안정적 수요와 제한적 공급으로 인해 확대될 것으로 예상됩니다.

[DRAM]

DRAM 시장은 공급업체의 축소 및 모바일 시장의 확대에 힘입어 지속적인 성장을 이어가

2017년 \$721억(+ 74.1%), 2018년 \$999억(+ 38.6%)을 기록하였습니다. 분야별로 살펴보면 PC 시장은 성숙기 도달로 저성장 기조가 유지되어 강한 수요 성장을 보이고 있지는 않으나, Gaming PC의 확산과 스펙 상향으로 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 제품의 고사양화로 DRAM 평균 탑재량이 2018년 3.0GB에서 2022년에는 5.3GB로 증가하며, 탑재량 중심의 성장을 지속할 것으로 기대됩니다. 또한, 고화질 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 이와 더불어 AI, 5G, Big Data 등 대량의 데이터 처리를 요구하는 기술의 고도화로 고용량 Server 메모리 수요가 확대되고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 기타 멀티미디어 가전 등에 사용되는 플래시카드, USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2019년 4월 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야에의 적용 확대로 2015년 3.5%(\$308억), 2016년 14.9%(\$354억)의 성장을 기록했고, 2017년, 2018년에는 평균 가격 상승에 힘입어 각각 51.9%(\$537억), 7.8%(\$580억)의 고성장을 기록했습니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 90년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 감시카메라, 블랙박스, 스마트폰, 태블릿 PC 등에 탑재되며 지속 성장하고 있습니다. 향후에는 스마트TV, AR/VR, 자율주행자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로도 활용되어 시장 규모가 확대될 것으로 보입니다.

가트너(Gartner, 2019년 4월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2019년 US\$131억에서 2023년 US\$167억 규모로 연평균 6.2%의 성장이 예상됩니다. 특히 당사가 생산 중인 CMOS이미지센서는 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지센서 시장에서 차지하는 비중이 2019년 97%에서 2023년 99%까지 확대될(연평균 6.9%의 성장) 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 과 인도 등 신흥시장 비중의 확대, 제품 수요처의 다변화, 경쟁력이 부족한 업체들의 일부 구조조정 등으로 경기 변동 폭이 이전 대비 축소되었습니다.

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔으나, 현재는 모바일기기, Cloud Computing 등 성장으로 주요 수요처가 PC에서 서버와 모바일로 분산되면서 경기 변동성이 과거 대비하여 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산 및 데이터센터의

확산 등 판매 시장과 응용처의 다변화로 전통적인 수요 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 최근에는 IT 기기의 스마트화, 고성능화로 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌면서 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다.

아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 스마트 TV, AR, VR, 자율주행자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오) 3. 설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였으나, 최근들어 공정 미세화 난이도 및 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증가하면서 이 같은 사업환경이 일부 변화하였습니다. 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감, 제품의 부가가치 증대를 위한 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 이러한 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기 시장진입과 eMMC, SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업이 필요합니다.

또한, 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년도 1분기는 메모리 수요 둔화가 지속되면서 출하량 감소와 가격 하락으로 연결기준 매출은 전년 동기 대비 22% 감소한 6,772,655백만원, 영업이익은 전년 동기 대비 69% 감소한 1,366,490백만원, 당기순이익은 전년 동기 대비 65% 감소한 1,102,130 백만원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제72기 1분기	제71기 4분기	전분기 대비 증감	제71기 1분기	전년 동기 대비 증감
매출액	6,772,655	9,938,081	-32%	8,719,691	-22%
누계실적	6,772,655	40,445,066	-	8,719,691	-
영업이익	1,366,490	4,430,075	-69%	4,367,338	-69%
누계실적	1,366,490	20,843,750	-	4,367,338	-
당기순이익	1,102,130	3,397,919	-68%	3,121,329	-65%
누계실적	1,102,130	15,539,984	-	3,121,329	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적임.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제72기 1분기 누계]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	6,772,655	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	6,772,655	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	'18년	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년
DRAM	28.3%	27.8%	26.0%	27.3%	27.1%	26.6%	24.7%
NAND Flash	12.2%	12.2%	11.8%	12.6%	10.8%	10.7%	9.9%

※ 출처: IDC 2019년 3월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[디램(DRAM)]

피씨 메모리(PC Memory)는 다양한 요소로 인해 꾸준한 수요 증가가 지속되고 있습니다. 피씨 고객군별로는, 2020년 1분기 윈도우7 지원 종료로 인해 기업용 윈도우10 피씨 수요 증가가 지속되고 있으며 교육용으로는 저렴한 가격 및 다양한 교육용 프로그램을 제공하는 크롬북(Chromebook)의 판매 지속이 전망됩니다. 제품군별로는, 고사양 게임을 즐기기 위한 사

용자 증가로 게이밍 피씨(Gaming PC)가 작지만 확고한 위치를 자리잡아 가고 있습니다. 또한 더욱 가볍고, 오래가며, 사용자 편의를 위해 다양한 기능을 탑재한 울트라북(Ultrabook)의 수요가 높아지고 있으며 이는 일반 소비자뿐만 아니라 기업에서도 많은 수요를 보이고 있습니다. 이에 피씨향 수요는 유지되고 있으며, 게이밍 피씨와 울트라북의 평균 메모리 탑재량이 점차 높아지고 있어 지속적인 피씨 메모리 수요 증대를 이끌고 있습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 분야의 성장세 유지로 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히, Enterprise향 Workload 중 Public Cloud로의 전환 가속화 및 Cloud Native Workload 증가에 따라 대형 클라우드 서비스 업체들은 Data Center 확장을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 이러한 흐름은 안정적인 서버 수요를 견인하는 동시에 단일 서버의 가상화 집적도 증가로 인한 서버 DRAM 용량(Content per Box) 상승세 유지에 일조하고 있습니다. 또한 5G 본격화와 함께 급격한 Edge Infra 확충이 이루어질 전망임에 따라 Edge Computing향 수요가 추가 성장 모멘텀이 될 수 있습니다. 더불어 AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 Analytics Application의 성장이 본격화되면서 High Bandwidth 및 High Density 메모리 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 이에 자사는 해당 수요에 대응할 수 있는 고속, 고용량 서버 모듈(Module) 제품을 공급하며 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 콘텐츠 구현, 동영상 제작 및 3D 그래픽 기술의 정교화와 함께 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다. 특히 GDDR6, HBM2 제품이 탑재된 고사양 그래픽 카드를 이용한 Deep learning, AI accelerator 분야가 주목 받고 있으며, 증가되는 Data를 병렬 처리하는데 용이한 그래픽카드 수요와 더불어 그래픽 메모리 수요 역시 증가할 것으로 전망됩니다. 주요 GPU/PC 업체 및 Game Console 업체들과의 전략적 관계 강화를 통하여 PC 그래픽 분야와 Game Console 분야에서도 고객의 요청사항에 적극적으로 대응하고 있습니다.

컨수머 메모리(Consumer Memory)는 기존 시장의 고용량화, 신규 시장의 Set 수요 증가에 따라 지속적이고 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 주요 응용분야인 Digital TV, Set-Top-Box 시장의 고사양/고화질(4K~8K) 지원 및 5G 네트워크 시대의 개막은 메모리 탑재 용량을 지속 증가 시킬 것이며, Smart Speaker를 위시한 IoT 시장의 성숙과 자율주행 시대를 준비하는 오토모티브 시장의 고성장은 향후 컨수머 메모리 수요를 견인하는 신규 모멘텀이 될 것입니다.

이에 당사는, 저용량에서부터 고용량 (2G~32Gb), 범용제품(DDR3/DDR4)부터 저전압/고속 제품(LPDDR4/LPDDR4X), Specialty (IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature)) 제품까지 Full line-up 제품 운영을 통해, 다양한 응용분야 및 고객의 니즈에 적극 대응함으로써 시장에서의 당사 입지를 견고히 하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 Low-power 및 High bandwidth를 필요로 하는 Mobile device(Smartphone/Tablet)를 중심으로 채용되고 있으며, 그 외 Low-power 특성이 중요한 IoT 및 Automotive, Consumer application으로 채용이 확대되고 있습니다. Mobile application의 대표기기인 Smartphone은 '15년부터 시장 성숙기에 진입하여 2018년부터는 연간 Set 성장률의 감소 추세가 진행되고 있습니다. 하지만 기기당 DRAM 채용량은 연간 두 자리 수 이상의 높은 성장률이 유지될 것으로 전망되며, 인도 등 신흥시장 내 지속적인 수요 확대로 서버 메모리와 함께 전체 DRAM 시장의 수요 성장을 견인하고 있습니다. 금년 출시되는 신규 Flagship 주요 모델들은 6GB/8GB 위주로 채용될 계획이며, Ultra-premium 제품에는 최대 12GB의 Mobile DRAM이 채용될 예정입니다. 당사는 전체 Smartphone의

DRAM 평균 채용량이 2018년 3.3GB에서 2019년 4.0GB까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 특히, Smartphone의 AI on Device, AR 기능, Multiple camera 탑재와 같은 신규기술 채용과 5G 도입에 따른 Contents 확대 및 하드웨어 스펙 경쟁 심화에 따라 고용량 DRAM 채용 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 최신 Tech의 LPDDR4X와 Legacy LPDDR3에 기반한 다양한 PoP/ MCP 제품으로 Line up을 구축하여 고객 대응 중에 있으며, 고용량/고성능 구현을 위한 미래 제품 개발을 추진 중에 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률 및 채용 용량이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 TV, 스마트 카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저 용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그리고, 낸드플래시를 기반으로 한 SSD(Solid State Drive)와 같은 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저 용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 3D NAND를 개발, 빠른 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2017년부터 2022년까지 연평균 약 10.4%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 2H. 2018, 출하량 기준)

또한 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차 등으로 응용 범위가 점차 확대되고 있으며, 전체 Application 중 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 화상 통신 및 사진촬영을 위한 전면과 후면 카메라용으로 두 개의 이미지 센서가 장착되었으나, 2016년부터는 후면 카메라에 광학줌 및 사진 배경을 뿌옇게 보이게 하는 보케(Bokeh) 기능을 지원하는 듀얼 카메라가 채용되기 시작하였고, 2018년에는 카메라 기능을 다양화한 Triple, Quadruple Camera가 채용되면서 기기당 이미지 센서 탑재 비율이 더욱 증가하고 있는 추세입니다.

최근 스마트폰 카메라 시장은 Multi Camera 및 40M pixel 이상 고화소 채용 증가로 카메라 성능이 어느때보다도 중요한 마케팅 요소가 되고 있습니다. 한편, 노트북용 이미지센서 시장은 HD 제품이 주류를 이루고 있으며, 태블릿 역시 5M~13M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라에 채용되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 모바일 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북 시장에 집중하고 있으며, 2012년 BSI(Back-Side Illumination) 기술 개발 완료, 2016년 advanced BSI 기술을 적용한 13M 제품 개발을 완료하여 시장에 성공적으로 진입함으로써 제품 라인업을 13M까지 확대하였습니다. 2017년부터는 고화소 시장

으로의 진입을 위해 300mm 공정을 Set-up하고, 16M 이상 제품 라인업 구축을 위한 1.0um Pixel의 성능을 선두 업체인 소니와 동등 수준으로 개발 완료하였습니다. 2018년 하반기 300mm 13M 제품 출시와 더불어 1.0um 16M 제품 샘플 출시를 통해 고화소 시장 확대를 위한 발판을 마련하였고, 경쟁사와의 기술 격차를 줄이기 위하여 1.0um에서 0.8um pixel 제품으로 개발력을 집중함으로써, 경쟁사 Catch-up 및 제품 Line-up 준비에 박차를 가하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 자동차 및 보안 카메라등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체 제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	6,772,655 (100%)
합계					6,772,655 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2019년 1분기에는 계절적 비수기 및 서버/모바일의 수요 감소로 메모리 가격 하락이 지속되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	WAFER	fab 생산	290,791	17%	
		Lead Frame & Substrate	package	41,077	2%	
		PCB	module	58,666	3%	
		기타	-	658,564	39%	
		소계		1,049,098	62%	
	저장품	S/P, 부재료	-	640,109	38%	
	합 계			1,689,207	100%	

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입하고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.

과거 몇년간 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등의 시장 확대에 따른 반도체 산업의 호황으로 웨이퍼 수요 및 가격은 지속적으로 증가하는 추세였으나, 최근에는 웨이퍼의 공급량이 개선됨에 따라 가격이 안정화되었습니다.

향후 시장은 중장기 반도체 시장 상황에 연동한 수요자(Chipmakers) / 공급자(Wafer제조사) 투자 규모 결정에 따라 가격 유지/하락 추세가 결정될 것으로 보입니다.

당사는 웨이퍼 시장 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 주요 매입처와 협력 관계를 통해 안정적 생산 지원 및 원가경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2019년 1분기 총 가동일은 90일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균 가동시간은 월 15,793,200시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2019년 1분기 생산능력은 5,104,813백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제 72기 1분기	제 71기	제 70기
반도체 부문	5,104,813	18,130,264	14,063,811

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2019년 1분기 생산실적은 5,104,813 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제72기 1분기	제71기	제70기
반도체 부문	5,104,813	18,130,264	14,063,811

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	47,379,600	47,379,600	100%

※가동률은 각 지역별 제조 인원을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 36,385,101백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단

위:백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2019.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,020,229	5,561,515	1,760,456	57,321,212	14,344	1,572,748	4,843,501	72,094,005
감가상각누계액	-	(992,088)	(459,536)	(34,510,486)	(3,008)	(949,409)	-	(36,914,527)
손상차손누계액	-	(23,699)	(19,104)	(164,497)	-	(28)	-	(207,327)
정보보조금	-	(15,782)	-	(3,731)	(21)	-	-	(19,534)
기초순장부금액	1,020,229	4,529,947	1,281,816	22,642,498	11,315	623,311	4,843,501	34,952,617
기중변동액	-	-	-	-	-	-	-	-

취득	2,256	7,857	53,386	1,198,858	30	44,403	1,752,102	3,058,891
처분	-	(439)	-	(1,642)	0	(64)	(208)	(2,353)
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각	-	(44,995)	(21,328)	(1,625,068)	(304)	(58,457)	-	(1,750,151)
대체	2	5,876	58,303	1,784,631	597	51,632	(1,974,109)	(73,069)
환율변동 등	822	20,689	10,749	106,866	15	3,633	56,392	199,166
기말순장부금액	1,023,308	4,518,935	1,382,927	24,106,143	11,654	664,458	4,677,677	36,385,101
2019.03.31	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,023,308	5,601,190	1,886,709	60,606,767	14,940	1,648,812	4,677,677	75,459,404
감가상각누계액	-	(1,042,342)	(484,678)	(36,332,506)	(3,266)	(984,331)	-	(38,847,123)
손상차손누계액	-	(23,699)	(19,104)	(164,604)	-	(24)	-	(207,430)
정보보조금	-	(16,215)	-	(3,515)	(20)	-	-	(19,749)
순장부금액	1,023,308	4,518,935	1,382,927	24,106,143	11,654	664,458	4,677,677	36,385,101

라. 투자계획

2019년 1분기 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액(누적)	비 고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가	2019.01.01~2019.03.31	3,157	-
합 계				3,157	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제72기 1분기	제71기	제70기
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	6,772,655	40,445,066	30,109,434
합 계			6,772,655	40,445,066	30,109,434

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅/영업 내 영업7팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등 총 8개 국가에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 14개 사무소 및 16개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에

서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

- 비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다.
- 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다.
- 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다.
- 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우 세계 유수의 모바일 및 Computing, 서버 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에, 글로벌 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	8,181	9,308,675	6,630	7,543,075

EUR	18	22,477	136	173,318
JPY	514	5,285	169,587	1,743,764

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분	10% 상승시	10% 하락시	
USD	176,560	(176,560)	
EUR	(15,084)	15,084	
JPY	(173,848)	173,848	

(2) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 9,217백만원만큼 증가 또는감소하였을 것입니다.

(3) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여

외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

8. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등

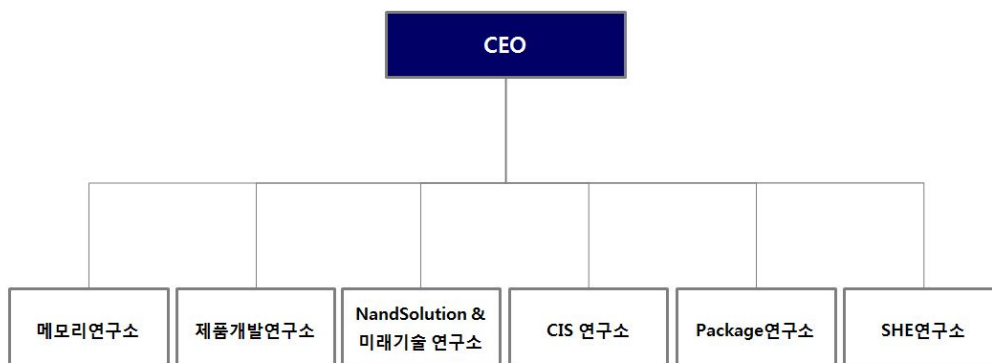
계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 6월 1일 이후	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	-
	계약 체결일	2014년 1월 28일	
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 =1 : 0.2232438	
Softeq Flash Solutions LLC	계약 유형	주식 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 15일	
	목적 및 내용	NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수	
	기타 주요내용	-	
Violin Memory	계약 유형	자산 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 29일	
	목적 및 내용	NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및	

		인력을 인수	
	기타 주요내용	PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결	
Sandisk Corporation	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약 등	-
	계약 기간	2015년 8월 ~ 2023년 3월	
	목적 및 내용	1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결 3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함	
	기타 주요내용	-	
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	계약 유형	영업 양도	-
	계약 기간	2017년 7월 1일 (영업/자산 양도 시점)	
	목적 및 내용	Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고	
	기타 주요내용	1) Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도 2) 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일	
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	계약 유형	특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여	
	기타 주요내용	-	
BCPE Pangea Cayman2 Limited	계약 유형	특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능	
	기타 주요내용	-	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, NandSolution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



나. 연구개발비용

(단위:백만원)

과 목		제72기 1분기	제71기	제70기	비 고
연구개발비용	원 재 료 비	29,845	113,064	87,617	-
	인 건 비	217,458	1,018,555	836,729	-
	감 가 상 각 비	92,874	349,710	295,672	-
	위 탁 용 역 비	54,160	227,286	225,842	-
	기 타	349,115	1,042,818	1,041,174	-
	연구개발비용 합계	743,451	2,894,954	2,487,033	-
회계처리	판매비와 관리비	653,973	2,284,000	1,975,386	-
	제 조 경 비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	89,478	610,954	511,647	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		11.0%	7.2%	8.3%	-
매 출 액		6,772,655	40,445,066	30,109,434	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제72기 1분기	1) 1xnm 16Gb DDR4 Prime	기존 제품 (1xnm 16Gb DDR4) 대비 Net Die 10% 증가 제품 개발을 추진, Power 또한 기존 제품 대비 10% 개선
	2) Hi-1336	CIS 300mm, 40nm 적용 첫 제품. 기존 양산중인 Hi-1333제품 대비 power 소모 25% 이상 개선
	3) Hi-1A1	CIS 200mm, 1.12um pixel 적용한 1/11" HD(1M) 화소 제품. 1/11" optical size 적용으로 slim module size 가능
구 분	연구과제명	기대효과
제71기	1) 2znm 8Gb HBM2 Gen2	HBM2 Gen1의 Speed 개선 Ver. 제품으로, Speed 2.4Gpbs 8Hi 제품 CS Qual. 완료 주요 고객 CS 적기 대응을 통하여 '18년 다양한 고객 인증 진행, '18년 하반기 Biz 확보를 통하여 HBM2 판매 확대 및 안정적 수익성 확보 기여
	2) 72단 SATA enterprise SSD	자체 개발 controller/FW 탑재한 72단 512Gb 3D NAND 기반 최대 4TByte 용량을 지원하는 SATA 규격의 기업용 SSD 개발하여, 기업용 SSD 사업 본격 진출
	3) 72단 PCIe enterprise SSD	자체 개발 FW 탑재한 72단 512Gb 3D NAND 기반 1TByte 이상 고용량을 지원하는 차세대 PCIe 규격의 기업

		용 SSD 개발하여, 기업용 SSD 사업 본격 진출
	4) 2znm 8Gb DDR4 Prime	Server 시장의 수요 확대에 따라 기존 2znm 8Gb DDR4 대비 특성 측면 개선을 도모한 극복제품으로 Server Portion 증대를 추진
	5) 1xnm 16Gb DDR4	자사 최고 16Gb Density Computing 제품으로, 16Gb Base 의 64GB Server 시장 적기 대응 및 Performance 개선 High Density 제품의 적기 개발을 통한 고용량/Premium 시장에서의 Solution을 확보하여 수익성에 기여
	6) 1ynm 8Gb DDR4	ICX Server Market 32GB이하, PC Client Market 8GB이하 제품 및 High Speed(3200Mbps) 대응 중심제품으로 수익성 극대화 기여, Core Device로서 1Y Tech의 안정성 확보를 통한 파생제품의 빠른 전개 확보 교두보 마련
	7) 96단 512Gb TLC	업계 최고 적층인 96단 512Gb TLC 4D NAND 개발. 기존 72단 3D NAND 대비 Wafer 당 bit 생산 1.5배로 원가 측면에서 유리하며 설계/공정 기술 혁신으로 읽기 및 쓰기 성능 약 30% 향상. 향후 96단 기반 고용량/고성능 솔루션 라인업 강화로 시장 대응력 향상 기대

구 분	연구과제명	기대효과
제70기	1) 3D 256Gb TLC	업계 최초로 개발한 72단 3D NAND FLASH로, 기존 48단 제품 대비 동위 단위면적당 셀의 수가 많아 고용량 확보에 유리함. SSD와 모바일 기기에 적용 예정이며 향후 매출 기여 예상됨.
	2) 2znm 8Gb GDDR6	2znm Tech. 기반의 GDDR6 제품으로 384개의 정보입출구(I/O)를 활용해 초당 최대768GB의 그래픽 데이터 처리가 가능. 향후 인공지능 및 가상 현실 등의 솔루션 등에 활용되며 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	3) 3D PCIe NVMe Client SSD	72단 3D NAND를 적용한 PCIe Client SSD 제품으로, 기존 36단 제품을 72단으로 전환함으로써 수익성 개선에 기여 전망
	4) 3D UFS 2.1	원가와 성능을 개선한 2세대 UFS 컨트롤러를 탑재하고, 기존 적용하던 36단 3D NAND를 48단으로 전환해 향후 수익성 개선에 기여 전망
	5) 3D eMMC 5.1	기존 적용하던 36단 3D NAND를 72단으로 전환하고, 자체 개발한 eMMC 컨트롤러를 적용해 매출 확대에 기여 예상
	6) 2znm 8Gb HBM2 Gen1	TSV 기술을 활용해 대역폭을 크게 늘림으로써 초당 204GB의 Data 처리가 가능한 초고속/저전력 제품. 고객과의 협업체제 구축으로 향후 매출 확대 기여 예상

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가구분
16.02.03	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
16.05.16	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.05.16	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.12.15	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
16.12.08	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
16.12.16	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
17.05.19	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
17.06.08	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
17.06.30	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
17.11.07	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	수시평가
17.11.09	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	수시평가
17.11.15	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	수시평가
18.04.26	회사채	AA	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
18.05.16	회사채	AA	한신평	AAA ~ D	정기평가
18.05.31	회사채	AA	한기평	AAA ~ D	정기평가
18.08.09	회사채	AA	한기평	AAA ~ D	본평가
18.08.10	회사채	AA	한신평	AAA ~ D	본평가
18.08.13	회사채	AA	NICE신평	AAA ~ D	본평가
19.04.23	회사채	AA	한기평	AAA ~ D	본평가
19.04.23	회사채	AA	한신평	AAA ~ D	본평가
19.04.24	회사채	AA	NICE신평	AAA ~ D	본평가
19.04.23	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
19.04.23	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
19.04.24	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가 구분
16.05.13	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
16.11.07	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.01.20	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가

17.11.06	발행회사	Baa3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.11.23	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
18.10.23	발행회사	Baa2	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
18.11.15	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.

A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 15개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2019년 3월 31일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 13,018건(특허12,805건/상표213건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁대응 등을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 '제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 OHSAS18001(안전보건경영시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템)과 국내인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있습니다. SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있으며, 조직 내부적으로 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 발생하는 안전보건환경 영향 요인을 모니터링하고, 국제/국내 인증규격에 따라 선행적/체계적인 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하고 환경 영향을 최소화하며, 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위하여 노력을 지속적 할 것 입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출 할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

당사는 2015년부터 시행되고 있는 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 정부로부터 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 온실가스 배출권 거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장 원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. 당사는 배출권 부족분(초과 배출량)의 구매 비용을 최소화하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고 있으

며, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리, 배출권 감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2018년 온실가스 배출량은 최종 3,719,595톤 CO₂ eq.입니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 글로벌 리더스 클럽 6년 연속 편입]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 6년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL 인증]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 10나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2018년에는 폐기물 제로화 인증을 국내 최초로 획득하여 국제적 규격에 맞는 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정 받았습니다. 회사는 향후에도 지속적으로 주요 제품에 대하여 친환경 제품 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하였고, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단 수행했으며, 127개 개선과제를 도출하여 개선 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.

또한 당사는 2017년 6월 세계 최고 수준의 지속 가능한 산업보건 선진화를 목표로 산업보건 선진화지속위원회를 발족하였으며, 작업장 및 구성원의 건강 관리 방안 수립 등 당사 작업환경 관련 산업보건 관리 역량을 높이고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제72기 1분기	제71기	제70기
[유동자산]	18,618,236	19,894,146	17,310,444
· 현금및현금성자산	1,152,257	2,349,319	2,949,991
· 단기금융상품	968,669	523,579	4,674,862
· 단기투자자산	5,070,776	5,496,452	929,801
· 매출채권	5,496,813	6,319,994	5,552,795
· 재고자산	5,117,491	4,422,733	2,640,439
· 기타	812,230	782,069	562,556
[비유동자산]	46,513,265	43,764,189	28,108,020
· 관계기업 및 조인트벤처투자	697,679	562,194	359,864
· 장기투자자산	4,418,533	4,325,550	43,226
· 유형자산	36,385,101	34,952,617	24,062,601
· 무형자산	2,611,595	2,678,770	2,247,290
· 기타	2,400,357	1,245,058	1,395,039
자산총계	65,131,501	63,658,335	45,418,464
[유동부채]	13,231,722	13,031,852	8,116,133
[비유동부채]	4,733,772	3,774,152	3,481,412
부채총계	17,965,494	16,806,004	11,597,545
[지배기업 소유주지분]	47,159,836	46,845,719	33,815,280
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
· 자본잉여금	4,143,736	4,143,736	4,143,736
· 기타포괄손익누계액	(239,859)	(482,819)	(502,264)
· 기타자본항목	(2,506,133)	(2,506,451)	(771,100)
· 이익잉여금	42,104,440	42,033,601	27,287,256
[비지배지분]	6,171	6,612	5,639
자본총계	47,166,007	46,852,331	33,820,919
매출액	6,772,655	40,445,066	30,109,434
영업이익	1,366,490	20,843,750	13,721,326
연결총당기순이익	1,102,130	15,539,984	10,642,219
지배기업의 소유주지분	1,102,753	15,540,111	10,641,512
비지배지분	(623)	(127)	707
기본주당순이익	1,612	22,255	15,073

연결에 포함된 회사수	31개사	30개사	24개사
-------------	------	------	------

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제72기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2019년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2019년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약별도재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제72기 1분기	제71기	제70기
[유동자산]	14,733,518	15,897,819	15,338,930
· 현금및현금성자산	474,190	1,741,271	2,270,036
· 단기금융상품	927,500	477,500	4,528,880
· 단기투자자산	2,908,497	2,919,140	580,449
· 매출채권	5,382,176	6,436,794	5,259,052
· 재고자산	4,351,409	3,721,521	2,224,740
· 기타	689,746	601,592	475,773
[비유동자산]	46,230,785	45,082,789	28,973,916
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	7,953,054	7,874,684	4,778,280
· 장기투자자산	4,340,970	4,249,518	37,593
· 유형자산	30,178,691	29,842,654	21,322,943
· 무형자산	2,229,485	2,298,649	1,918,259
· 기타	1,528,585	817,284	916,841
자산총계	60,964,303	60,980,608	44,312,846
[유동부채]	11,362,414	11,681,290	8,076,214
[비유동부채]	4,028,080	3,638,425	3,464,757
부채총계	15,390,494	15,319,715	11,540,971
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,183,564	4,183,564	4,183,564
[기타포괄손익누계액]	-	-	(10,735)
[기타자본항목]	(2,506,133)	(2,506,451)	(771,100)
[이익잉여금]	40,238,726	40,326,128	25,712,494
자본총계	45,573,809	45,660,893	32,771,875
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	6,420,330	40,324,651	29,718,939
영업이익	1,216,990	20,579,078	13,340,791
당기순이익	944,276	15,407,086	10,110,797
기본주당순이익	1,381	22,064	14,321

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제72기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2019년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2019년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재

제 71 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기말	제 71 기말
자산		
유동자산	18,618,236	19,894,146
현금및현금성자산	1,152,257	2,349,319
단기금융상품	968,669	523,579
단기투자자산	5,070,776	5,496,452
매출채권	5,496,813	6,319,994
기타수취채권	41,112	18,392
재고자산	5,117,491	4,422,733
당기법인세자산	8,926	22,252
기타유동자산	762,192	741,425
비유동자산	46,513,265	43,764,189
관계기업 및 공동기업투자	697,679	562,194
장기투자자산	4,418,533	4,325,550
기타수취채권	96,170	68,514
기타금융자산	1,950	310
유형자산	36,385,101	34,952,617
사용권자산	1,140,039	
무형자산	2,611,595	2,678,770
투자부동산	1,384	1,400
이연법인세자산	552,484	544,016
종업원급여자산		5,164
기타비유동자산	608,330	625,654
자산총계	65,131,501	63,658,335
부채		
유동부채	13,231,722	13,031,852
매입채무	952,620	1,096,380
미지급금	5,427,403	3,681,933
기타지급채무	966,837	1,879,520
차입금	2,511,052	1,614,303
총당부채	67,141	56,208

당기법인세부채	2,906,381	4,555,670
리스부채	223,175	
기타유동부채	177,113	147,838
비유동부채	4,733,772	3,774,152
기타지급채무	16,251	15,231
차입금	3,635,961	3,667,634
확정급여부채	63,948	5,387
이연법인세부채	6,224	6,597
리스부채	930,673	
기타비유동부채	80,715	79,303
부채총계	17,965,494	16,806,004
자본		
지배기업의 소유지분	47,159,836	46,845,719
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,143,736	4,143,736
기타자본	(2,506,133)	(2,506,451)
기타포괄손익누계액	(239,859)	(482,819)
이익잉여금	42,104,440	42,033,601
비지배지분	6,171	6,612
자본총계	47,166,007	46,852,331
부채및자본총계	65,131,501	63,658,335

연결 포괄손익계산서

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기		제 71 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	6,772,655	6,772,655	8,719,691	8,719,691
매출원가	4,092,455	4,092,455	3,383,214	3,383,214
매출총이익	2,680,200	2,680,200	5,336,477	5,336,477
판매비와관리비	1,313,710	1,313,710	969,139	969,139
영업이익	1,366,490	1,366,490	4,367,338	4,367,338
금융수익	358,346	358,346	240,135	240,135
금융비용	247,855	247,855	313,278	313,278
지분법투자 관련 손익	4,426	4,426	4,526	4,526
기타영업외수익	24,690	24,690	7,066	7,066
기타영업외비용	26,550	26,550	14,977	14,977

법인세비용차감전순이익	1,479,547	1,479,547	4,290,810	4,290,810
법인세비용	377,417	377,417	1,169,481	1,169,481
분기순이익	1,102,130	1,102,130	3,121,329	3,121,329
법인세차감후 기타포괄손익	237,231	237,231	141,965	141,965
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(5,911)	(5,911)	(7,040)	(7,040)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
해외사업장환산외환차이	225,544	225,544	150,244	150,244
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	17,598	17,598	(1,239)	(1,239)
분기총포괄이익	1,339,361	1,339,361	3,263,294	3,263,294
분기순이익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	1,102,753	1,102,753	3,120,254	3,120,254
비지배지분	(623)	(623)	1,075	1,075
분기총포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	1,339,802	1,339,802	3,262,275	3,262,275
비지배지분	(441)	(441)	1,019	1,019
주당손익				
기본주당분기순이익 (단위 : 원)	1,612	1,612	4,420	4,420
희석주당분기순이익 (단위 : 원)	1,612	1,612	4,419	4,419

연결 자본변동표

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,100)	(491,529)	27,276,521	33,815,280	5,639	33,820,919
분기순이익					3,120,254	3,120,254	1,075	3,121,329
확정급여제도의 재측정요소					(7,040)	(7,040)		(7,040)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(1,239)		(1,239)		(1,239)
해외사업장환산외환차이				150,300		150,300	(56)	150,244
배당금지급					(706,002)	(706,002)		(706,002)
주식선택권 부여			275			275		275
2018.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(770,825)	(342,468)	29,683,733	36,371,828	6,658	36,378,486
2019.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(2,506,451)	(482,819)	42,033,601	46,845,719	6,612	46,852,331
분기순이익					1,102,753	1,102,753	(623)	1,102,130
확정급여제도의 재측정요소					(5,911)	(5,911)		(5,911)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				17,598		17,598		17,598
해외사업장환산외환차이				225,362		225,362	182	225,544
배당금지급					(1,026,003)	(1,026,003)		(1,026,003)
주식선택권 부여			318			318		318
2019.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(2,506,133)	(239,859)	42,104,440	47,159,836	6,171	47,166,007

연결 현금흐름표

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기	제 71 기 1분기
영업활동현금흐름	2,630,762	4,523,576
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,679,234	5,575,680
이자의 수취	7,158	28,192
이자의 지급	(39,580)	(30,195)
배당금의 수취	42	346
법인세의 납부	(16,092)	(1,050,447)
투자활동현금흐름	(4,655,347)	(3,709,452)
단기금융상품의 순증감	(445,000)	1,301,927
단기투자자산의 순증감	459,133	(491,621)
기타수취채권의 감소	672	2,189
기타수취채권의 증가	(28,503)	(6,033)
장기투자자산의 처분	170	558
장기투자자산의 취득	(29,238)	(12,994)
기타금융자산의 증가	(1,610)	
유형자산의 처분	323	5,971
유형자산의 취득	(4,349,571)	(4,317,223)
무형자산의 처분	183	
무형자산의 취득	(148,436)	(192,226)
관계기업투자의 취득	(113,470)	
재무활동현금흐름	807,047	(301,005)
차입금의 차입	983,810	298,732
차입금의 상환	(109,224)	(599,737)
리스부채의 상환	(67,539)	
현금및현금성자산의 환율변동효과	20,476	14,248
현금및현금성자산의 순증감	(1,197,062)	527,367
기초 현금및현금성자산	2,349,319	2,949,991
분기말 현금및현금성자산	1,152,257	3,477,358

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2019년 3월 31일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤주	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	537,901,795	73.89
자기주식	44,000,570	6.04
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이이엔지㈜	국 내	건설공사 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이이텍㈜	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
행복모아㈜	국 내	반도체 의류 제조 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	국 내	반도체 제조 및 판매	12월	100	100
행복나래㈜	국 내	산업자재 유통	12월	100	100
SK hynix America Inc.	미 국	반도체 판매	12월	97.74	97.74
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Asia Pte. Ltd.	싱가포르	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(*)1	인 도	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(*)2	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l	이탈리아	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions America Inc.	미 국	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대 만	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.	벨라루스	반도체 연구개발	12월	100	100
SK APTECH Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(*)3	중 국	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(*)4	중 국	해외병원자산법인	12월	100	100
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(*)4	중 국	해외병원운영법인	12월	100	100
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.(*)5	중 국	반도체 제조 및 판매	12월	100	100
SK hynix happy (Wuxi) cleaning Ltd.(*)4	중 국	기업 건물 관리 등	12월	100	100
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.(*)6	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.(*)7	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
SkyHigh Memory Limited(*)8	홍 콩	반도체 제조 및 판매	12월	100	-
MMT(특정금전신탁)	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(*)1 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.

(*)2 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.

(*)3 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.

(*)4 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.

(*)5 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다.

(*)6 종속기업인 행복나래㈜의 종속기업입니다.

(*)7 종속기업인 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.의 종속기업입니다.

(*)8 당기 중 설립되었으며, 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다

.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명	사 유
종속기업 추가	SkyHigh Memory Limited	신규 설립

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	588,532	118,916	469,616	550,323	92,989	457,334
SK hynix America Inc.	2,314,115	2,027,900	286,215	3,013,637	2,707,732	305,905
SK hynix Deutschland GmbH	66,034	21,980	44,054	99,641	60,244	39,397
SK hynix Asia Pte. Ltd.	598,683	509,898	88,785	933,268	848,990	84,278
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	296,346	148,454	147,892	347,109	204,622	142,487
SK hynix U.K. Ltd.	372,484	362,253	10,231	536,208	518,036	18,172
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	259,358	233,562	25,796	449,054	427,498	21,556
SK hynix Japan Inc.	552,468	479,879	72,589	837,362	770,819	66,543
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	240,150	151,787	88,363	1,199,602	1,116,282	83,320
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	1,937,340	1,881,947	55,393	535,819	492,934	42,885
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	7,842,181	3,064,395	4,777,786	6,390,490	2,158,715	4,231,775
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	649,733	142,119	507,614	540,284	124,451	415,833

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기			전분기		
	매출액	분기순손익	총포괄손익	매출액	분기순손익	총포괄손익
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	152,944	12,295	12,281	122,230	12,837	12,832
SK hynix America Inc.	2,119,591	(24,799)	(24,799)	2,997,192	46,490	46,490
SK hynix Deutschland GmbH	71,092	4,712	4,712	121,872	(690)	(690)
SK hynix Asia Pte. Ltd.	460,088	2,997	2,997	716,691	(1,829)	(1,829)
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	402,524	3,194	3,194	1,451,249	(26,026)	(26,026)
SK hynix U.K. Ltd.	285,374	(8,170)	(8,170)	290,593	(1,373)	(1,373)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	328,678	4,036	4,036	759,872	1,405	1,405
SK hynix Japan Inc.	171,903	5,026	5,026	275,260	(2,638)	(2,638)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	167,595	1,955	1,955	1,765,629	4,223	4,223
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	2,594,860	10,787	10,787	52,908	138	138
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	727,349	44,191	44,191	575,533	44,964	44,964
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	84,533	7,820	7,820	92,511	6,581	6,581

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주식에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주식 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주식 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 연결실체의 2019년 기말연결재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.

연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 연결재무제표에 반영하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

(1) 리스의 정의

중전에 연결실체는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결실체는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결실체는 리스이용자에 해당하는 일부 유형의 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리할것입니다.

(2) 리스이용자

연결실체는 장비, 설비자산을 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제 1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.

그러나 연결실체는 일부 단기리스 및 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구분	부동산	구축물	기계장치	차량운반구	기타유형자산	합계
당기초	26,599	867,864	279,952	10,674	3,215	1,188,304
당분기말	24,216	865,712	237,208	10,490	2,413	1,140,039

① 유의적인 회계정책

연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다.

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 연결실체의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결실체는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치 보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

② 경과규정

연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 장비 리스 등을 운용리스로 분류하였습니다.

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음의 방법으로 측정합니다.

- 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정).

연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.

- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

연결실체는 구축물을 리스합니다. 이러한 리스 중 일부는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류되었습니다. 기존에 기업회계기준서 제1017호에 따라 인식된 금융리스의 경우, 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다.

(3) 리스제공자

연결실체는 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 연결실체는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 연결실체가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다.

연결실체는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 연결실체는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

(4) 연결재무제표에 미치는 영향

① 전환시점에 미치는 영향

기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 연결실체는 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	2019년 1월 1일
사용권자산	1,188,304
유형자산	(73,069)
리스부채	1,192,094
차입금	(68,157)
기타유동부채	(8,702)

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 연결실체는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 2.22%입니다.

(단위: 백만원)	
구 분	금 액
2019년 1월 1일의 운용리스 약정 금액	1,291,372
2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액	1,128,364
전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채	68,157
- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용	(834)
- 단기리스에 대한 면제규정 적용	(3,591)
2019년 1월 1일에 인식한 리스부채	1,192,096

② 전환기간에 미치는 영향

기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 연결실체는 2019년 3월 31일에 종전에 운용 리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 1,068,136백만원을 인식하였고, 리스부채로 1,087,434백만원을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 연결실체는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 연결실체는 이 리스에 대하여 2019년 3월 31일로 종료되는 분기 동안 감가상각비 65,187백만원, 이자비용 5,830백만원을 인식하였습니다.

4. 영업부문

연결실체는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	33,746,860	32,768,811
중 국	6,592,722	5,100,869
대 만	9,207	6,309
아시아(중국, 대만제외)	3,656	1,401
미 국	382,356	376,307
유 럽	11,648	9,908
합 계	40,746,449	38,263,605

(2) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가)와 (나)로부터 발생한 매출액은 각각 1,437,218백만원(전분기: 918,074백만원), 947,401백만원(전분기: 1,007,856백만원)입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	1,152,257	1,152,257
단기금융상품	-	968,669	968,669
단기투자자산	5,070,776	-	5,070,776
매출채권	-	5,496,813	5,496,813
기타수취채권	-	137,282	137,282
기타금융자산	-	1,950	1,950
장기투자자산	4,418,533	-	4,418,533
합 계	9,489,309	7,756,971	17,246,280

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	2,349,319	2,349,319
단기금융상품	-	523,579	523,579
단기투자자산	5,496,452	-	5,496,452
매출채권	-	6,319,994	6,319,994
기타수취채권	-	86,906	86,906
기타금융자산	-	310	310
장기투자자산	4,325,550	-	4,325,550
합 계	9,822,002	9,280,108	19,102,110

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	952,620
미지급금	5,427,403
기타지급채무(*1)	983,088
차입금	6,147,013
리스부채	1,153,848
합 계	14,663,972

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,096,380
미지급금	3,681,933
기타지급채무(*1)	1,894,751
차입금(*2)	5,281,937
합 계	11,955,001

(*1) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	966,837	1,879,520
비유동:		
장기미지급비용	1,906	1,096
임대보증금	14,345	14,135
합 계	983,088	1,894,751

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 68,157백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 연결재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	8,181	9,308,675	6,630	7,543,075
EUR	18	22,477	136	173,318
JPY	514	5,285	169,587	1,743,764

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	176,560	(176,560)
EUR	(15,084)	15,084
JPY	(173,848)	173,848

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 9,217백만원만큼 증가 또는감소하였을 것입니다.

(다) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 장·단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	17,965,494	16,806,004
자 본 (B)	47,166,007	46,852,331
현금및현금성자산 등 (C) (*1)	7,191,702	8,369,350
차입금 (D)(*2)	6,147,013	5,281,937
부채비율 (A/B)	38.09%	35.87%
순차입금비율 (D-C)/B (*3)	-	-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 68,157백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 연결재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

(*3) 당분기말과 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	5,070,776	-	5,070,776	-	5,070,776
장기투자자산	4,418,533	-	-	4,418,533	4,418,533
소 계	9,489,309	-	5,070,776	4,418,533	9,489,309
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	1,152,257	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	968,669	-	-	-	-
매출채권(*1)	5,496,813	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	137,282	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	1,950	-	-	-	-
소 계	7,756,971	-	-	-	-
금융자산 합계	17,246,280	-	5,070,776	4,418,533	9,489,309
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	952,620	-	-	-	-
미지급금(*1)	5,427,403	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	983,088	-	-	-	-
차입금	6,147,013	-	6,176,123	-	6,176,123
금융부채 합계	13,510,124	-	6,176,123	-	6,176,123

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	5,496,452	-	5,496,452	-	5,496,452
장기투자자산	4,325,550	-	-	4,325,550	4,325,550
소 계	9,822,002	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	2,349,319	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	523,579	-	-	-	-
매출채권(*1)	6,319,994	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	86,906	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	310	-	-	-	-
소 계	9,280,108	-	-	-	-
금융자산 합계	19,102,110	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,096,380	-	-	-	-
미지급금(*1)	3,681,933	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,894,751	-	-	-	-
차입금(*2)	5,281,937	-	5,300,120	-	5,300,120
금융부채 합계	11,955,001	-	5,300,120	-	5,300,120

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	처 분	평가손익	환율변동	당분기말
장기투자자산	4,325,550	29,251	(170)	(13)	63,915	4,418,533

7. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
소비세 이연납부에 대한 예치금	6,169	6,079
소 계	233,669	233,579
기타금융자산:		
당좌개설보증금	13	11
기타	300	265
소 계	313	276
합 계	233,982	233,855

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	25,492	8,465
미수수익	8,057	3,899
단기대여금	5,958	4,807
단기보증금	1,605	1,221
소 계	41,112	18,392
비유동:		
장기미수금	55	54
장기대여금	30,054	28,125
보증금	65,837	40,117
기타	224	218
소 계	96,170	68,514
합 계	137,282	86,906

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,496,861	(48)	5,496,813	6,320,042	(48)	6,319,994
유동성 기타수취채권	42,436	(1,324)	41,112	19,715	(1,323)	18,392
비유동성 기타수취채권	97,305	(1,135)	96,170	69,631	(1,117)	68,514
합 계	5,636,602	(2,507)	5,634,095	6,409,388	(2,488)	6,406,900

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	48	-	-	-	-	48
유동성 기타수취채권	1,323	-	(1)	-	2	1,324
비유동성 기타수취채권	1,117	-	-	-	18	1,135
합 계	2,488	-	(1)	-	20	2,507

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	46	-	-	-	1	47
유동성 기타수취채권	1,327	-	(1)	-	2	1,328
비유동성 기타수취채권	1,087	-	-	-	(4)	1,083
합 계	2,460	-	(1)	-	(1)	2,458

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
상 품	1,756	(11)	1,745	1,648	(14)	1,634
제 품	2,295,121	(417,830)	1,877,291	1,532,188	(127,749)	1,404,439
재공품	2,536,633	(316,382)	2,220,251	2,327,178	(208,197)	2,118,981
원재료	520,057	(34,605)	485,452	486,436	(24,894)	461,542
저장품	490,382	(20,246)	470,136	433,017	(17,138)	415,879
미착품	62,616	-	62,616	20,258	-	20,258
합 계	5,906,565	(789,074)	5,117,491	4,800,725	(377,992)	4,422,733

10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	102,311	113,030
선급비용	296,616	260,064
부가세대급금	332,962	343,821
계약자산	30,146	24,294
기타	157	216
소 계	762,192	741,425
비유동:		
장기선급금	89,283	96,817
장기선급비용	519,047	528,837
소 계	608,330	625,654
합 계	1,370,522	1,367,079

11. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	69	2,070	9.12	2,079
	SK China Company Limited(*)	중 국	컨설팅 및 투자	11.87	206,349	258,699	11.87	246,052
	Gemini Patners Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅	20.00	2,602	2,602	20.00	2,601
	TCL Fund(*)	중 국	투자	11.06	3,585	3,582	11.06	3,464
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅 및 투자	20.00	227,346	227,346	20.00	111,810
	Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources)	중 국	벤처투자 캐피탈	46.30	3,341	3,341	46.30	3,241
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	중 국	반도체 부품 제조	45.00	114,755	114,755	45.00	109,708
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	중 국	파운드리 공장 건설	50.10	83,865	85,284	50.10	83,239
합 계					641,912	697,679		562,194

(*) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본변동	배 당	기 말
Stratio, Inc.	2,079	-	(10)	1	-	2,070
SK China Company Limited	246,052	-	2,644	10,003	-	258,699
Gemini Partners Pte. Ltd.	2,601	-	(62)	63	-	2,602
TCL Fund	3,464	-	-	127	(9)	3,582
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	111,810	113,470	(207)	2,273	-	227,346
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources)	3,241	-	(19)	119	-	3,341
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	109,708	-	3,029	2,018	-	114,755
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	83,239	-	(949)	2,994	-	85,284
합 계	562,194	113,470	4,426	17,598	(9)	697,679

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	지분법손익	지분법자본변동	배당	기 말
Stratio, Inc.	2,105	1	-	-	2,106
SK China Company Limited	244,912	1,387	(960)	-	245,339
Gemini Partners Pte. Ltd.	4,003	14	35	-	4,052
TCL Fund	2,634	(8)	97	-	2,723
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	106,210	3,132	(411)	(13,120)	95,811
합 계	359,864	4,526	(1,239)	(13,120)	350,031

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업과 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	294	622	158	-
SK China Company Limited	687,389	1,240,404	58,776	130,037
Gemini Patners Pte. Ltd.	5,718	7,362	68	-
TCL Fund	948	34,775	3,305	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	1,136,732	-	-	-
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources)	6,373	844	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	233,562	390,610	93,933	275,229
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	149,558	105,615	16,907	70,871

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	403	617	159	-
SK China Company Limited	646,779	1,148,281	65,037	97,633
Gemini Patners Pte. Ltd.	5,357	7,649	-	-
TCL Fund	915	33,596	3,188	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	559,050	-	-	-
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources)	6,187	814	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	211,273	376,266	114,756	228,987
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	145,509	19,295	1,490	-

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업과 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
Stratio, Inc.	7	(114)	8	13
SK China Company Limited	49,310	22,279	28,878	11,689
Gemini Patners Pte. Ltd.	-	(309)	-	68
TCL Fund	-	2	-	(74)
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	-	(1,033)	-	-
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources)	-	(42)	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	168,672	6,731	148,958	6,610
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	(1,894)	-	-

12. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,325,550	43,226
취득	29,251	12,994
처분	(170)	(309)
평가손익	(13)	-
환율변동	63,915	209
기말장부금액	4,418,533	56,120

13. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	34,952,617	24,062,601
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	(73,069)	-
조정 후 기초장부금액	34,879,548	24,062,601
취득	3,058,891	4,521,120
처분 및 폐기	(2,353)	(3,086)
감가상각	(1,750,151)	(1,318,830)
환율변동	199,166	102,964
기말장부금액	36,385,101	27,364,769

(2) 당분기말 현재 연결실체의 일부 기계장치 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 33 참조).

14. 리스

(1) 당분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	당분기
기초장부금액	-
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	1,188,304
조정 후 기초장부금액	1,188,304
증가	3,838
감가상각	(66,710)
환율변동	14,607
기말장부금액	1,140,039

(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	당분기
기초장부금액	-
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	1,192,094
조정 후 기초장부금액	1,192,094
증가	3,678
이자비용	6,447
지급	(68,156)
환율변동	19,785
기말장부금액	1,153,848

15. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,678,770	2,247,290
취득	148,436	192,226
처분 및 폐기	(1,674)	(1,659)
상각	(221,098)	(129,801)
손상차손	(70)	(3,463)
환율변동 등	7,231	259
기말장부금액	2,611,595	2,304,852

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 89,478백만원(전분기: 132,545백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 653,973백만원(전분기: 512,389백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

16. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,400	2,468
감가상각	(16)	(26)
기말장부금액	1,384	2,442

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 16백만원(전분기: 26백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 59백만원(전분기: 122백만원)입니다.

17. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말(*)
유 동:		
단기차입금	1,408,055	585,788
유동성장기차입금(*)	653,034	578,665
유동성사채	449,963	449,850
소 계	2,511,052	1,614,303
비유동:		
장기차입금(*)	2,129,595	2,161,566
사 채	1,506,366	1,506,068
소 계	3,635,961	3,667,634
합 계	6,147,013	5,281,937

(*) 전기말의 유동성장기차입금과 장기차입금은 각각 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 10,563백만원과 57,594백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시합니다.

18. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	5,264	8,973
선수수익	2,193	186
예수금	82,836	49,770
보증예수금	1,036	1,036
계약부채	81,344	80,373
기타	4,440	7,500
소 계	177,113	147,838
비유동:		
기타장기종업원급여부채	75,815	74,403
장기선수금	4,900	4,900
소 계	80,715	79,303
합 계	257,828	227,141

19. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
판매보증충당부채	3,992	-	(206)	(671)	3,115
소송충당부채	5,881	-	(5,881)	-	-
배출부채	46,335	17,691	-	-	64,026
합 계	56,208	17,691	(6,087)	(671)	67,141

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환입변동	기 말
판매보증충당부채	3,807	14	(268)	-	3,553
소송충당부채	9,460	-	(4,391)	264	5,333
배출부채	37,412	17,242	-	-	54,654
합 계	50,679	17,256	(4,659)	264	63,540

(2) 판매보증충당부채

연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 소송충당부채

연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 배출부채

연결실체는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

20. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,667,664	1,609,055
사외적립자산의 공정가치	(1,603,716)	(1,608,832)
순확정급여부채	63,948	223
확정급여부채	63,948	5,387
확정급여자산(*)	-	(5,164)

(*) 전기말 현재 지배기업의 확정급여제도의 초과적립액 5,164백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	2.64 ~ 3.78	2.64 ~ 3.78
미래임금상승률	2.70 ~ 5.83	2.70 ~ 5.83

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,609,055	1,330,559
당기근무원가	54,369	42,502
이자원가	14,898	14,117
관계사전출입액	2,287	1,024
퇴직급여지급액	(12,955)	(8,662)
기타	10	36
기말장부금액	1,667,664	1,379,576

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,608,832	1,337,848
이자수익	15,123	14,186
관계사전출입액	3,120	1,016
퇴직급여지급액	(17,447)	(16,078)
재측정요소	(5,912)	(7,040)
기말장부금액	1,603,716	1,329,932

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	54,369	42,502
순이자원가	(225)	(69)
합 계	54,144	42,433

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,602,005	1,607,552
기타	1,711	1,280
합 계	1,603,716	1,608,832

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 9,211백만원과 7,147백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 101백만원(전분기: 44백만원)입니다.

21. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다.

22. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	517,939	517,939
합 계	4,143,736	4,143,736
기타자본:		
자기주식	(2,508,427)	(2,508,427)
주식선택권	2,294	1,976
합 계	(2,506,133)	(2,506,451)
자기주식수	44,001	44,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 지배기업의 유통주식수는 각각 684,002천주 및 706,002천주입니다

23. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
(부의)지분법자본변동	(568)	(18,166)
해외사업장외화환산차이	(239,291)	(464,653)
합 계	(239,859)	(482,819)

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
(부의)지분법자본변동	(18,166)	17,598	(568)
해외사업장외화환산차이	(464,653)	225,362	(239,291)
합 계	(482,819)	242,960	(239,859)

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	기 초	증 감	유의적인 회계 정책 변경효과	기 말
(부의)지분법자본변동	(20,442)	(1,239)	-	(21,681)
장기투자자산평가손익	(10,735)	-	10,735	-
해외사업장환산외환차이	(471,087)	150,300	-	(320,787)
합 계	(502,264)	149,061	10,735	(342,468)

24. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	281,555	178,954
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	41,587,379	41,619,141
합 계	42,104,440	42,033,601

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2019년 3월 22일자 주주총회에서 배당금 1,026,003백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

25. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품 등의 판매	6,753,808	8,705,845
용역의 제공	18,847	13,846
합 계	6,772,655	8,719,691

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
DRAM	5,353,137	6,880,516
NAND Flash	1,155,316	1,693,838
기타	264,202	145,337
합 계	6,772,655	8,719,691

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
국 내	209,498	308,041
중 국	3,158,068	3,258,755
대 만	327,918	759,068
아시아(중국, 대만 제외)	630,369	990,082
미 국	2,097,673	2,995,086
유 럽	349,129	408,659
합 계	6,772,655	8,719,691

(4) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
한 시점에 이행	6,753,808	8,705,845
기간에 걸쳐 이행	18,847	13,846
합 계	6,772,655	8,719,691

(5) 수행의무와 수익인식 정책

수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 연결실체는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다.

고객과의 계약에서의 주요 매출 별 수행의무의 특성과 이행시기와 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.

구 분	재화나 용역의 특성, 수행의무 이행시기	기업회계기준서 제1115호 하에서 수익인식
제품의 판매	<p>제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 이 시점에 수익을 인식합니다.</p> <p>제품의 하자 등이 발생할 경우, 고객에게 반품권이 부여되어 있으며 반품된 제품은 새 제품으로 교체 또는 현금으로 환불됩니다.</p>	<p>과거 정보를 이용하여 예상되는 반품 추정치를 반영한 금액을 제품이 고객에게 이전되어 고객이 인수한 시점에 수익으로 인식하였으며, 반품부채(계약부채)와 고객에게서 제품을 회수할 기업의 권리(계약자산)에 대하여 자산이 인식되었습니다.</p> <p>반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리에 대해 인식하는 자산은 처음 측정할 때 제품의 이전 장부금액에서 그 제품 회수에 예상되는 원가를 차감한 금액으로 측정됩니다. 반품부채는 기타유동부채(주석 18 참조)에 포함되어 있고, 반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리는 기타유동자산(주석 10 참조)에 포함 되어 있습니다. 연결실체는 보고기간 말마다 반품될 제품에 대한 예상치의 변동을 반영하여 자산과 부채의 측정치를 새로 수정합니다.</p>

26. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급여	147,407	135,533
퇴직급여	11,452	7,602
복리후생비	34,611	25,312
지급수수료	106,331	57,299
감가상각비	43,714	28,749
무형자산상각비	196,784	110,962
운반보관비	7,954	5,921
송무비	7,839	3,375
임차료	1,228	3,234
세금과공과	16,084	5,232
교육훈련비	11,872	7,064
광고선전비	11,418	10,042
수도광열비	3,424	3,591
소모품비	15,191	12,492
수선비	5,229	5,880
여비교통비	4,127	3,506
판매촉진비	16,721	16,875
기타	18,351	14,081
소 계	659,737	456,750
경상개발비:		
연구개발비 총지출액	743,451	644,934
개발비 자산화	(89,478)	(132,545)
소 계	653,973	512,389
합 계	1,313,710	969,139

27. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(574,123)	(380,804)
원재료 및 소모품 사용	1,510,770	1,204,220
종업원급여	937,898	843,171
감가상각 및 무형자산 상각	2,013,112	1,417,526
기술료	34,092	55,544
지급수수료	490,269	354,797
동력 및 수도광열비	323,976	264,179
수선비	263,303	225,287
외주가공비	290,826	240,306
기 타	116,042	128,127
합 계(*)	5,406,165	4,352,353

(*) 분기연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

28. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익:		
이자수익	11,306	27,282
배당금수익	42	346
외환차이(*)	320,219	207,561
단기투자자산평가이익	20,737	1,104
단기투자자산처분이익	6,042	3,594
장기투자자산처분이익	-	248
합 계	358,346	240,135
금융비용:		
이자비용	41,070	24,891
외환차이	206,772	288,387
장기투자자산평가손실	13	-
합 계	247,855	313,278
순금융손익	110,491	(73,143)

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 63,915백만원이 포함되어 있습니다.

29. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	202	5,768
기타	24,488	1,298
합 계	24,690	7,066

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	2,184	2,883
무형자산처분손실	1,491	1,659
무형자산손상차손	70	3,463
매출채권처분손실	1,609	2,235
기부금	4,557	1,047
기타	16,639	3,690
합 계	26,550	14,977

30. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

31. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)		
구 분	당분기	전분기
지배기업소유주지분 분기순이익	1,102,753	3,120,254
가중평균유통보통주식수(*)	684,001,795	706,001,795
기본주당이익	1,612 원	4,420 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(44,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	684,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주희석분기순이익	1,102,753	3,120,254
가중평균희석유통보통주식수(*)	684,066,765	706,075,772
희석주당이익	1,612 원	4,419 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
가중평균유통보통주식수	684,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	64,970	73,977
가중평균희석유통보통주식수	684,066,765	706,075,772

32. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource)

공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배 기업인 SK(주)와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득
관계기업	SK China Company Limited	4	2,281	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,100	168,500	-
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	186	-	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	23,672	226,032	3,555
	SK(주)(*2)	7,705	60,567	39,031
	ESSENCORE Limited	176,061	-	-
	SK건설(주)	13,415	-	85,184
	SK에너지(주)	7,576	24,899	-
	SK네트웍스(주)	2,574	2,540	-
	에스케이씨솔믹스(주)	219	19,715	627
	충청에너지서비스(주)	6	10,718	-
	SK머티리얼즈(주)	1,077	19,060	-
	SK실트론(주)	8,380	106,199	-
	기타	28,896	140,271	4,001
합 계		270,871	780,782	132,398

(*1) 영업비용 등에는 배당금 219,200만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 20,537백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수취
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	2	148,740	-	13,120
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*1)	28	151,572	2,818	-
	SK㈜(*2)	274	43,336	46,096	-
	ESSEN CORE Limited	253,637	-	-	-
	SK건설㈜	347	142	556,541	-
	SK에너지㈜	1,383	34,345	-	-
	SK네트웍스㈜	-	1,203	10,600	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	5,228	96	-
	충청에너지서비스㈜	-	8,639	-	-
	행복나래㈜	10	119,614	12,298	-
	SK머티리얼즈㈜	-	14,828	-	-
	SK실트론㈜	808	68,061	-	-
	기타	82	55,491	6,090	-
합 계		256,571	651,199	634,539	13,120

(*1) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 8,808백만원입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
관계기업	SK China Company Limited	2	2,305
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	514	113,666
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	146	-
기타특수관계자	SK텔레콤㈜	5,720	225,245
	SK㈜	4,324	136,960
	ESSEN CORE Limited	61,794	-
	SK건설㈜	13,077	485,228
	SK에너지㈜	1,628	6,850
	SK네트웍스㈜	244	491
	에스케이씨솔믹스㈜	73	11,653
	충청에너지서비스㈜	6	3,268
	SK머티리얼즈㈜	432	13,100
	SK실트론㈜	142,887	50,357
	기타	9,792	92,921

합 계	240,639	1,142,044
-----	---------	-----------

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
관계기업	SK China Company Limited	1	9,060
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	33	102,932
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	19	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	3,339	15,489
	SK(주)	1,876	144,225
	ESSEN CORE Limited	71,673	-
	SK건설(주)	12,910	744,935
	SK에너지(주)	5,350	9,005
	SK네트웍스(주)	790	1,452
	에스케이씨솔믹스(주)	57	8,113
	충청에너지서비스(주)	4	3,644
	SK머티리얼즈(주)	443	18,214
	SK실트론(주)	156,023	37,070
	기타	14,918	120,955
합 계		267,436	1,215,094

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결실체는 기업활동의 계획·지휘·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급여	1,932	794
퇴직급여	102	88
주식보상비용	47	1
합 계	2,081	883

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리	108	-	-	-
	SK케미칼㈜	2,120	368	-	-
	SK바이오사이언스㈜	957	1	-	-
	㈜에이앤티에스	2	3,334	-	-
합 계		3,187	3,703	-	-

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	-	299	-	-

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리	90	-
	SK케미칼㈜	905	227
	SK바이오사이언스㈜	409	1
	㈜에이앤티에스	-	1,461
합 계		1,404	1,689

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리㈜	5	-
	SK케미칼㈜	1,253	331
	SK바이오사이언스㈜	884	13
합 계		2,142	344

33. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 SK hynix America Inc. 등 지배기업의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 지배기업 및 지배기업의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 중국 특허심판원의 소송 특허 무효 결정에 대한 항소를 포기하여, 동 결정은 최종적으로 확정되었습니다.

2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 1월 31일 연결실체가 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다.

② 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 당분기말 현재 연결실체는 제기된 본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

④ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되

며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

연결실체는 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additi-onal Service Charge를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

연결실체는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 연결실체는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	19,369	1,119,922	시설자금대출관련 등
건 물	57,412		
기계장치	575,652		
합 계	652,433	1,119,922	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 연결실체의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	225
		매입외환 등 수출금융약정	USD	50
		수입·수출 포괄한도약정	USD	960
		당좌차월	KRW	20,000
		상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	1,548
			USD	392
SK hynix America Inc. (SKHYA)등 판매법인	씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	141
국내종속기업	하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	45
		외상매출채권담보대출	KRW	57,020
		납품대금지급업무대행계약	KRW	12,500

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
구 분	단 위	금 액	비 고
종업원	KRW	4	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)	USD	60	물품공급계약에 대한 지급보증

(*) 연결실체는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금 1,000백만원을 담보로제공 받았습니다.

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 1,779,442백만원 (전기말: 1,857,092백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정

연결실체는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 2017년 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 당분기 중 Wafer 구매와 관련하여 사용된 선급금은 13,446백만원이며 당분기말 현재 선급금 잔액은 136,554백만원입니다. 한편, SK실트론(주)는 연결실체의 선급금을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) Toshiba Memory Corporation(이하 'TMC') 투자

BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 'SPC1') 및 BCPE Pang-ea Cayman2 Limited(이하 'SPC2')에 대한 투자를 통한 TMC투자와 관련하여 연결실체는 지분 취득일 이후 일정기간 동안 연결실체의 직·간접적인 TMC 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 연결실체는 동 기간동안 TMC에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

34. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	1,102,130	3,121,329
조정항목:		
법인세비용	377,417	1,169,481
퇴직급여	54,144	42,433
유형자산상각비	1,750,151	1,318,830
투자부동산상각비	16	26
무형자산상각비	221,098	129,801
사용권자산상각비	66,710	-
주식보상비용	318	275
유형자산처분손실	2,184	2,883
무형자산처분손실	1,491	1,659
무형자산손상차손	70	3,463
이자비용	41,070	24,891
외화환산손실	85,781	94,235
장기투자자산평가손실	13	-
지분법손익	(4,426)	(4,526)
유형자산처분이익	(202)	(5,768)
단기투자자산평가이익	(20,737)	(1,104)
단기투자자산처분이익	(6,042)	(3,594)
장기투자자산처분이익	-	(248)
이자수익	(11,306)	(27,282)
외화환산이익	(149,801)	(44,953)
기 타	1,371	1,889
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	1,061,463	(32,970)
기타수취채권의 감소(증가)	(4,855)	24,711
재고자산의 증가	(670,841)	(451,101)
기타자산의 감소(증가)	1,256	(130,886)
매입채무의 증가(감소)	(318,091)	9,057
미지급금의 증가(감소)	(31,410)	955,649
기타지급채무의 감소	(906,108)	(656,160)
충당부채의 증가(감소)	10,952	(18,079)
기타부채의 증가	28,545	58,594
퇴직금의 지급	(3,127)	(6,855)

영업으로부터 창출된 현금	2,679,234	5,575,680
---------------	-----------	-----------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득 관련 미지급금 등 증가	-	199,780
배당금 관련 미지급금의 증가	1,026,003	706,002

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
전기말	5,281,937	4,171,270
기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(*)	1,123,937	-
당분기초	6,405,874	4,171,270
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	983,810	298,732
- 차입금의 상환	(109,224)	(599,737)
- 리스부채의 상환	(67,539)	-
- 이자의 지급	(617)	-
기타(환율변동효과 등)	81,700	(3,945)
상각(이자비용)	6,857	389
기말	7,300,861	3,866,709

(*) 기업회계기준서 제1116호의 최초적용으로 인해 리스부채를 추가로 인식하였습니다.

35. 주식기준보상

(1) 지배기업은 지배기업이 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
6차	8,171	-	-	8,171	2019.02.28	2019.02.28 ~ 2021.02.28	2021.03.01 ~ 2024.02.29	73,430원
7차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2021.03.22	2021.03.23 ~ 2024.03.22	71,560원
8차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2022.03.22	2022.03.23 ~ 2025.03.22	77,290원
9차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2023.03.22	2023.03.23 ~ 2026.03.22	83,470원
합 계	506,402	-	-	506,402				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%
6차	25.60%	16,505원	1.36%	1.89%
7차	26.20%	17,744원	1.32%	1.82%
8차	26.20%	16,888원	1.32%	1.88%
9차	26.20%	16,093원	1.32%	1.91%

(3) 연결실체가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 318백만원(전분기: 275백만원) 입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재

제 71 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기말	제 71 기말
자산		
유동자산	14,733,518	15,897,819
현금및현금성자산	474,190	1,741,271
단기금융상품	927,500	477,500
단기투자자산	2,908,497	2,919,140
매출채권	5,382,176	6,436,794
기타수취채권	62,025	19,454
재고자산	4,351,409	3,721,521
기타유동자산	627,721	582,139
비유동자산	46,230,785	45,082,789
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	7,953,054	7,874,684
장기투자자산	4,340,970	4,249,518
기타수취채권	58,133	32,794
기타금융자산	11	11
유형자산	30,178,691	29,842,654
사용권자산	707,826	
무형자산	2,229,485	2,298,649
투자부동산	1,384	1,400
이연법인세자산	156,545	156,545
종업원급여자산		4,581
기타비유동자산	604,686	621,953
자산총계	60,964,303	60,980,608
부채		
유동부채	11,362,414	11,681,290
매입채무	1,387,892	1,505,170
미지급금	4,696,133	2,686,520
기타지급채무	858,464	1,704,766
차입금	1,102,997	1,028,170
충당부채	77,578	67,473
당기법인세부채	2,884,305	4,530,712
리스부채	176,443	
기타유동부채	178,602	158,479

비유동부채	4,028,080	3,638,425
기타지급채무	17,124	16,104
차입금	3,333,636	3,546,141
확정급여부채	56,061	
리스부채	543,744	
기타비유동부채	77,515	76,180
부채총계	15,390,494	15,319,715
자본		
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,183,564	4,183,564
기타자본	(2,506,133)	(2,506,451)
이익잉여금	40,238,726	40,326,128
자본총계	45,573,809	45,660,893
부채및자본총계	60,964,303	60,980,608

포괄손익계산서

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기		제 71 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	6,420,330	6,420,330	8,745,834	8,745,834
매출원가	4,016,872	4,016,872	3,499,128	3,499,128
매출총이익	2,403,458	2,403,458	5,246,706	5,246,706
판매비와관리비	1,186,468	1,186,468	881,643	881,643
영업이익	1,216,990	1,216,990	4,365,063	4,365,063
금융수익	240,359	240,359	198,853	198,853
금융비용	145,052	145,052	211,987	211,987
기타영업외수익	16,182	16,182	5,537	5,537
기타영업외비용	32,450	32,450	14,266	14,266
법인세비용차감전순이익	1,296,029	1,296,029	4,343,200	4,343,200
법인세비용	351,753	351,753	1,148,547	1,148,547
분기순이익	944,276	944,276	3,194,653	3,194,653
법인세차감후 기타포괄손익	(5,675)	(5,675)	(7,035)	(7,035)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(5,675)	(5,675)	(7,035)	(7,035)
분기총포괄이익	938,601	938,601	3,187,618	3,187,618
주당손익				
기본주당분기순이익 (단위 : 원)	1,381	1,381	4,525	4,525
희석주당분기순이익 (단위 : 원)	1,380	1,380	4,525	4,525

자본변동표

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,100)		25,701,759	32,771,875
분기순이익					3,194,653	3,194,653
확정급여제도의 재측정요소					(7,035)	(7,035)
배당금지급					(706,002)	(706,002)
주식선택권 부여			275			275
2018.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(770,825)		28,183,375	35,253,766
2019.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(2,506,451)		40,326,128	45,660,893
분기순이익					944,276	944,276
확정급여제도의 재측정요소					(5,675)	(5,675)
배당금지급					(1,026,003)	(1,026,003)
주식선택권 부여			318			318
2019.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(2,506,133)		40,238,726	45,573,809

현금흐름표

제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 72 기 1분기	제 71 기 1분기
영업활동현금흐름	2,314,920	4,399,945
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,342,838	5,435,962
이자의 수취	4,850	25,077
이자의 지급	(30,684)	(29,059)
배당금의 수취		346
법인세의 납부	(2,084)	(1,032,381)
투자활동현금흐름	(3,424,583)	(3,566,877)
단기금융상품의 순증감	(450,000)	1,354,040
단기투자자산의 순증감	26,790	(232,496)
기타수취채권의 감소	571	1,889
기타수취채권의 증가	(25,910)	(5,107)
장기투자자산의 처분	170	558
장기투자자산의 취득	(29,168)	(8,780)
유형자산의 처분	10,831	6,482

유형자산의 취득	(2,738,942)	(4,042,429)
무형자산의 처분	170	
무형자산의 취득	(147,471)	(190,134)
종속기업투자(MMT)의 순증감	444,716	(270,699)
종속기업투자(주식)의 취득	(402,870)	(180,201)
관계기업투자의 취득	(113,470)	
재무활동현금흐름	(157,418)	(260,678)
차입금의 차입		298,732
차입금의 상환	(103,424)	(559,410)
리스부채의 상환	(53,994)	
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,167)
현금및현금성자산의 순증감	(1,267,081)	566,223
기초 현금및현금성자산	1,741,271	2,270,036
분기말 현금및현금성자산	474,190	2,836,259

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2019년 3월 31일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤(주)	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	537,901,795	73.89
자기주식	44,000,570	6.04
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 록셈 부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차 보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다.

당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 당사의 2019년 기말재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.

당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 재무제표에 반영하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

(1) 리스의 정의

종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 리스이용자에 해당하는 일부 유형의 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리할 것입니다.

(2) 리스이용자

당사는 장비, 설비자산을 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제 1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.

그러나 당사는 일부 단기리스 및 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구분	부동산	구축물	기계장치	기타유형자산	합계
당기초	1,947	476,673	279,952	3,186	761,758
당분기말	1,567	466,661	237,208	2,390	707,826

① 유의적인 회계정책

당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다.

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치 보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

② 경과규정

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 장비 리스 등을 운용리스로 분류하였습니다.

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음의 방법으로 측정합니다.

- 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정).

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.

- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

당사는 구축물을 리스합니다. 이러한 리스 중 일부는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류되었습니다. 기존에 기업회계기준서 제1017호에 따라 인식된 금융리스의 경우, 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다.

(3) 리스제공자

당사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 당사는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 당사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다.

당사는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 당사는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

(4) 재무제표에 미치는 영향

① 전환시점에 미치는 영향

기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	2019년 1월 1일
사용권자산	761,758
유형자산	(71,699)
리스부채	765,518
차입금	(66,757)
기타유동부채	(8,702)

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 2.22%입니다.

(단위: 백만원)	
구 분	금 액
2019년 1월 1일의 운용리스 약정 금액	787,735
2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액	700,116
전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채	66,757
- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용	(428)
- 단기리스에 대한 면제규정 적용	(927)
2019년 1월 1일에 인식한 리스부채	765,518

② 전환기간에 미치는 영향

기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 2019년 3월 31일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 637,561백만원을 인식하였고, 리스부채로 655,425백만원을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 3월 31일로 종료되는 분기 동안 감가상각비 52,498백만원, 이자비용 3,512백만원을 인식하였습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	474,190	474,190
단기금융상품	-	927,500	927,500
단기투자자산	2,908,497	-	2,908,497
매출채권	-	5,382,176	5,382,176
기타수취채권	-	120,158	120,158
기타금융자산	-	11	11
장기투자자산	4,340,970	-	4,340,970
합 계	7,249,467	6,904,035	14,153,502

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	1,741,271	1,741,271
단기금융상품	-	477,500	477,500
단기투자자산	2,919,140	-	2,919,140
매출채권	-	6,436,794	6,436,794
기타수취채권	-	52,248	52,248
기타금융자산	-	11	11
장기투자자산	4,249,518	-	4,249,518
합 계	7,168,658	8,707,824	15,876,482

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,387,892
미지급금	4,696,133
기타지급채무(*1)	875,588
차입금	4,436,633
리스부채	720,187
합 계	12,116,433

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,505,170
미지급금	2,686,520
기타지급채무(*1)	1,720,870
차입금(*2)	4,574,311
합 계	10,486,871

(*1) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	858,464	1,704,766
비유동:		
장기미지급비용	1,906	1,096
임대보증금	15,218	15,008
합 계	875,588	1,720,870

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 66,757백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	4,853	5,521,385	2,613	2,973,138
EUR	-	451	11	13,742
JPY	479	4,924	136,671	1,405,303

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	254,825	(254,825)
EUR	(1,329)	1,329
JPY	(140,038)	140,038

(나) 이자율위험

당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 4,951백만원만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 장·단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공하는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	15,390,494	15,319,715
자 본 (B)	45,573,809	45,660,893
현금및현금성자산 등(C) (*1)	4,310,187	5,137,911
차입금 (D) (*2)	4,436,633	4,574,311
부채비율 (A/B)	33.77%	33.55%
순차입금비율 (D-C)/B (*3)	0.28%	-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 66,757백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

(*3) 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	2,908,497	-	2,908,497	-	2,908,497
장기투자자산	4,340,970	-	-	4,340,970	4,340,970
소 계	7,249,467	-	2,908,497	4,340,970	7,249,467
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	474,190	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	927,500	-	-	-	-
매출채권(*1)	5,382,176	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	120,158	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	11	-	-	-	-
소 계	6,904,035	-	-	-	-
금융자산 합계	14,153,502	-	2,908,497	4,340,970	7,249,467
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,387,892	-	-	-	-
미지급금(*1)	4,696,133	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	875,588	-	-	-	-
차입금	4,436,633	-	4,465,891	-	4,465,891
금융부채 합계	11,396,246	-	4,465,891	-	4,465,891

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	2,919,140	-	2,919,140	-	2,919,140
장기투자자산	4,249,518	-	-	4,249,518	4,249,518
소 계	7,168,658	-	2,919,140	4,249,518	7,168,658
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	1,741,271	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	477,500	-	-	-	-
매출채권(*1)	6,436,794	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	52,248	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	11	-	-	-	-
소 계	8,707,824	-	-	-	-
금융자산 합계	15,876,482	-	2,919,140	4,249,518	7,168,658
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,505,170	-	-	-	-
미지급금(*1)	2,686,520	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,720,870	-	-	-	-
차입금(*2)	4,574,311	-	4,592,699	-	4,592,699
금융부채 합계	10,486,871	-	4,592,699	-	4,592,699

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	취 득	처 분	환율변동	당분기말
장기투자자산	4,249,518	29,168	(170)	62,454	4,340,970

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
기타금융자산:		
당좌개설보증금	11	11
합 계	227,511	227,511

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	54,276	15,818
미수수익	7,569	3,456
단기대여금	180	180
소 계	62,025	19,454
비유동:		
장기대여금	1,500	1,531
보증금	56,633	31,263
소 계	58,133	32,794
합 계	120,158	52,248

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,382,176	-	5,382,176	6,436,794	-	6,436,794
유동성 기타수취채권	63,306	(1,281)	62,025	20,736	(1,282)	19,454
비유동성 기타수취채권	58,235	(102)	58,133	32,896	(102)	32,794
합 계	5,503,717	(1,383)	5,502,334	6,490,426	(1,384)	6,489,042

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
유동성 기타수취채권	1,282	-	(1)	-	1,281
비유동성 기타수취채권	102	-	-	-	102
합 계	1,384	-	(1)	-	1,383

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
유동성 기타수취채권	1,286	-	(1)	-	1,285
비유동성 기타수취채권	102	-	-	-	102
합 계	1,388	-	(1)	-	1,387

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제품	2,050,151	(334,650)	1,715,501	1,312,745	(106,701)	1,206,044
재공품	2,212,393	(315,740)	1,896,653	2,048,275	(207,462)	1,840,813
원재료	413,944	(33,007)	380,937	407,127	(23,346)	383,781
저장품	323,067	(10,511)	312,556	284,180	(6,820)	277,360
미착품	45,762	-	45,762	13,523	-	13,523
합 계	5,045,317	(693,908)	4,351,409	4,065,850	(344,329)	3,721,521

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	84,061	92,704
선급비용	277,851	243,320
부가세대급금	231,468	211,899
계약자산	34,192	34,008
기타	149	208
소 계	627,721	582,139
비유동:		
장기선급금	89,169	96,817
장기선급비용	515,517	525,136
소 계	604,686	621,953
합 계	1,232,407	1,204,092

10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	7,376,733	7,411,833
관계기업 및 공동기업	576,321	462,851
합 계	7,953,054	7,874,684

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이엔지㈜	국 내	사업지원 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이시스템즈㈜	국 내	사업지원 및 공사 등	100.00	6,760	100.00	6,760
행복모아㈜	국 내	사업지원 및 제조	100.00	7,400	100.00	7,400
에스케이하이닉스 시스템아이씨㈜	국 내	파운드리 사업	100.00	404,928	100.00	404,928
행복나래㈜	국 내	산업자재 유통	100.00	63,147	100.00	63,147
SK hynix America Inc.	미 국	해외판매법인	97.74	31	97.74	31
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	해외판매법인	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix Asia Pte. Ltd.,	싱가포르	해외판매법인	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	해외판매법인	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	해외판매법인	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	해외판매법인	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Japan Inc.	일 본	해외판매법인	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	중 국	해외판매법인	100.00	4,938	100.00	4,938
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	인 도	해외판매법인	1.00	5	1.00	5
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	해외판매법인	100.00	237	100.00	237
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(*)1	중 국	해외제조법인	100.00	3,868,622	100.00	3,533,222
SK hynix Italy S.r.l	이탈리아	해외연구개발법인	100.00	18	100.00	18
SK hynix memory solutions America Inc.	미 국	해외연구개발법인	100.00	311,283	100.00	311,283
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대 만	해외연구개발법인	100.00	7,819	100.00	7,819
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.	벨라루스	해외연구개발법인	99.93	14,579	99.93	14,579
SK APTECH Ltd.(*)2	홍 콩	해외투자법인	100.00	440,770	100.00	373,300
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	홍 콩	해외투자법인	100.00	60,613	100.00	60,613
MMT(특정금전신탁)(*)3	국 내	특정금전신탁	100.00	1,988,806	100.00	2,426,776
합 계				7,376,733		7,411,833

(*)1) 당분기 중 유상증자로 인하여 335,400백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.

(*)2) 당분기 중 유상증자로 인하여 67,470백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.

(*)3) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)을 일부 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(※1)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	2,194	9.12	2,194
	SK China Company Limited(※1)	중 국	부동산 투자업 등	11.87	257,169	11.87	257,169
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(※2)	싱가포르	컨설팅	20.00	224,350	20.00	110,880
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	중 국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
합 계					576,321		462,851

(※1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(※2) 당분기 중 113,470백만원 추가 출자하였습니다.

11. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,249,518	37,593
취득	29,168	8,780
처분	(170)	(309)
환율변동	62,454	-
기말장부금액	4,340,970	46,064

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	29,842,654	21,322,943
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	(71,699)	-
조정 후 기초장부금액	29,770,955	21,322,943
취득	1,920,285	4,074,772
처분 및 폐기	(34,163)	(9,047)
감가상각	(1,478,386)	(1,103,014)
기말장부금액	30,178,691	24,285,654

(2) 당분기말 현재 당사의 일부 기계장치는 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 31 참조).

13. 리스

(1) 당분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	당분기
기초장부금액	-
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	761,758
조정 후 기초장부금액	761,758
감가상각	(53,932)
기말장부금액	707,826

(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	당분기
기초장부금액	-
기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정	765,518
조정 후 기초장부금액	765,518
이자비용	4,112
지급	(54,431)
환율변동	4,988
기말장부금액	720,187

14. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,298,649	1,918,259
취득	147,471	190,134
처분 및 폐기	(1,652)	(1,624)
상각	(214,913)	(125,471)
손상차손	(70)	(3,463)
기말장부금액	2,229,485	1,977,835

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 89,478백만원(전분기: 132,545백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 652,198백만원(전분기: 512,468백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

15. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,400	2,468
감가상각	(16)	(26)
기말장부금액	1,384	2,442

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 16백만원(전분기: 26백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 59백만원(전분기: 122백만원)입니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
유동성장기차입금(*)	653,034	578,320
유동성사채	449,963	449,850
소 계	1,102,997	1,028,170
비유동:		
장기차입금(*)	1,827,270	2,040,073
사채	1,506,366	1,506,068
소 계	3,333,636	3,546,141
합 계	4,436,633	4,574,311

(*) 전기말의 유동성장기차입금과 장기차입금은 각각 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 10,177백만원과 56,580백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시합니다.

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	661	225
선수수익	41	44
예수금	66,599	36,641
계약부채	111,301	121,569
소 계	178,602	158,479
비유동:		
기타장기종업원급여부채	72,615	71,280
장기선수금	4,900	4,900
소 계	77,515	76,180
합 계	256,117	234,659

18. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
계약손실충당부채	11,345	-	-	(822)	10,523
판매보증충당부채	3,912	-	-	(883)	3,029
소송충당부채	5,881	-	(5,881)	-	-
배출부채	46,335	17,691	-	-	64,026
합 계	67,473	17,691	(5,881)	(1,705)	77,578

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	환율변동	기 말
계약손실충당부채	7,316	429	-	-	-	7,745
판매보증충당부채	3,763	-	(25)	(216)	-	3,522
소송충당부채	9,460	-	(4,391)	-	264	5,333
배출부채	37,412	29,144	(11,902)	-	-	54,654
합 계	57,951	29,573	(16,318)	(216)	264	71,254

(2) 계약손실충당부채

당사는 당사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer 반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 충당부채로 인식하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 소송충당부채

당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(5) 배출부채

당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,606,419	1,550,464
사외적립자산의 공정가치	(1,550,358)	(1,555,045)
순확정급여부채	56,061	(4,581)
확정급여부채	56,061	-
확정급여자산(*)	-	4,581

(*) 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 4,581백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정치는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	3.78	3.78
미래임금상승률	5.55	5.55

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,550,464	1,285,003
당기근무원가	51,337	40,759
이자원가	14,425	13,646
관계사전출입액	1,663	743
퇴직급여지급액	(11,470)	(7,922)
기말장부금액	1,606,419	1,332,229

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,555,045	1,298,388
이자수익	14,456	13,777
관계사전출입액	2,479	852
퇴직급여지급액	(15,947)	(15,283)
재측정요소	(5,675)	(7,035)
기말장부금액	1,550,358	1,290,699

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	51,337	40,759
순이자원가	(31)	(131)
합 계	51,306	40,628

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,549,114	1,553,765
기타	1,244	1,280
합 계	1,550,358	1,555,045

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 8,781백만원과 6,742백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 89백만원(전분기: 44백만원)입니다.

20. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다.

21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	557,767	557,767
합 계	4,183,564	4,183,564
기타자본:		
자기주식	(2,508,427)	(2,508,427)
주식선택권	2,294	1,976
합 계	(2,506,133)	(2,506,451)
자기주식수	44,001	44,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 당사의 유통주식수는 각각 684,002천주 및 706,002천주입니다.

22. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	281,555	178,954
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	39,721,665	39,911,668
합 계	40,238,726	40,326,128

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2019년 3월 22일자 주주총회에서 배당금 1,026,003백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

23. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품의 판매	6,360,975	8,693,518
용역의 제공	59,355	52,316
합 계	6,420,330	8,745,834

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
DRAM	5,241,019	6,952,413
NAND Flash	1,026,420	1,681,377
기타	152,891	112,044
합 계	6,420,330	8,745,834

(3) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
한 시점에 이행	6,360,975	8,693,518
기간에 걸쳐 이행	59,355	52,316
합 계	6,420,330	8,745,834

(4) 수행의무와 수익인식 정책

수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 당사는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다.

고객과의 계약에서의 주요 매출 별 수행의무의 특성과 이행시기와 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.

구 분	재화나 용역의 특성, 수행의무 이행시기	기업회계기준서 제1115호 하에서 수익인식
제품의 판매	<p>제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 이 시점에 수익을 인식합니다.</p> <p>제품의 하자 등이 발생할 경우, 고객에게 반품권이 부여되어 있으며 반품된 제품은 새 제품으로 교체 또는 현금으로 환불됩니다.</p>	<p>과거 정보를 이용하여 예상되는 반품 추정치를 반영한 금액을 제품이 고객에게 이전되어 고객이 인수한 시점에 수익으로 인식하였으며, 반품부채(계약부채)와 고객에게서 제품을 회수할 기업의 권리(계약자산)에 대하여 자산이 인식되었습니다.</p> <p>반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리에 대해 인식하는 자산은 처음 측정할 때 제품의 이전 장부금액에서 그 제품 회수에 예상되는 원가를 차감한 금액으로 측정됩니다. 반품부채는 기타유동부채(주석 17 참조)에 포함되어 있고, 반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리는 기타유동자산(주석 9 참조)에 포함 되어 있습니다. 당사는 보고기간 말마다 반품될 제품에 대한 예상치의 변동을 반영하여 자산과 부채의 측정치를 새로 수정합니다.</p>

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급여	100,700	97,888
퇴직급여	10,594	7,256
복리후생비	25,571	17,644
지급수수료	99,685	51,407
감가상각비	39,177	25,247
무형자산상각비	194,642	109,558
운반보관비	3,507	2,860
송무비	7,499	3,082
임차료	259	620
세금과공과	3,006	1,576
교육훈련비	11,145	6,644
광고선전비	11,347	10,022
수도광열비	2,444	2,631
소모품비	13,577	11,081
수선비	3,985	5,251
여비교통비	2,449	2,283
판매촉진비	405	1,842
기타	4,278	12,283
소 계	534,270	369,175
경상개발비:		
연구개발비 총지출액	741,676	645,013
개발비 자산화	(89,478)	(132,545)
소 계	652,198	512,468
합 계	1,186,468	881,643

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기(*2)
제품 및 재공품의 변동	(565,297)	(307,901)
원재료 및 소모품 사용	1,853,934	1,544,363
종업원급여	746,364	714,388
감가상각 및 무형자산 상각	1,722,437	1,198,021
기술료	34,092	55,544
지급수수료	410,997	286,087
동력 및 수도광열비	263,475	214,377
수선비	197,191	171,801
외주가공비	359,049	306,806
기타	181,098	197,285
합 계(*1)	5,203,340	4,380,771

(*1) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

(*2) 전분기의 비용은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

26. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익 :		
이자수익	8,964	23,936
배당금수익	9,200	35,966
외환차이(*)	206,048	135,813
단기투자자산평가이익	13,912	835
단기투자자산처분이익	2,235	2,055
장기투자자산처분이익	-	248
합 계	240,359	198,853
금융비용 :		
이자비용	28,582	23,782
외환차이	116,470	188,205
합 계	145,052	211,987
순금융손익	95,307	(13,134)

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 62,454백만원이 포함되어 있습니다.

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	7,950	2,374
종속기업및관계기업투자처분이익	6,746	2,301
기타	1,486	862
합 계	16,182	5,537

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	20,036	4,939
무형자산처분손실	1,482	1,624
무형자산손상차손	70	3,463
매출채권처분손실	424	669
기부금	2,630	1,029
기타	7,808	2,542
합 계	32,450	14,266

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주분기순이익	944,276	3,194,653
가중평균유통보통주식수(*)	684,001,795	706,001,795
기본주당이익	1,381 원	4,525 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(44,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	684,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주희석분기순이익	944,276	3,194,653
가중평균희석유통보통주식수(*)	684,066,765	706,075,772
희석주당이익	1,380 원	4,525 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
가중평균유통보통주식수	684,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	64,970	73,977
가중평균희석유통보통주식수	684,066,765	706,075,772

30. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SK hynix America Inc.외 30사(*1)
관계기업(*2)	Stratio. Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource)
공동기업(*3)	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	당사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(*1) 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(*2) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.

(*3) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비고
에스케이하이이엔지(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이시스템(주)	당사	국내종속기업
행복모아(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이닉스시스템아이씨(주)	당사	국내종속기업
행복나래(주)	당사	국내종속기업
SK hynix America Inc.	당사	해외판매법인
SK hynix Deutschland GmbH	당사	해외판매법인
SK hynix Asia Pte. Ltd.	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	당사	해외판매법인
SK hynix U.K. Ltd.	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	당사	해외판매법인
SK hynix Japan Inc.	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	SK hynix Asia Pte. Ltd.	해외판매법인
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	당사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	SK APTECH Ltd.	해외제조법인
SK hynix Italy S.r.l	당사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions America Inc.	당사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	당사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.	당사	해외연구개발법인
SK APTECH Ltd.	당사	해외투자법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	당사	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.	에스케이하이닉스시스템아이씨(주)	해외제조법인
SK hynix happy (Wuxi) cleaning Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	행복나래(주)	해외기타법인
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	해외기타법인
SkyHigh Memory Limited	에스케이하이닉스시스템아이씨(주)	해외제조법인

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
종속기업	국내종속기업	63,910	313,337	2,821	9,200
	해외판매법인	6,345,663	72,327	399,838	-
	해외제조법인(*1)	23,131	747,376	669	-
	해외연구개발법인	23	49,861	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	125	168,500	-	-
관계기업	SK China Company Limited	-	2,281	-	-
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*2)	40	225,657	1,756	-
	SK㈜(*3)	4,196	58,455	38,271	-
	SK건설㈜	94	-	83,723	-
	SK에너지㈜	401	24,781	-	-
	SK네트웍스㈜	-	1,230	-	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	6,268	13	-
	충청에너지서비스㈜	-	10,641	-	-
	SK머티리얼즈㈜	1	16,603	-	-
	SK실트론㈜	1,195	45,958	-	-
	기타	96	100,923	3,513	-
합 계		6,438,875	1,844,198	530,604	9,200

(*1) 영업수익 등에는 자산 처분액 21,823백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금 219,200백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 20,142백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
종속기업	국내종속기업	63,090	151,652	33,148	22,500
	해외판매법인	8,473,030	50,000	859,058	-
	해외제조법인(*1)	6,855	620,124	77,799	-
	해외연구개발법인	25	52,499	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	-	148,740	-	13,120
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*2)	28	151,060	2,455	-
	SK㈜(*3)	46	41,386	45,765	-
	SK건설㈜	76	31	547,553	-
	SK에너지㈜	400	34,306	-	-
	SK네트웍스㈜	-	135	10,600	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	1,349	96	-
	충청에너지서비스㈜	-	8,583	-	-
	행복나래㈜	6	99,520	11,311	-
	SK머티리얼즈㈜	-	12,133	-	-
	SK실트론㈜	608	37,625	-	-
	기타	4	46,806	3,251	-
합 계		8,544,168	1,455,949	1,591,036	35,620

(*1) 영업수익 등에는 자산 처분액 5,636백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 8,457백만원입니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	국내종속기업	46,105	186,999
	해외판매법인	5,207,068	481,272
	해외제조법인	109,688	591,788
	해외연구개발법인	73	15,524
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	122	113,666
관계기업	SK China Company Limited	-	2,305
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	223,156
	SK(주)	1,453	134,666
	SK건설(주)	35	483,810
	SK에너지(주)	37	6,850
	SK네트웍스(주)	-	19
	에스케이씨솔믹스(주)	-	8,560
	충청에너지서비스(주)	-	3,268
	SK머티리얼즈(주)	-	11,896
	SK실트론(주)	137,431	21,499
	기타	1	69,876
합 계		5,502,013	2,355,154

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	국내종속기업	19,940	246,165
	해외판매법인	6,290,142	766,016
	해외제조법인	117,893	600,493
	해외연구개발법인	25	40,567
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	5	102,733
관계기업	SK China Company Limited	-	9,060
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	89	12,840
	SK(주)	21	138,453
	SK건설(주)	28	668,307
	SK에너지(주)	33	9,005
	SK네트웍스(주)	-	962
	에스케이씨솔믹스(주)	-	3,771
	충청에너지서비스(주)	-	3,644
	SK머티리얼즈(주)	-	16,630
	SK실트론(주)	150,246	15,960
	기타	1	91,203
합 계		6,578,423	2,725,809

(5) 주요 경영진에 대한 보상

당사는 당사의 기업활동의 계획·지휘·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급여	1,932	794
퇴직급여	102	88
주식보상비용	47	1
합 계	2,081	883

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	368	-	-

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	296	-	-

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	227

② 전기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	331

31. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 당사와 SK hynix America Inc. 등 당사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 당사 및 당사의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 중국 특허심판원의 소송 특허 무효 결정에 대한 항소를 포기하여, 동 결정은 최종적으로 확정되었습니다.

2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 1월 31일 당사가 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다.

② 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 당분기말 현재 당사는 제기된본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 당사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

④ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이센스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이센스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며,

Lump-sum royalty 지급액은 특허라이센스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

당사는 베올리아워터산업개발주 ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional ServiceCharge를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

당사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 당사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
기계장치	543,393	941,340	시설자금대출 관련

(*) 상기 담보제공자산 이외에 당사의 금융리스자산은 해당 금융리스계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	225
	매입외환 등 수출금융약정	USD	50
	수입·수출 포괄한도 약정	USD	960
	당좌차월	KRW	20,000
	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
구 분	단위	금 액	비 고
종업원	KRW	4	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)	USD	60	물품공급계약에 대한 지급보증

(*) 당사는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금 1,000백만원을 담보로 제공 받았습니다.

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 1,497,027백만원 (전기 말: 1,638,776백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정

당사는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 2017년 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 당기 중 Wafer 구매와 관련하여 사용된 선급금은 13,446백만원이며 당분기말 현재 선급금 잔액은 136,554백만원입니다. 한편, SK실트론(주)는 당사의 선급금을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)와의 약정

당사는 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)와 Wafer Foundry 공급계약을 체결하여 관련 서비스를 제공받고 있습니다. 동 회사와 업무위탁계약 및 Shared Service계약을 체결하고, 제품 생산, 장비 운영, 개발 및 경영지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

(11) Toshiba Memory Corporation(이하 'TMC') 투자

BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 'SPC1') 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 'SPC2')에 대한 투자를 통한 TMC투자와 관련하여 당사는 지분취득일 이후 일정기간 동안 당사의 직·간접적인 TMC 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 당사는 동 기간동안 TMC에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

32. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	944,276	3,194,653
조정항목:		
법인세비용	351,753	1,148,547
이자비용	28,582	23,782
이자수익	(8,964)	(23,936)
유형자산상각비	1,478,386	1,103,014
투자부동산상각비	16	26
무형자산상각비	214,913	125,471
사용권자산상각비	53,932	-
유형자산처분손실	20,036	4,939
무형자산처분손실	1,482	1,624
무형자산손상차손	70	3,463
퇴직급여	51,306	40,628
주식보상비용	318	275
외화환산손실	62,164	72,574
유형자산처분이익	(7,950)	(2,374)
외화환산이익	(110,363)	(26,379)
장기투자자산처분이익	-	(248)
종속기업및관계기업투자처분이익	(6,746)	(2,301)
단기투자자산평가이익	(13,912)	(835)
단기투자자산처분이익	(2,235)	(2,055)
배당금수익	(9,200)	(35,966)
기타	416	1,097
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	1,099,269	(211,748)
기타수취채권의 증가	(17,861)	(200)
재고자산의 증가	(629,888)	(380,411)
기타자산의 증가	(28,316)	(113,558)
매입채무의 증가(감소)	(130,067)	69,465
미지급금의 증가(감소)	(191,606)	998,815
기타지급채무의 감소	(835,116)	(601,884)
충당부채의 증가(감소)	10,124	(32,537)
기타부채의 증가	20,852	88,734
퇴직금의 지급	(2,833)	(6,713)

영업으로부터 창출된 현금	2,342,838	5,435,962
---------------	-----------	-----------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득 관련 미지급금의 증가	-	28,226
배당금 관련 미지급금의 증가	1,026,003	706,002

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
전기말	4,574,311	4,029,356
기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(*)	698,761	-
당분기초	5,273,072	4,029,356
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	-	298,732
- 차입금의 상환	(103,424)	(559,410)
- 리스부채의 상환	(53,994)	-
- 이자의 지급	(437)	-
환율변동효과	37,081	(6,542)
상각(이자비용)	4,522	389
기말	5,156,820	3,762,525

(*) 기업회계기준서 제1116호의 최초적용으로 인해 리스부채를 추가로 인식하였습니다.

33. 주식기준보상

(1) 당사는 당사가 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
6차	8,171	-	-	8,171	2019.02.28	2019.02.28 ~ 2021.02.28	2021.03.01 ~ 2024.02.29	73,430원
7차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2021.03.22	2021.03.23 ~ 2024.03.22	71,560원
8차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2022.03.22	2022.03.23 ~ 2025.03.22	77,290원
9차	61,487	-	-	61,487	2019.03.22	2019.03.22 ~ 2023.03.22	2023.03.23 ~ 2026.03.22	83,470원
합 계	506,402	-	-	506,402				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%
6차	25.60%	16,505원	1.36%	1.89%
7차	26.20%	17,744원	1.32%	1.82%
8차	26.20%	16,888원	1.32%	1.88%
9차	26.20%	16,093원	1.32%	1.91%

(3) 당사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 318백만원(전분기: 275백만원)입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 72기 1분기	제 71기	제 70기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	209,498	840,491	1,207,464
지역간내부매출액	6,764,631	40,666,094	29,311,067
계	6,974,129	41,506,585	30,518,531
2. 영업이익	1,236,300	20,664,349	13,366,065
3. 자산	61,852,203	61,908,282	44,910,780
중국			
1. 매출액			
외부매출액	3,158,068	15,785,993	10,074,686
지역간내부매출액	831,399	2,976,991	2,555,178
계	3,989,467	18,762,984	12,629,864
2. 영업이익	50,876	247,617	146,098
3. 자산	11,445,117	9,421,189	6,338,929
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	958,288	7,559,667	6,201,365
지역간내부매출액	4,466	19,953	21,078
계	962,754	7,579,620	6,222,443
2. 영업이익	14,062	14,290	14,239
3. 자산	1,486,999	2,291,212	1,847,516
미국			
1. 매출액			
외부매출액	2,097,673	14,278,161	11,063,504
지역간내부매출액	55,972	162,402	158,153
계	2,153,644	14,440,562	11,221,657
2. 영업이익	(16,379)	52,471	52,994

3. 자산	2,421,200	3,129,593	2,619,480
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	349,129	1,980,753	1,562,416
지역간내부매출액	13,732	60,867	19,660
계	362,861	2,041,621	1,582,076
2. 영업이익	(3,060)	4,298	5,393
3. 자산	452,205	648,464	442,627
합계			
1. 매출액			
외부매출액	6,772,655	40,445,066	30,109,434
지역간내부매출액	7,670,199	43,886,307	32,065,137
계	14,442,854	84,331,373	62,174,571
2. 영업이익			
연결조정	84,691	(139,274)	136,537
계	1,366,490	20,843,750	13,721,326
3. 자산			
연결조정	(12,526,223)	(13,740,405)	(10,740,868)
계	65,131,501	63,658,335	45,418,464

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제72기 1분기	매출채권	5,496,861	48	0.00%
	장·단기 대여금	36,013	0	0.00%
	장·단기 미수금	26,871	1,324	4.93%
	장·단기 미수수익	8,057	0	0.00%
	장·단기 보증금	67,544	102	0.15%
	장기성 외상매출금	0	0	0
	장단기성 예치금	1,256	1,033	82.23%
	계	5,636,602	2,507	0.04%
제71기 연간	매출채권	6,320,042	48	0.00%
	장·단기 대여금	32,931	0	0.00%
	장·단기 미수금	9,842	1,323	13.44%
	장·단기 미수수익	3,899	0	0.00%
	장·단기 보증금	41,439	102	0.25%

	장기성 외상매출금	0	0	0
	장단기성 예치금	1,235	1,015	82.23%
	계	6,409,388	2,488	0.04%
제70기 연간	매출채권	5,552,841	46	0.00%
	장·단기 대여금	13,984	0	0.00%
	장·단기 미수금	12,199	1,327	10.88%
	장·단기 미수수익	22,308	0	0.00%
	장·단기 보증금	32,814	102	0.31%
	장기성 외상매출금	0	0	0
	장단기성 예치금	1,132	985	87.00%
	계	5,635,278	2,460	0.04%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제72기 1분기	제71기	제70기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	2,488	2,460	4,684
2. 순대손처리액(①-②±③)	0	0	0
① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0
② 상각채권 회수액	0	0	0
③ 기타증감액	0	0	0
3. 대손상각비 계상(환입)액	19	28	(2,224)
4. 기말 대손충당금 잔액 합계	2,507	2,488	2,460

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준
매출채권	1)정상채권 -과거 경험율을 바탕으로 설정
	2)장기채권 -거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	5,399,137	0	0	4	5,399,142
	특수관계자	97,719	0	0	0	97,719
	계	5,496,857	0	0	4	5,496,861
구성비율		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제72기 1분기	제71기	제70기	비고
반도체	상 품	1,745	1,634	433,405	-
	제 품	1,877,291	1,404,439	433,405	-
	재 공 품	2,220,251	2,118,981	1,616,889	-
	원 재 료	485,452	461,542	296,252	-
	저 장 품	470,136	415,879	270,804	-
	미 착 품	62,616	20,258	23,089	-
	합 계	5,117,491	4,422,733	2,640,439	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계*100]		7.9%	6.9%	5.8%	-
재고자산회전율{회수} [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.4회	4.3회	5.4회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
원부자재	2019-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
제품			-
제품	2018-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2017-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2019년 1분기말 현재 연결기준 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고
상 품	1,756	1,756	11	1,745	-
제 품	2,295,121	2,295,121	417,830	1,877,291	-
재 공 품	2,536,633	2,536,633	316,382	2,220,251	-
원 재 료	520,057	520,057	34,605	485,452	-
저 장 품	490,382	490,382	20,246	470,136	-
미 착 품	62,616	62,616		62,616	-
합 계	5,906,565	5,906,564	789,074	5,117,491	-

라. 공정가치

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

(2) 공정가치 평가내역

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	5,070,776	-	5,070,776	-	5,070,776
장기투자자산	4,418,533	-	-	4,418,533	4,418,533
소 계	9,489,309	-	5,070,776	4,418,533	9,489,309
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	1,152,257	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	968,669	-	-	-	-
매출채권(*1)	5,496,813	-	-	-	-

기타수취채권(*1)	137,282	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	1,950	-	-	-	-
소 계	7,756,971	-	-	-	-
금융자산 합계	17,246,280	-	5,070,776	4,418,533	9,489,309
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	952,620	-	-	-	-
미지급금(*1)	5,427,403	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	983,088	-	-	-	-
차입금	6,147,013	-	6,176,123	-	6,176,123
금융부채 합계	13,510,124	-	6,176,123	-	6,176,123

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	5,496,452	-	5,496,452	-	5,496,452
장기투자자산	4,325,550	-	-	4,325,550	4,325,550
소 계	9,822,002	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	2,349,319	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	523,579	-	-	-	-
매출채권(*1)	6,319,994	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	86,906	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	310	-	-	-	-
소 계	9,280,108	-	-	-	-
금융자산 합계	19,102,110	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,096,380	-	-	-	-
미지급금(*1)	3,681,933	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,894,751	-	-	-	-
차입금(*2)	5,281,937	-	5,300,120	-	5,300,120
금융부채 합계	11,955,001	-	5,300,120	-	5,300,120

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	평가손익	환율변동	당분기말
장기투자자산	4,325,550	29,251	(170)	(13)	63,915	4,418,533

마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A(한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 03월 14일	300,000	3.01	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	250,000	2.48	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	90,000	2.67	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 08월 27일	미상환	케이비증권
합 계	-	-	-	2,060,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(2.19%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제215-2회 무보증원화 공모사 채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리 팀 (02-3770-8556)
제215-3회 무보증원화 공모사 채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리 팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(2.19%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제216-2회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(2.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(2.19%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제218회 무보증원화 공모사채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

(이행현황기준일(지배구조변경제한) : 2019년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하
	이행현황	이행(2.19%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

	이행현황	이행(0.31%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 만기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)
제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일)

(이행현황기준일(지배구조변경제한) : 2019년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(33.55%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행(2.19%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.31%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.23 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 만기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	합 계	발행 한도	잔여 한도
------	--------	-------	-------	-------	--------	-----	-------	-------

			30일이하	90일이하	180일이하	1년이하			
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	490,000	150,000	530,000	250,000	90,000	-	1,510,000
	사모	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000
	합계	450,000	490,000	150,000	530,000	250,000	90,000	-	1,960,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목은 기재하지 않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제72기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-
제71기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제70기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

※ 상기 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제72기 1분기(당기)	삼정회계법인	분반기검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타감사업무	950	2,307
제71기(전기)	삼정회계법인	분반기검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타감사업무	950	11,967
제70기(전전기)	삼정회계법인	분반기검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타감사업무	950	10,644

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제72기 1분기(당기)	-	해당사항없음	-	-	-
	-	해당사항없음	-	-	-
제71기(전기)	2018.05.24	이전가격 문서화 용역	2018.05~2018.12	145	-
	2018.02.27	지속경영 프로그램 자문 용역	2018.02~2018.07	300	-
제70기(전전기)	2017.08.03	이전가격 문서화 용역	2017.08~2018.12	150	-
	2017.07.19	지속경영 프로그램 자문 용역	2017.07~2017.08	100	-

2. 회계 감사인의 변경

☞ 해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 6인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회 3개의 소위원회가 있습니다.

경영투명성을 제고하기 위해 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였으며, 2019년 3월 27일 이사회를 개최하여 이사회 의장으로 박정호 기타비상무이사를 선임하였습니다.

(1) 이사회에 관한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

(1) 주주총회에 부의할 의안

- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)
- (5)<삭제 2012.3.5>
- (6) 해외증권의 발행
- (7) <삭제1999.4.9>
- (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지
- (9)<삭제 2012.3.5>
- (10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위
단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함
- 가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래
- (11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정
- (12) 10억원 이상의 기부. 단, 지속경영 및 사회적 가치 창출 등에 대해 전문적으로 심의하는 위원회가 있는 경우 해당 위원회에서 사전 심의함. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

[2019년 3월 31일]

성 명	주 요 경 력	비 고
최 종 원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	2017. 3. 24 재선임
신 창 환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 자이링스(Xilinx) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	2017. 3. 24 선임

송호근	<p>서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)</p>	2018. 3. 28 선임
조현재	<p>한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)</p>	2018. 3. 28 선임
윤태화	<p>연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現) 국세청 대표시민감사관 (現) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)</p>	2018. 3. 28 선임
하영구	<p>서울대 국제경제학 미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사 한국씨티은행 기획부 심사역 / 자금담당 총괄이사 한국투자금융 / 기업금융 / 소비자금융그룹 대표 한미은행장 한국씨티은행장 전국은행연합회장 금융개혁협의회 위원 김·장 법률사무소 고문 (現)</p>	2019. 3. 22 선임

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	
위 임	-다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 - 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.	
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)	

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석						사내이사(기타비상무이사 포함) 참석			
				최종원 (출석률 :100%)	신정환 (출석률 :100%)	송호근 (출석률 :100%)	조현재 (출석률 :100%)	윤태화 (출석률 :100%)	하영구 (출석률 :100%)	박성욱 (출석률 :100%)	박정호 (출석률 :75%)	이석희 (출석률 :100%)	오종훈 (출석률 :100%)
1	'19.01.23	1. 제71기(2018년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음
		2. 제71기(2018년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음
		3. 전자투표제 도입(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음
		4. 2019년 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음
2	'19.02.28	1. 주식매수선택권 부여 및 부여방법 변경(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참	찬성	해당없음
		2. 제71기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참	찬성	해당없음
		3. 스마트 에너지센터 건설 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참	찬성	해당없음
3	'19.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		2. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		3. SK텔레콤 등과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		4. SK에너지와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
4	'19.04.24	1. 2019년 사채 발행 위임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		2. SUPEX추구협의회 협약서 당사자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		3. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		4. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		4-1. SUPEX추구협의회 운영비용 분담	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		4-2. IT시스템 개선 및 개발	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

※ 하영구 사외이사, 오종훈 사내이사의 경우, 제 71기 정기 주주총회('19.03.22)에서 신규 선임됨.

※ 박성욱 부회장의 경우, '19.03.22일부로 사내이사직에서 사임함.

※ 사내이사 참석 구분에 기타비상무이사인 박정호 이사를 포함함.

이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사	이사	결의일자	거래 내역
SK텔레콤 등	박정호	2019년 3월 27일	AI 기반 Image Processing 시스템 및 IT통합 운영시스템 구축, 청년 희망 나눔 프로그램 운영
		2019년 4월 24일	SUPEX 추구협의회 관련 운영비용 거래

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

[2019년 3월 31일]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 3명	최종원(위원장) 윤대화 신창환	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보추천위원회	사외이사 2명	최종원(위원장) 조현재	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-
지속경영위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	송호근(위원장) 조현재 이석희	[권한] 1. 10억원 이상의 기부 심의. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음 2. 회사의 지속가능경영과 관련한 다음 사항들에 대한 심의 (1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과 (2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동 (3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응 (4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

(다) 지속경영위원회

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석		사내이사 참석
			송호근 (출석률: 100%)	조현재 (출석률: 100%)	이석희 (출석률: 0%)
			찬 반 여부		
'19.03.11	1. ECO Alliance 추진 계획	보고	-	-	불참

	2. 청년희망나눔 2019년 추진 계획	보고	-	-	불참
	3. 그룹 사회공헌 기부금 출연(안)	보고	-	-	불참
	4. 핸드볼 발전재단 출연(안)	보고	-	-	불참

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 사외이사 회의를 주재하고 사외이사들의 의견을 집약하기 위하여 선임사외이사를 선임하였습니다.

(1) 이사의 인적 사항

[2019년 3월 31일]

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래내역	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고
이석희 (1965.06.23)	Intel KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장 / 부사장 SK하이닉스 사업총괄 사장 SK하이닉스 대표이사 사장 (現)	이사회	전사 경영전반 총괄	없음	-	지속경영위원회 위원
박 정 호 (1963.05.17)	SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사 / 사장 SK(주) 대표이사 / 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 / 사장 (現) SK하이닉스 이사회 의장 (現)	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	(주1)	최대주주의 임원 (SK텔레콤)	이사회 의장
오종훈 (1964.08.20)	현대전자 SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄 SK하이닉스 DRAM 상품기획실장 SK하이닉스 DRAM 제품본부장 SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당 SK하이닉스 GSM담당 부사장 (現)	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	-	-
최 종 원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	-	감사위원회 위원/ 사외이사후보추천위원회 위원/ 선임사외이사

<p>신창환 (1979.11.23)</p>	<p>고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 자이링스(Xilinx) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)</p>	<p>사외이사후보추천위원회</p>	<p>전사 경영전반에 대한 업무</p>	<p>없음</p>	<p>-</p>	<p>감사위원회 위원</p>
<p>송호근 (1956.01.04)</p>	<p>서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)</p>	<p>사외이사후보추천위원회</p>	<p>전사 경영전반에 대한 업무</p>	<p>없음</p>	<p>-</p>	<p>지속경영위원회 위원</p>
<p>조현재 (1958.01.21)</p>	<p>한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)</p>	<p>사외이사후보추천위원회</p>	<p>전사 경영전반에 대한 업무</p>	<p>없음</p>	<p>-</p>	<p>지속경영위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원</p>
<p>윤대화 (1960.10.27)</p>	<p>연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現) 국세청 대표시민감사관 (現) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)</p>	<p>사외이사후보추천위원회</p>	<p>전사 경영전반에 대한 업무</p>	<p>없음</p>	<p>-</p>	<p>감사위원회 위원</p>

하영구 (1953.11.26)	서울대 국제경제학 미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사 한국씨티은행 기획부 심사역 / 자금담당 총괄이사 한국투자금융 / 기업금융 / 소비자금융그룹 대표 한미은행장 한국씨티은행장 전국은행연합회장 금융개혁협의회 위원 김·장 법률사무소 고문 (現)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	-	-
---------------------	---	-------------	-------------------	----	---	---

(주1) 박정호 이사의 회사와의 거래내역 상세 내용은 상기 "나. 중요의결사항 등" 참조

성명	선임 배경
최종원	서울대학교 행정대학원 교수로서 동 대학 행정대학원장과 KDI 연구위원, 공정거래위원회 비상임위원 및 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 등을 역임한 경제 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단
신창환	서울시립대학교 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대 기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
송호근	서울대학교 사회과학대 교수 및 동 대학 석좌교수로서 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한 사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단
조현재	매일경제신문 편집국장, 매일경제TV 대표이사과 MBN 대표이사를 역임한 경제 및 산업전문가로, 오랜 기간 언론계 활동을 통해 정치, 경제, 산업, 국제정세 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
윤태화	현재 가천대학교 경영대학 학장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안건 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 비상임감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단
하영구	한미은행장, 한국씨티은행장, 금융개혁협의회 위원, 전국은행연합회 회장 등을 역임한 최고 금융 전문가이며 국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[2019년 3월 31일]

성명	사외이사 여부	비고
최종원	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
조현재	○	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		사내이사의 성명
			최종원 (출석률: 100%)	조현재 (출석률: 100%)	박성욱 (출석률: 100%)
			찬반여부		
'19.02.25	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2. 제71기 정기주주총회에 대한 사외이사후보 추천(안)	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
이사회사무국	구성원 3명 (팀장 1명 포함)	TL 3명(17년)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2019년 03월 18일	사외	신창환	특정 사외이사에 대한 교육(대표로 참석)	Semicon China 2019 심포지엄
2019년 04월 16일	이사회사무국	하영구	신임 사외이사에 대한 교육	2019년 신임 사외이사에 대한 교육
2019년 04월 10일	삼성KPMG	최종원 윤태화 신창환	-	-결산시 회계관련 유의사항 -내부회계관리제도 감사 -감사의 계획수립과 수행에 있어서의 중요성 개념
2019년 05월 14일	삼성KPMG	윤태화	특정 사외이사에 대한 교육(대표로 참석)	제5회 삼성KPMG ACI 세미나 -新외부감사법 도입 원년 감사위원회의 과제와 역할 수행방안

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 3인(최종원, 신창환, 윤태화)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기위원회(매분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[2019년 3월 31일]

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고
최 종 원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	해당사항 없음	-
신 창 환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 자이링스(Xilinx) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	해당사항 없음	-
윤 태 화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現) 국세청 대표시민감사관 (現) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

- ③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
- ④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무·재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령
- (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
- (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

- ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
- ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

- ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치 운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
- ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회사	일자	의 안	가결여부	사외이사의 성명		
				최종원 (출석률 :100%)	신창환 (출석률 :100%)	윤태화 (출석률 :100%)
				찬반여부		

1	'19.01.22	1. '18년 내부회계관리제도 설계/운영 실태 평가 보고	보고	-	-	-
		2. '18년 4분기 윤리경영실적 및 '19년 업무 계획	보고	-	-	-
2	'19.02.25	1. 2018년 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-
		2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성
3	'19.03.13	1. 제71기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		3. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성
4	'19.03.25	1. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성
5	'19.04.22	1. 2019년 1분기 윤리경영 실적	보고	-	-	-
		2. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성

[감사위원회 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2019년 04월 10일	삼정KPMG	최종원, 윤태화, 신창환	-	-결산시 회계관련 유의사항 -내부회계관리제도 감사 -감사의 계획수립과 수행에 있어서의 중요성 개념
2019년 05월 14일	삼정KPMG	윤태화	특정 사외이사에 대한 교육 (대표로 참석)	제5회 삼정KPMG ACI 세미나 -新외부감사법 도입 원년 감사위원회의 과제와 역할 수행방안

당사 감사위원회는 매 분기 업무감사 관련 업무 결과 및 현황에 대한 보고를 받고 있으며, 외부감사인과의 반기 1 회 회사의 개입 없이 별도의 만남의 장을 마련하고 있습니다.

[감사위원에 대한 교육실시 계획]

당사 감사위원회는 외부감사인으로부터 전년도 회계연도 회계감사 결과(2월)와 외부회계감사 업무 수행 계획(7월)을 보고 받고 있습니다. 또한 올해 4월에 외부감사인과의 별도 미팅을 가졌으며, 6월과 10월에도 미팅을 계획하고 있습니다.

그리고, 매년 정기적으로 워크숍을 통해 회사경영에 대한 이해도를 제고하고 그 역할에 충실할 수 있도록 회의 외에 다양한 프로그램을 마련하여 활동을 지원 할 예정입니다.

[감사위원회 지원조직 현황]

당사는 감사위원회의 업무 수행을 보좌하기 위한 공식적인 내부감사부서를 설치 및 운영하지 않고 있지는 않습니다. 단, 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행 지원을 위해 내부감사부서로서 「윤리경영담당」 산하 윤리경영/경영진단 조직을 통해 매 분기 감사 결과 및 계획 등을 보고 받고 있으며, 이에 대한 의견을 개진하고 있습니다.

[감사위원회 위원의 회계/재무 전문가 여부]

윤태화 이사	공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험 보유
--------	---

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구 분	상 세
성 명	신승국 (전무)
생 년 월 일	1962년 11월 3일
학 력 사 항	- 연세대학교 대학원 상법학 석사 (1985년~1987년) - 미국 밴더빌트대 법과대학원 법학박사 (J.D.)
주 요 경 력	- 2017년 1월~ : SK하이닉스 지속경영담당(現) - 2014년 1월~ : SK하이닉스 대외협력본부장 - 2006년 2월~ : SK에너지 법무실장 / CR전략실장 - 2000년 8월~ : SK텔레콤 법무팀장 / 법무실장 - 1988년 7월~ : SK(舊유공) 법제부 입사
주 요 자 격	- 미국 뉴욕주 변호사

-준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무담당	32	임원 1명(22년) TL 31명(평균 4년 8개월)	준법 업무 지원

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다.

당사는 2019년 1월 23일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 개최한 제71기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지분 인수
이석희	특수관계인	보통주	42	0.00	42	0.00	-
박정호	특수관계인	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
계		보통주	146,101,132	20.07	146,101,132	20.07	-
		우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 상세

(1) 최대주주 및 지분율

당사의 최대주주는 SK텔레콤주식회사(영문명 : SK Telecom Co., Ltd.)이며, 그 지분율은 146,100,000주(20.07%)로서 특수관계인을 포함하여 146,101,132주(지분율 20.07%)입니다.

(2) 최대주주의 기본 정보

1) 대표자

(2019년 3월 31일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
박정호	대표이사/사장	상근	1963년

2) 기본정보

(2019년 3월 31일 기준)

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK텔레콤 주식회사	52,961	박정호	0.00	-	-	SK(주)	26.78
		-	-	-	-	-	-

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	박정호	-	-	-	-	-
2017.03.28	박정호	0.00	-	-	-	-
2017.03.30	박정호	0.00	-	-	-	-

※ 박정호 대표이사는 '17년 3월 24일 주주총회 및 이사회를 통해 대표이사로 선임되었으며, '17년 3월 28일과 30일 각각 500주의 주식을 취득함

(4) 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황 (2019년 3월 31일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK텔레콤주식회사
자산총계	43,346,481
부채총계	21,227,364
자본총계	22,119,117
매출액	4,334,906
영업이익	322,572
당기순이익	373,631

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 1984년 3월 19일에 한국이동통신서비스주식회사로 설립되었으며, 1989년 10월 유가증권시장에 최초 상장되었습니다. 이후 1997년 1월 선경그룹 계열사로 편입되었으며, 이후 3월에 SK텔레콤(주)로 사명이 변경되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (가) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (나) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (다) 커머스사업, (라) 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업입니다.

(6). 최대주주의 최대주주 관련 사항

(가) 최대주주의 최대주주 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주는 에스케이 주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며 기본정보 등은 아래와 같습니다.

1) 기본정보

구분	내용	비고
----	----	----

설립일	1991년 4월 13일	-
주소	서울특별시 종로구 종로 26	-
전화번호	02-2121-5114	-
홈페이지	www.sk.co.kr	-
연결실체 내 종속기업수	269개사	국내 75, 해외 194

※ 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK주식회사로 변경하였습니다.

2) 주권상장(또는 등록·지정)여부

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	종목코드	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	2009년 11월 11일	034730	-	-

3) 국내 상장 종속회사수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부	회사명	법인등록번호
상장사(11)	SK(주)	110111-0769583
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SKC(주)	130111-0001585
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	AJ렌터카(주)	110111-0577233
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	(주)드림어스컴퍼니	110111-1637383

※ SK(주), SK이노베이션(주), SK텔레콤(주), SK네트웍스(주), SKC(주), (주)부산도시가스, AJ렌터카(주) 이상 7개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈(주), SKC솔믹스(주), SK바이오랜드(주), (주)드림어스컴퍼니(舊, (주)아이리버) 이상 4개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다.

(나) 최대주주의 최대주주 지분율 (2019년 3월 31일 기준)

당사 최대주주의 최대주주 지분율은 26.78%(21,624,120주)입니다.

(다) 최대주주의 최대주주 대표자

(2019년 3월 31일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사 회장	상근	1960년

장동현	대표이사 사장	상근	1963년
-----	---------	----	-------

(라) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 기본정보

(2019년 3월 31일 기준)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	21,043	최태원	18.44	-	-	최태원	18.44
		장동현	-	-	-	-	-

※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

※ 출자자수는 제28차 정기주주총회(2019.3.27)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018.12.31) 기준 보통주 주주수임

(마) 최대주주(법인 또는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2018년 10월 24일	-	-	-	-	최태원	23.40% → 23.12%
2018년 11월 21일	-	-	-	-	최태원	23.12% → 18.44%

※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음.

- 공시대상기간 중 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 지분율 변동 세부내역

(단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
2018년 10월 24일	최태원	16,265,472	23.12%	증여(△200,000) : 최종현학술원
2018년 11월 21일	최태원	12,975,472	18.44%	증여(△3,290,000) : 최재원외 17명

※ 상기 지분율은 보통주 기준임,

※ 상기 2018년 10월 24일 및 11월 21일의 변동내역은 모두 특별관계자 대상 증여임

(바) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 최근 결산기 재무현황

당사 최대주주의 최대주주인 SK주식회사의 제29기 1분기 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK주식회사
자산총계	128,450,741

부채총계	75,719,652
자본총계	52,731,089
매출액	25,549,309
영업이익	1,285,421
당기순이익	981,457

※ SK주의 2019년 1분기 연결 재무제표 기준

1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제29기 1분기 (2019.3.31)
[유동자산]	41,208,319
현금및현금성자산	9,363,026
재고자산	8,833,408
기타의유동자산	23,011,885
[비유동자산]	87,242,422
관계기업및공동기업투자	19,835,263
유형자산	40,853,709
무형자산 및 영업권	16,226,016
기타의비유동자산	10,327,434
자산총계	128,450,741
[유동부채]	33,745,800
[비유동부채]	41,973,852
부채총계	75,719,652
[지배기업소유주지분]	17,354,614
자본금	15,385
기타불입자본	5,010,101
이익잉여금	12,412,849
기타자본구성요소	(83,721)
[비지배지분]	35,376,475
자본총계	52,731,089
부채와자본총계	128,450,741
연결에 포함된 회사 수	269
	제29기 1분기 (2019.01.01~2019.03.31)
I. 매출액	25,549,309
II. 영업이익	1,285,421
III. 법인세비용차감전계속영업순이익	1,296,879
IV. 계속영업연결당기순이익	986,177

V. 연결당기순이익	981,457
지배기업소유주지분순이익	460,401
비지배지분순이익	521,056
VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익	
기본주당이익	8,237원
기본주당계속영업이익	8,271원

2) 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제29기 1분기 (2019.3.31)
[유동자산]	1,202,270
현금및현금성자산	105,746
기타유동자산	1,096,524
[비유동자산]	21,099,985
종속기업및관계기업투자	17,704,544
유형자산	476,175
무형자산및영업권	2,107,622
기타비유동자산	811,644
자산총계	22,302,255
[유동부채]	2,562,845
[비유동부채]	5,749,896
부채총계	8,312,741
자본금	15,385
기타불입자본	4,411,635
이익잉여금	9,564,523
기타자본구성요소	(2,029)
자본총계	13,989,514
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법
부채와자본총계	22,302,255
	제29기 1분기 (2019.01.01~2019.03.31)
I. 매출액	1,502,773
II. 영업이익	1,119,487
III. 법인세비용차감전계속영업이익	1,074,298
IV. 계속영업당기순이익	1,045,112
V. 당기순이익	1,045,112
VI. 기타포괄손익	(3,779)

VII. 총포괄이익	1,041,333
VIII. 주당이익	
보통주기본주당이익	18,711원
보통주기본주당계속영업이익	18,711원

(사) 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

(아) 사업현황

당사 최대주주의 최대주주인 SK주식회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 보고서 작성일 현재 SK주식회사가 영위하고 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

최대주주의 최대주주인 SK주식회사가 영위하는 목적사업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배 · 경영지도 · 정리 · 육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
- 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
- 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
9. 의약 및 생명과학 관련 사업
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 · 판매 및 설비 · 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업
14. 회사가 보유하고 있는 지식 · 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도 · 소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기계·장비 제조업 및 임대업 <2017.3.24 신설>
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산 · 판매 및 유통 · 컨설팅 · 교육 · 수출입 등 제반 사업 일체

또한 SK주식회사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사 및 각 사가 영위하는 주요사업의 내용은 아래와 같습니다

구 분	주요 목적사업
SK이노베이션(주)	지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업
SK텔레콤(주)	정보통신사업
SK네트웍스(주)	상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
SKC(주)	화학사업 및 Industry소재산업
SK건설(주)	인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업
SK E&S(주)	가스사 소유 및 복합화력발전 사업
SK바이오팜(주)	신약개발사업
SK바이오텍(주)	의약품 중간체 제조업
SK머티리얼즈(주)	특수가스 생산 및 판매업
SK 실트론(주)	전자산업용 규소박판 제조업
SK임업(주)	조림사업, 조경사업, 복합임업사업
SK China Company, Ltd.	컨설팅 및 투자업

(자) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부
- 해당사항 없음

(차) 최대주주의 최대주주 관련 사항

성 명	학 력	직 위	기 간	경력사항
최태원	고려대학교 물리학과 졸업 (1983) 미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)	대표이사 회장 (등기임원)	2016.3.18 ~ 현재	SK주식회사 대표이사 회장
			2015.8 ~ 2016.3.18	SK주식회사 회장
			2012.2 ~ 현재	SK하이닉스 주식회사 회장
			2007.7 ~ 현재	SK이노베이션 주식회사 회장
			1997.12 ~ 2015.7	(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등 기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 등 기이사 및 대표이사로 재선임 되었음

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변 동함.	-
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변 동함.	-
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각	-
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도	-

2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도	-
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각	-
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도	-
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도	-
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도	-
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도	-
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도	-
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수	-
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가	-
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자 추가	-
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가	-
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가	-
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수	-
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가	-
2015년 02월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	장내 매수	-
2016년 03월 28일	에스케이텔레콤(주)	146,127,532	20.07	특별관계자 추가	-
2017년 03월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,122,574	20.07	특별관계자 제외 및 추가	-
2017년 07월 05일	에스케이텔레콤(주)	146,111,574	20.07	특별관계자 제외	-
2017년 08월 30일	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	특별관계자 제외	-
2019년 03월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,101,132	20.07	특별관계자 제외	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3차배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특수관계인의 보유주식 1,132주를 합산한 것임.

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식 소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,101,132	20.07	(주1)
	국민연금공단	65,890,385	9.05	-
	블랙록 펀드 어드바이저스	37,011,690	5.08	(주2)
	더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크.	57,141,278	7.85	(주3)
우리사주조합		-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3차배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특수관계인의 보유주식 1,132주를 합산한 것임.(최대주주인 에스케이텔레콤(주)이 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함.)

(주2) 블랙록 펀드 어드바이저스 보유지분은 2018년 05월 14일 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)'을 참고하였음.

(주3) 더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크. 는 2019년 03월 06일 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)'을 참고하였음.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	

소액주주	309,676	99.99	422,650,910	58.05	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주
------	---------	-------	-------------	-------	-----------------------------------

※ 소액주주 현황은 2018년말 기준 주주명부의 개별 주주번호 기준으로 1% 미만의 주주를 모두 포함하여 기재함

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조 (주식의 발행 및 배정) < 개정 2017.3.24 ></p> <p>① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.</p> <p>1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함.</p> <p>가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>라. 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p> <p>2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식에 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음</p>
------------------	---

	<p>할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.</p>		
결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	<p>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(2019년 9월 시행 예정)을 반영하여, 2019년 3월 22일 제71기 정기주주총회에서 주권의 종류와 관련된 당사 정관(제9조)을 아래와 같이 변경하였습니다.</p> <p>- 기존 : 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.</p> <p>- 변경 : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>		
명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2019.03.22>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종 류		'19년 3월	'19년 2월	'19년 1월	'18년 12월	'18년 11월	'18년 10월
보통주	최고주가	76,100	77,400	75,900	70,500	74,500	73,700
	최저주가	66,600	70,000	57,700	58,600	67,500	64,700
	평균주가	70,150	75,018	65,882	63,642	70,705	69,486
거래량	최고일거래량	10,030,131	7,869,451	7,163,871	5,618	5,334	6,211
	최저일거래량	2,158,588	1,462,071	1,934,295	1,647	1,499	2,212
	월간거래량	3,721,661	3,209,845	3,824,554	3,157	3,078	4,192

※ 주가는 일별 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 록셈부르그]

(단위 : USD, DR)

종 류			'19년 3월	'19년 2월	'19년 1월	'18년 12월	'18년 11월	'18년 10월
주가 (종가 기준)	최고	USD	67.0	68.5	68.0	63.5	65.5	66.5
		원화환산	76,179	76,994	75,684	70,866	73,491	75,843
	최저	USD	58.5	62.0	51.0	52.0	60.0	57.0

		원화환산	66,515	69,688	56,763	58,032	67,320	65,009
거래량	최고(일)		-	-	-	86	-	-
	최저(일)		-	-	-	-	-	-
	월간평균		-	-	-	5	-	-
환율			1,137.00	1,124.00	1,113.00	1,116.00	1,122.00	1,140.50

※ 환율의 경우 매월 말 고시기준율을 기준으로 하였음

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
이석희	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	대표이사 지속경영위원회 위원	스탠퍼드대 대학원 재료공학 박사 Intel KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 / 전무 SK하이닉스 DRAM개발부문장 / 부사장 SK하이닉스 사업총괄 / 사장	42	-	-	선임(17.03.24)	-
박정호	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	이사회 의장	조지워싱턴대 대학원 경영학 석사 SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사 / 사장 SK(주) 대표이사 / 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 / 사장 (現)	1,090	-	계열회사 임원 (SK텔레콤)	선임(17.03.24)	-
오종훈	남	1964년 08월	부사장	등기임원	상근	마케팅/영업 총괄	서울대 전자공학 현대전자 SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄 SK하이닉스 DRAM 상품기획실장 SK하이닉스 DRAM 제품본부장 SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당	-	-	-	선임(19.03.22)	-
최종원	남	1958년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천 위원회 위원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	-	-	-	선임(14.03.21) 중임(17.03.24)	-
신창환	남	1979년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 자이링스(Xilinx) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	-	-	-	선임(17.03.24)	-

송호근	남	1956년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회 위원	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 포스코정알재단 감사위원 (現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)	-	-	-	선임(18.03.28)	-
조현재	남	1958년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위 원	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	-	-	-	선임(18.03.28)	-
윤태화	남	1960년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現) 국세청 대표시민감사관 (現) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	-	-	-	선임(18.03.28)	-
하영구	남	1953년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 국제경제학 미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사 한국씨티은행 기획부 심사역 / 자금담당 총괄이사 한국투자금융 / 기업금융 / 소비자금융그룹 대표 한미은행장 한국씨티은행장 전국은행연합회장 금융개혁협의회 위원 김·장 법률사무소 고문 (現)	-	-	-	선임(19.03.22)	-

※ 임기 만료일은 취임 후 개폐되는 제3차 정기주주총회 종료시임.

※ 당사 등기임원의 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항의 특수관계인(계열회사 임원)에 해당하나 기재 생략하였음.

(2) 등기임원의 겸직 현황
[기준일: 2019년 3월 31일]

겸직임원		겸직회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	
이 석 희	대표이사	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	대표이사	-
		SK hynix memory solutions America Inc.	이사	-
		SK China Company Ltd.	이사	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이사	-
박 정 호	기타비상무이사	SK텔레콤	대표이사	-
		SK브로드밴드	대표이사	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이사	-
최 중 원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-
하 영 구	사외이사	미래에셋자산운용(주)	사외이사	-

(3) 미등기 임원 현황

(가) 미등기 임원
[기준일: 2019년 3월 31일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	담당업무	약력	최대주주와의 관계	재직기간
회장 (상근)	미등기임원	최태원	남	1960.12	회장	Univ. of Chicago 회장	계열회사 임원 (SK(주))	
부회장 (상근)	미등기임원	박성욱	남	1958.01	미래기술&성장 담당임원	한국과학기술원 미래기술&성장 담당임원	-	
사장 (상근)	미등기임원	김동섭	남	1963.01	대외협력총괄	서울대 대외협력총괄	-	9개월
사장 (상근)	미등기임원	정태성	남	1960.11	NAND개발사업총괄	Univ. of Wisconsin - Madison NAND사업총괄	-	29개월
부사장 (상근)	미등기임원	Tony Yoon	남	1963.04	NAND개발사업총괄 담당임원	UC Berkeley NAND개발사업총괄 담당임원	-	47개월
부사장 (상근)	미등기임원	김진국	남	1964.07	미래기술연구원 담당	연세대 미래기술연구원 담당	-	
부사장 (상근)	미등기임원	송현중	남	1965.11	미래기술&성장 담당임원	Massachusetts Institute of Technology 마케팅/영업 담당	-	
부사장 (상근)	미등기임원	오종훈	남	1964.08	GSM 담당	서울대 DRAM개발사업 담당	-	
부사장 (상근)	미등기임원	이상선	남	1961.09	제조/기술 담당	고려대 제조/기술 담당	-	
부사장 (상근)	미등기임원	차진석	남	1963.04	재무/구매 담당임원	University of Michigan 재무/구매 담당임원	-	5개월
부사장 (상근)	미등기임원	진교원	남	1962.09	DRAM개발사업 담당	서울대 품질보증 담당	-	

부사장 (상근)	미등기임원	현순엽	남	1963.10	기업문화 담당	서울대 기업문화 담당	-	
부사장 (상근)	미등기임원	홍성주	남	1962.11	CIS Business 담당	한국과학기술원 CIS Business 담당	-	
전무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	1965.11	제조/기술 담당임원	고려대 제조/기술 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	권원택	남	1962.10	제조/기술 담당임원	광운대 제조/기술 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	길병승	남	1963.06	대외협력총괄 담당임원	경찰대 기업문화 담당임원	-	26개월
전무 (상근)	미등기임원	김광욱	남	1962.08	재무/구매 담당임원	경북대 경영지원 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	김남석	남	1967.02	CEO 직속 담당임원	서울대 P&T 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	김상근	남	1962.01	제조/기술 담당임원	동아대 제조/기술 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	김형수	남	1965.02	SHE 담당	한국과학기술원 기업문화 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	박성계	남	1967.06	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	박정식	남	1963.12	품질보증 담당	홍익대 P&T 담당	-	
전무 (상근)	미등기임원	사택진	남	1961.11	재무/구매 담당임원	고려대 경영지원 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	송창복	남	1969.01	CEO 직속 담당임원	서울대 사업총괄 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	신승국	남	1962.11	대외협력총괄 담당임원	Vanderbilt University 경영지원 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	안근욱	남	1959.08	NAND개발사업총괄 담당임원	단국대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	안현	남	1967.06	미래기술&성장 담당임원	서울대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	오기영	남	1960.05	CEO 직속 담당임원	SOPHIA UNIVERSITY 사업총괄 담당임원	-	38개월
전무 (상근)	미등기임원	이상래	남	1965.07	GSM 담당임원	Boston University 경영지원 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	이재성	남	1966.09	NAND개발사업총괄 담당임원	연세대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	38개월
전무 (상근)	미등기임원	이재형	남	1965.09	GSM 담당임원	서강대 마케팅/영업 담당임원	-	25개월
전무 (상근)	미등기임원	임동규	남	1964.04	CEO직속 담당임원	서울대 사업총괄 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	임종혁	남	1964.08	윤리경영 담당	서울대 윤리경영 담당	-	16개월
전무 (상근)	미등기임원	전준현	남	1966.05	DRAM개발사업 담당임원	경북대 DRAM개발사업 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	AndrewChong	남	1965.09	NAND개발사업총괄 담당임원	UC Berkeley NAND개발사업총괄 담당임원	-	16개월
전무 (상근)	미등기임원	차선용	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	

전무 (상근)	미등기임원	최정달	남	1964.07	미래기술연구원 담당임원	경북대 미래기술연구원 담당임원	-	34개월
전무 (상근)	미등기임원	피승호	남	1966.04	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
전무 (상근)	미등기임원	노종원	남	1975.11	미래전략 담당	서울대 미래전략 담당	-	5개월
전무 (상근)	미등기임원	유만석	남	1966.05	기업문화 담당임원	Lancaster University 기업문화 담당임원	-	5개월
상무 (상근)	미등기임원	강상원	남	1968.10	P&T 담당임원	한양대 P&T 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	강선국	남	1969.02	GSM 담당임원	인하대 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	강유종	남	1970.12	미래기술&성장 담당임원	Vanderbilt University 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	강진수	남	1967.07	GSM 담당임원	한국과학기술원 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	권재순	남	1969.12	제조/기술 담당임원	서강대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김기현	남	1968.10	GSM 담당임원	University of Phoenix 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김대영	남	1962.09	기업문화 담당임원	부산대 기업문화 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김도근	남	1964.03	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원 NAND개발사업총괄 담당임원	-	25개월
상무 (상근)	미등기임원	김상덕	남	1968.02	미래기술연구원 담당임원	서울대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김석	남	1970.11	GSM 담당임원	연세대 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김선경	남	1969.04	재무/구매 담당임원	Purdue University West Lafayette 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김선순	남	1970.06	DRAM개발사업 담당임원	연세대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김성한	남	1968.12	재무/구매 담당임원	서울대 경영지원 담당임원	-	40개월
상무 (상근)	미등기임원	김영식	남	1967.12	제조/기술 담당임원	연세대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김영일	남	1965.10	현장경영 담당	Univ. of Denver 현장경영 담당	-	
상무 (상근)	미등기임원	김영희	남	1972.01	NAND개발사업총괄 담당임원	University of Texas – Austin NAND개발사업총괄 담당임원	-	12개월
상무 (상근)	미등기임원	김용주	남	1968.10	DRAM개발사업 담당임원	한양대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김점수	남	1972.01	미래기술연구원 담당임원	청주대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김정기	남	1964.01	대외협력총괄 담당임원	서강대 경영지원 담당임원	-	48개월
상무 (상근)	미등기임원	김정태	남	1969.07	GSM 담당임원	한국과학기술원 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김종환	남	1972.09	DRAM개발사업 담당임원	서울대 DRAM개발사업 담당임원	-	

상무 (상근)	미등기임원	김주선	남	1966.06	GSM 담당임원	성균관대 마케팅/영업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김춘환	남	1967.04	제조/기술 담당임원	서울대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김대찬	남	1963.06	CIS Business 담당임원	고려대 CIS Business 담당임원	-	43개월
상무 (상근)	미등기임원	김대훈	남	1963.02	제조/기술 담당임원	경북대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김대훈	남	1970.02	미래기술연구원 담당임원	연세대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김형환	남	1970.03	미래기술연구원 담당임원	서울대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	나한주	남	1963.05	NAND개발사업총괄 담당임원	서강대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	마금선	남	1968.11	대외협력총괄 담당임원	Indiana State University 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	문승훈	남	1969.08	제조/기술 담당임원	서울시립대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	문유진	남	1967.05	기업문화 담당임원	한양대 기업문화 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	1966.01	대외협력총괄 담당임원	New York University 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	1966.04	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박일	남	1971.01	DRAM개발사업 담당임원	Purdue University DRAM개발사업 담당임원	-	49개월
상무 (상근)	미등기임원	박찬진	남	1970.05	CEO 직속 담당임원	서울대 사업총괄 담당임원	-	20개월
상무 (상근)	미등기임원	박찬하	남	1969.01	미래기술연구원 담당임원	포항공대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박철규	남	1966.06	DRAM개발사업 담당임원	경북대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박현	남	1969.06	대외협력총괄 담당임원	중앙대 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	손석우	남	1968.01	제조/기술 담당임원	영남대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	신동원	남	1967.11	CIS Business 담당임원	고려대 CIS Business 담당임원	-	15개월
상무 (상근)	미등기임원	심대용	남	1969.06	DRAM개발사업 담당임원	서울대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	안명규	남	1968.10	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	남	1964.12	품질보증 담당임원	한국과학기술원 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	오재성	남	1967.10	P&T 담당임원	홍익대 P&T 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	오종진	남	1965.02	재무/구매 담당임원	경희대 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	원국	남	1966.12	GSM 담당임원	Univ. of Helsinki 마케팅/영업 담당임원	-	

상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	1964.06	기업문화 담당임원	한국과학기술원 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	윤석훈	남	1966.11	제조/기술 담당임원	충남대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이기정	남	1965.10	미래기술연구원 담당임원	아주대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이기화	남	1968.12	P&T 담당임원	충북대 P&T 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이두희	남	1967.07	기업문화 담당임원	연세대 기업문화 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이문환	남	1967.09	미래기술연구원 담당임원	University of Washington 미래기술연구원 담당임원	-	12개월
상무 (상근)	미등기임원	이민형	남	1968.10	제조/기술 담당임원	명지대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이병기	남	1972.02	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이상철	남	1965.02	CEO 직속 담당임원	아주대 사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	1963.12	미래기술연구원 담당임원	서울대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이성재	남	1969.07	DRAM개발사업 담당임원	연세대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	1964.06	미래기술연구원 담당임원	연세대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이창수	남	1967.02	품질보증 담당임원	Tohoku University 품질보증 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이한주	남	1965.11	CEO 직속 담당임원	성균관대 사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이호석	남	1969.09	NAND개발사업총괄 담당임원	성균관대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	1964.07	NAND개발사업총괄 담당임원	인하대 품질보증 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	1963.06	제조/기술 담당임원	울산대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	장승호	남	1970.11	NAND개발사업총괄 담당임원	서강대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	장혁준	남	1967.06	재무/구매 담당임원	Indiana University – Bloomington 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	1963.01	미래기술연구원 담당임원	연세대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	전영호	남	1961.04	NAND개발사업총괄 담당임원	광운대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	전용주	남	1962.10	NAND개발사업총괄 담당임원	전북대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	정상규	남	1967.12	NAND개발사업총괄 담당임원	연세대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	22개월
상무 (상근)	미등기임원	정성용	남	1972.12	미래기술연구원 담당임원	Ohio State University 미래기술연구원 담당임원	-	56개월
상무 (상근)	미등기임원	정의상	남	1965.03	제조/기술 담당임원	고려대 제조/기술 담당임원	-	

상무 (상근)	미등기임원	정진수	남	1970.10	품질보증 담당임원	충남대 품질보증 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	정진욱	남	1970.04	미래기술연구원 담당임원	경북대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	정철우	남	1965.04	미래전략 담당임원	성균관대 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	정대우	남	1965.05	미래기술연구원 담당임원	연세대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	조영만	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	한양대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	조주환	남	1968.01	DRAM개발사업 담당임원	광운대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	조호진	남	1968.11	DRAM개발사업 담당임원	서울대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	천영일	남	1966.10	미래기술연구원 담당임원	고려대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최광문	남	1968.01	기업문화 담당임원	연세대 기업문화 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	1962.09	DRAM개발사업 담당임원	연세대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	1966.04	미래전략 담당임원	Univ. of MichiganAnn Arbor 사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최용수	남	1969.02	품질보증 담당임원	인하대 품질보증 담당임원	-	17개월
상무 (상근)	미등기임원	최정산	남	1967.01	품질보증 담당임원	연세대 품질보증 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최준기	남	1968.02	제조/기술 담당임원	송실대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최준배	남	1969.01	CEO 직속 담당임원	Fairleigh Dickinson University 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	최홍석	남	1968.11	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	한영수	남	1969.11	NAND개발사업총괄 담당임원	아주대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	홍권	남	1965.11	재무/구매 담당임원	고려대 경영지원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	1963.02	P&T 담당	성균관대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	김달주	남	1970.12	미래전략 담당임원	연세대 미래전략 담당임원	-	5개월
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	1974.06	DRAM개발사업 담당임원	한국과학기술원 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	권기창	남	1969.11	NAND개발사업총괄 담당임원	강원대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	도창호	남	1970.01	DRAM개발사업 담당임원	경북대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박명수	남	1970.04	GSM 담당임원	고려대 GSM 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	박성환	남	1968.11	재무/구매 담당임원	연세대 재무/구매 담당임원	-	

상무 (상근)	미등기임원	박용근	남	1969.07	대외협력총괄 담당임원	University of Oxford 대외협력총괄 담당임원	-	52개월
상무 (상근)	미등기임원	박창현	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	연세대 미래기술연구원 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	송치화	남	1969.01	제조/기술 담당임원	충남대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	신정호	남	1968.10	제조/기술 담당임원	청주대 제조/기술 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	이상권	남	1974.12	DRAM개발사업 담당임원	고려대 DRAM개발사업 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	조민상	남	1968.09	P&T 담당임원	성균관대 P&T 담당임원	-	
상무 (상근)	미등기임원	정상록	남	1969.07	대외협력총괄 담당임원	연세대 대외협력총괄 담당임원	-	4개월
연구위원 (상근)	미등기임원	김성동	남	1967.03	미래기술연구원 담당임원	서울대 미래기술연구원 담당임원	-	37개월
연구위원 (상근)	미등기임원	김세연	남	1973.01	미래기술연구원 담당임원	University of illinois at Urbana champaign 미래기술연구원 담당임원	-	10개월
연구위원 (상근)	미등기임원	김창한	남	1971.04	미래기술연구원 담당임원	University of Wisconsin - Madison 미래기술연구원 담당임원	-	11개월
연구위원 (상근)	미등기임원	김태현	남	1970.03	CIS Business 담당임원	Georgia Institute of Technology CIS Business 담당임원	-	21개월
연구위원 (상근)	미등기임원	문용식	남	1970.11	미래기술연구원 담당임원	University of California - Berkeley 미래기술연구원 담당임원	-	11개월
연구위원 (상근)	미등기임원	박경	남	1968.07	NAND개발사업총괄 담당임원	고려대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	24개월
연구위원 (상근)	미등기임원	박종민	남	1968.08	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원 NAND개발사업총괄 담당임원	-	34개월
연구위원 (상근)	미등기임원	설광수	남	1970.01	제조/기술 담당임원	Waseda University 제조/기술 담당임원	-	18개월
연구위원 (상근)	미등기임원	양지철	남	1973.07	제조/기술 담당임원	성균관대 제조/기술 담당임원	-	18개월
연구위원 (상근)	미등기임원	오훈상	남	1969.07	CIS Business 담당임원	서울대 CIS Business 담당임원	-	19개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이동준	남	1964.03	제조/기술 담당임원	인하대 제조/기술 담당임원	-	23개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이병호	남	1970.05	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	31개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이승철	남	1968.12	미래기술연구원 담당임원	중앙대 미래기술연구원 담당임원	-	14개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이창렬	남	1967.02	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	임의철	남	1969.08	NAND개발사업총괄 담당임원	성균관대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	32개월
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	1966.01	NAND개발사업총괄 담당임원	연세대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	임창문	남	1966.06	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	

연구위원 (상근)	미등기임원	장경식	남	1967.07	DRAM개발사업 담당임원	포항공과대 DRAM개발사업 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	장세억	남	1966.03	미래기술연구원 담당임원	포항공과대 미래기술연구원 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	정성웅	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원 미래기술연구원 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	1966.05	NAND개발사업총괄 담당임원	포항공과대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	
연구위원 (상근)	미등기임원	진일섭	남	1971.05	미래기술연구원 담당임원	University of California - Los Angeles 미래기술연구원 담당임원	-	14개월
연구위원 (상근)	미등기임원	채동혁	남	1973.10	NAND개발사업총괄 담당임원	서울대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	39개월
연구위원 (상근)	미등기임원	현창석	남	1967.02	DRAM개발사업 담당임원	연세대 DRAM개발사업 담당임원	-	34개월
연구위원 (상근)	미등기임원	강옥성	남	1969.01	GSM 담당임원	University of Michigan GSM 담당임원	-	5개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이병찬	남	1965.03	미래기술연구원 담당임원	Rensselaer Polytechnic Institute 미래기술연구원 담당임원	-	5개월
연구위원 (상근)	미등기임원	임낙훈	남	1974.11	미래기술연구원 담당임원	Stanford University 미래기술연구원 담당임원	-	12개월
연구위원 (상근)	미등기임원	심재성	남	1974.06	미래기술연구원 담당임원	서울대 미래기술연구원 담당임원	-	27개월
연구위원 (상근)	미등기임원	정인철	남	1972.01	DRAM개발사업 담당임원	서울대 DRAM개발사업 담당임원	-	15개월
연구위원 (상근)	미등기임원	이영택	남	1964.02	NAND개발사업총괄 담당임원	서울대 NAND개발사업총괄 담당임원	-	12개월

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년도말 주주명부상 미등기 임원의 보유 주식수는 보통주-(의결권 있는 주식) 33,607주임. (최대원 회장 보유주식수는 '0주'임)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 회사에 5년 이상 계속하여 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략함.

(나) 미등기 임원의 변동

보고기간종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다

구분	직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	약력	담당업무	비고	최대주주와의 관계
퇴임	전무 (상근)	미등기임원	한우중	남	1959.01	메모리시스템 연구 담당임원	메모리시스템 연구 담당임원	-	-
신규선임	연구위원 (상근)	미등기임원	강대웅	남	1972.07	경력입사	NAND개발사업총괄 담당임원	경력입사	-
신규선임	연구위원 (상근)	미등기임원	강수춘	남	1966.04	경력입사	미래기술연구원 담당임원	경력입사	-

나. 직원의 현황

(가) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계				
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
반도체부문	남	17,473	-	48	-	17,521	9.7	1,086,087,584	64,201	-
반도체부문	여	10,190	-	57	2	10,247	11.5	453,653,126	45,306	-
합 계		27,663	-	105	2	27,768	10.3	1,539,740,710	57,176	-

※ '직원수'는 기준일 현재 본사 재직자(휴직자 포함) 기준이며, 사내이사/사외이사/기타비상무이사 등 제외, 미등기 임원은 포함한 수치임.

※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 1인평균급여액은 이행상황신고서상 인원의 분기 평균수를 기준으로 계산하였음.

(나) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	173	66,048	382	-

※ 동 표는 제출일 현재 기준 퇴임한 임원에 대한 자료도 포함함

다. 노동조합의 현황

(기준일: 2019년 03월 31일)

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,721명 / 청주 5,181명	-
가입인원	이천 7,579명 / 청주 5,147명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	Full-time 기준
소속된 연합단체	한국노총 금속노련	-
기타	-	-

2. 임원의 보수 등

가. 이사·감사 전체의 보수 현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	9	12,000	-

(2) 이사·감사 전체 지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	3,020	378	-

(3) 유형별 지급금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,915	972	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	63	21	-
감사위원회 위원	3	42	21	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2019.03.31 기준임.

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 기간 누적 총액 기준임.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 계산함.

나. 이사·감사의 개인별 보수현황

※ 자본시장법 개정으로 인해 임원등의 보수 기재 회수가 연 2회로 축소함에 따라, 분기보고서에는 관련 내용을 기재하지 않는 것으로 함.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	1	3,252	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
계	1	3,252	-

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			

박성욱	미등기임원	2017.03.24	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	99,600	-	-	99,600	2019.3.25~2022.3.24	48,400
박성욱	미등기임원	2017.03.24	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	99,600	-	-	99,600	2020.3.25~2023.3.24	52,280
박성욱	미등기임원	2017.03.24	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	99,600	-	-	99,600	2021.3.25~2024.3.24	56,460
정태성	미등기임원	2018.01.01	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	7,747	-	-	7,747	2020.1.1~2022.12.31	77,440
이석희	등기임원	2018.03.28	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	7,223	-	-	7,223	2020.3.29~2023.3.28	83,060
정태성	미등기임원	2019.02.28	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	8,171	-	-	8,171	2021.3.1~2024.2.29	73,430
이석희	등기임원	2019.03.22	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	61,487	-	-	61,487	2021.3.23~2024.3.22	71,560
이석희	등기임원	2019.03.22	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	61,487	-	-	61,487	2022.3.23~2025.3.22	77,290
이석희	등기임원	2019.03.22	자기주식교부 혹은 차액지급	보통주	61,487	-	-	61,487	2023.3.23~2026.3.22	83,470

※ 공시서류작성 기준일인 2019년 3월 31일 기준 증가는 74,200원임.

※ 박성욱 부회장은 2019년 3월 22일부로 에스케이하이닉스 사내이사직을 사임함.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

나. 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○
- 지정시기 : 1987년
- 규제내용 요약
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 등에 관한 공시
 - 비상장사의 중요사항 공시

다. 기업집단에 소속된 회사 (2019. 03. 31 기준 계열사 : 107개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (18)	AJ렌터카(주)	110111-0577233
	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK(주)	110111-0769583
	SK케미칼(주)	131111-0501021
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	(주)드림어스컴퍼니	110111-1637383
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	(주)에스엠코어	110111-0128680
비상장사 (89)	11번가(주)	110111-6861490

	SK E&S(주)	110111-1632979
	SKC에코솔루션즈(주)	154311-0026200
	SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
	SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
	SK건설(주)	110111-0038805
	SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
	SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
	SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
	SK매직서비스(주)	134811-0039752
	SK매직(주)	110111-5125962
	SK모바일에너지(주)	161511-0076070
	SK바이오사이언스(주)	131111-0523736
	SK바이오텍(주)	160111-0395453
	SK바이오팜(주)	110111-4570720
	SK브로드밴드(주)	110111-1466659
	SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
	SK스토아(주)	110111-6585884
	SK신택(주)	131411-0232597
	SK실트론(주)	175311-0001348
	SK어드밴스드(주)	230111-0227982
	SK에너지(주)	110111-4505967
	SK에어가스(주)	230111-0134111
	SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
	SK와이번스(주)	120111-0217366
	SK인천석유화학(주)	120111-0666464
	SK인포섹(주)	110111-2007858
	SK임업(주)	134811-0174045
	SK종합화학(주)	110111-4505975
	SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
	SK텔레시스(주)	110111-1405897
	SK텔링크(주)	110111-1533599
	SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
	SK트리켄(주)	164711-0060753
	SK티엔에스(주)	110111-5833250
	SK플라즈마(주)	131111-0401875
	SK플래닛(주)	110111-4699794
	SK핀크스(주)	224111-0003760
	SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
	SK하이스텍(주)	134411-0037746

	SK하이이엔지(주)	134411-0017540
	강원도시가스(주)	140111-0002010
	금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
	나래에너지서비스(주)	135711-0092181
	내트릭(주)	110111-3222570
	네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
	당진에코파워(주)	165011-0035072
	디앤디인베스트먼트(주)	110111-6618263
	라이프앤시큐리티홀딩스(주)	110111-5371408
	목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
	미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
	보령LNG터미널(주)	164511-0021527
	비엔엠개발(주)	110111-5848712
	서비스에이스(주)	110111-4368688
	서비스탑(주)	160111-0281090
	아이디퀀티크(유)	131114-0009566
	에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
	에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
	엔티스(주)	130111-0021658
	여주에너지서비스(주)	110111-6897817
	영남에너지서비스(주)	175311-0001570
	울산아로마텍스(주)	110111-4499954
	원스토어(주)	131111-0439131
	위례에너지서비스(주)	110111-4926006
	유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
	유빈스(주)	135111-0077367
	유빈스홀딩스(주)	110111-5316694
	이니츠(주)	230111-0212074
	전남도시가스(주)	201311-0000503
	전북에너지서비스(주)	214911-0004699
	제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
	(주)대한송유관공사	110111-0671522
	(주)DDISS280위탁관리부동산투자회사	110111-6896835
	(주)ADT시큐리티	110111-2385585
	(주)ADT캡스	110111-0072639
	(주)에이앤티에스	110111-3066861
	(주)제이에스아이	124611-0261880
	(주)캡스텍	110111-3141663
	충청에너지서비스(주)	150111-0006200

	코원에너지서비스(주)	110111-0235617
	파주에너지서비스(주)	110111-4629501
	피아이유엔(주)	134111-0383195
	피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
	한국빅슬렌(유)	230114-0003328
	행복나래(주)	110111-2016940
	행복디딤(주)	110111-6984325
	행복모아(주)	150111-0226204
	행복키움(주)	110111-6984672
	홈앤서비스(주)	110111-6420460

주1) '19.4.1일자로 디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사, 디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사 계열 편입주

2) 네트워크앤에스(주)는 '19.4.19일자로 SK오앤에스(주)로 사명 변경

(*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)), 나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비엔엠개발(주) (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)), SK에어가스(주) (舊 SKC에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주)), SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), SK디스커버리(주) (舊 SK케미칼(주)), SKC하이테크앤마케팅(주) (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스(주) (舊 카라이프서비스(주)), 라이프앤시큐리티홀딩스(주) (舊 사이렌홀딩스코리아(주)), SKC에코솔루션즈(주) (舊 SK더블유), (주)드림어스컴퍼니 (舊 (주)아이리버)

라. 계열회사간 출자현황

[2019년 3월 31일 기준]

(보통주 기준)

피투자회사 \\ 투자회사	SK이노베이션	대한송유관공사	SK모바일에너지	행복키움	SK에너지	네트릭	제주유나이티드FC	행복디딤	SK종합화학	울산아로마틱스
SK(주)	33.4%									
SK이노베이션		41.0%	100.0%	100.0%	100.0%				100.0%	
SK에너지						100.0%	100.0%	100.0%		
SK종합화학										50.0%
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										

SK머티리얼즈										
계열사 계	33.4%	41.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK루브리컨츠	유베이스매뉴팩처링아시아	SK인전석유화학	SK트레이딩인더내셔널	SK텔레콤	SK커뮤니케이션즈	SK와이브스	에프엔유신용정보	PS&마케팅	네트웍오앤에스
SK(주)					26.8%					
SK이노베이션	100.0%		100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠		70.0%								
SK텔레콤						100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	100.0%	70.0%	100.0%	100.0%	26.8%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	서비스에이스	서비스탑	드림어스컴퍼니	원스토어	나노엔텍	FSK L&S	SK텔링크	11번가	SK인포섹	SK브로드밴드
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%	100.0%	52.4%	65.5%	28.9%	60.0%	100.0%	98.1%	100.0%	100.0%
SK브로드밴드										
SK플래닛								1.9%		
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										

SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	100.0%	100.0%	52.4%	65.5%	28.9%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	홀앤서비스	SK스토아	SK플래닛	SK웬앤서비스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤			98.1%		20.1%					
SK브로드밴드	100.0%	100.0%								
SK플래닛				100.0%						
SK하이닉스						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신택										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	100.0%	100.0%	98.1%	100.0%	20.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK E&S	코원에너지서비스	부산도시가스	충청에너지서비스	영남에너지서비스	전남도시가스	전북에너지서비스	강원도시가스	파주에너지서비스	위례에너지서비스
SK(주)	90.0%									
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S		100.0%	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	95.2%
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										

SK신택										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	90.0%	100.0%	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	95.2%

피투자회사 \ 투자회사	나래에너지서비 스	여주에너지서비 스	보령LNG터미 널	SKC	SKC솔믹스	SKC에코솔루션 즈	SK바이오랜드	SKC하이테크엔마케 팅	SK텔레시스	SKC인프라서비 스
SK(주)				41.0%						
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S	100.0%	100.0%	50.0%							
SKC					57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%	
SK텔레시스										100.0%
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신택										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	100.0%	100.0%	50.0%	41.0%	57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	미쓰이케미칼앤드SKC폴리우레탄	SK네트웍스	SK네트웍스서비스	SK핀크스	SK렌터카서비스	목감휴게소서비스	AJ렌터카	SK매직	SK매직서비스
SK(주)		39.1%							
SK이노베이션									
SK에너지									
SK종합화학									
SK루브리컨츠									
SK텔레콤									
SK브로드밴드									
SK플래닛									
SK하이닉스									
SK E&S									
SKC	50.0%								
SK텔레시스									
SK네트웍스			86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	42.2%	100.0%	
SK매직									100.0%

SK건설									
SK디스커버리		0.02%							
SK신텍									
SK가스									
SK디앤디									
SK케미칼									
SK머티리얼즈									
계열사 계	50.0%	39.1%	86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	42.2%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK건설	SK티앤에스	SK플라즈마	SK신텍	SK가스	SK디앤디	비엔엠개발	디앤디인베스트먼트	DDISS280위탁관리부동산투자회사	SK어드밴스드
SK(주)	44.5%									
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설		100.0%								
SK디스커버리	28.2%		100.0%	100.0%	45.6%					
SK신텍					10.0%					
SK가스						29.3%				45.0%
SK디앤디							100.0%	100.0%	100.0%	
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
계열사 계	72.7%	100.0%	100.0%	100.0%	55.6%	29.3%	100.0%	100.0%	100.0%	45.0%

피투자회사 \ 투자회사	당진에코파워	SK케미칼	SK바이오사이언스	엔티스	이니츠	제이에스아이	SK바이오팜	SK바이오텍	SK임업	SK실트론
SK(주)							100.0%	100.0%	100.0%	51.0%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										

SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리		33.9%								
SK신타										
SK가스	51.0%									
SK디앤디										
SK케미칼			98.0%	50.0%	66.0%	56.0%				
SK머티리얼즈										
계열사 계	51.0%	33.9%	98.0%	50.0%	66.0%	56.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK머티리얼즈	SK에어가스	SK트리켄	SK쇼와덴코	에스엘코어	라이프앤시큐리티홀딩스	ADT캡스	캡스텍	ADT시큐리티	유빈스홀딩스	유빈스	피아이유엔
SK(주)	49.1%				26.6%							
SK이노베이션												
SK에너지												
SK종합화학												
SK루브리컨츠												
SK텔레콤						55.0%						
SK브로드밴드												
라이프앤시큐리티홀딩스							100.0%	100.0%	100.0%			
SK플래닛												
SK하이닉스												
SK E&S												
SKC												
SK텔레시스												
SK네트웍스												
SK매직												
SK건설												
SK디스커버리												
SK신타												
SK가스												
SK디앤디												
SK케미칼												
SK머티리얼즈		100.0%	65.0%	51.0%								
에이앤티에스										85.90%		
유빈스홀딩스											100.0%	
유빈스												100.0%
계열사 계	49.1%	100.0%	65.0%	51.0%	26.6%	55.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.9%	100.0%	100.0%

마. 해외계열사 현황

[2019년 3월 31일 기준]

No.	해외계열사명
1	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
2	SK USA, Inc.
3	SK E&P Company (구.SK Innovation Americas Inc.)
4	SK E&P America, Inc.

5	SK Plymouth, LLC
6	SK Permian, LLC
7	SK Battery Hungary Kft.
8	Blue Dragon Energy Co., Limited
9	SK E&P Operations America, LLC
10	SK Nemaha, LLC
11	SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD.
12	SK BATTERY AMERICA
13	SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O.
14	SK BATTERY MANUFACTURING KFT
15	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
16	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
17	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
18	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
19	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
20	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
21	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
22	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
23	Netruck Franz Co., Ltd.
24	Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
25	TAN CANG – SK ENERGY COMPANY Ltd.
26	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
27	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
28	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
29	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
30	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
31	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
32	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
33	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
34	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
35	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
36	SK Primacor Europe, S.L.U
37	SK Primacor Americas LLC
38	SK Saran Americas LLC
39	SK Global Chemical China Ltd.
40	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
41	SK GC Americas, Inc.
42	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
43	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.

44	SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.
45	SK China Company, Ltd.
46	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
47	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
48	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
49	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
50	SK C&C Beijing Co., Ltd.
51	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
52	SKY Property Mgmt. Ltd.
53	SK C&C India Pvt., Ltd.
54	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
55	SK China Real Estate Co., Limited
56	SK Industrial Development China Co., Ltd.
57	SK GI Management
58	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
59	Gemini Partners Pte. Ltd
60	SKY Investment Co., Ltd
61	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
62	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
63	Sky Yunjian Investment Management Limited
64	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
65	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
66	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
67	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
68	SK C&C Chengdu Co., Ltd.
69	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
70	Solaris GEIF Investment
71	Prostar Capital Ltd.
72	Prostar Capital Management Ltd.
73	S&G Technology
74	Dogus SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.
75	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
76	CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.
77	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
78	SK Property Investment Management Company Limited
79	ESSENCORE Limited
80	SK China Investment Management Company Limited
81	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
82	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.

83	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
84	Hermed Capital
85	Hermed Capital Health Care GP Ltd
86	SK BeiJing Investment Management Limited
87	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
88	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
89	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
90	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
91	Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
92	CFC-SK EI Dorado Latam Fund, L.P.
93	Prostar APEIF GP Ltd.
94	CFC-SK Covipaci Colombia SAS
95	CFC-SK Malta Covipacifico Ltd.
96	CFC-SK Spain Covipacifico S.L.
97	Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd
98	CFC-SK Capital S.A.S.
99	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
100	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
101	SK Financial Leasing Co, Ltd.
102	SK Investment Management Co., Limited.
103	Prostar APEIF Management Ltd.
104	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
105	SK computer and communication L.L.C.
106	Hermeda Industrial Co. Ltd
107	Plutus Capital NY, Inc.
108	Hudson Energy NY, LLC
109	EM Holdings (Cayman) L.P.
110	EM Holdings (US) LLC
111	Plutus Fashion NY, Inc
112	Wonderland NY, LLC
113	SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
114	Hudson Energy NY II, LLC
115	Alchemy Acquisition Corp.
116	Abrasax Investment Inc.
117	Fine Chemicals Holdings Corp.
118	AMPAC Fine Chemicals, LLC
119	AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
120	AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
121	Solaris Partners Pte. Ltd

122	Atlas NY, LLC
123	SK Semiconductor Investments Co., Ltd
124	SL Capital Partners Limited
125	SLSF I GP Limited
126	SL Capital Management Limited
127	SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
128	SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
129	SK Siltron America, Inc.
130	SK Siltron Japan, Inc.
131	SK Materials Japan Co., Ltd.
132	SK Materials Taiwan Co., Ltd
133	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd
134	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
135	SK Biotek Ireland Limited
136	SK Biotek USA, Inc.
137	SK Life Science, Inc.
138	SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. (SK 생물의약품(상해) 유한공사)
139	SMC US, INC
140	PHILKO UBINS LTD. CORP.
141	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
142	PT. Patra SK
143	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
144	SK Lubricants Europe B.V.
145	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd
146	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
147	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
148	SK Lubricants Americas, Inc.
149	SK Energy International Pte, Ltd.
150	SK Energy Europe, Ltd.
151	SK Energy Americas Inc.
152	SK Terminal B.V.
153	Atlas Investment Ltd.
154	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
155	SK Healthcare Co.,Ltd.
156	SK Healthcare China Holding Co.
157	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
158	SK telecom Japan Inc.
159	AI ALLIANCE, LLC
160	ID Quantique S.A.

161	Axess II Holdings
162	CYWORLD China Holdings
163	Global Opportunities Breakaway Fund
164	Global opportunities Fund, L.P
165	Immersive Capital, L.P.
166	Magic Tech Network Co., Ltd.
167	SK Latin America Investment S.A.
168	SK MENA Investment B.V.
169	SK Technology Innovation Company
170	SK Telecom Americas, Inc.
171	SK Telecom China Fund 1 L.P.
172	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
173	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
174	SK Telecom Venture Capital, LLC
175	SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
176	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
177	SKTA Innopartners, LLC
178	ULand Company Limited
179	Westly Capital Partners Fund II
180	YTK Investment Ltd.
181	SK Planet Inc.
182	SKP America LLC
183	SK Planet Japan K.K.
184	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
185	shopkick GmbH
186	shopkick management co.
187	shopkick Inc.
188	Celcom Planet Sdn Bhd
189	Dogus Planet Inc.
190	SK Telink Vietnam Co., Ltd.
191	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
192	CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
193	Iriver Enterprise Ltd.
194	Iriver Inc.
195	Groovers Japan Co.,Ltd
196	Iriver China Co., Ltd.
197	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd
198	LIFE DESIGN COMPANY Inc.
199	NanoenTek America Inc.

200	NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
201	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
202	SK Telecom TMT Investment Corp.
203	ID Quantique Ltd
204	SK BRASIL LTDA
205	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
206	SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
207	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
208	Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
209	SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
210	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
211	SK NETWORKS AMERICA, Inc.
212	SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
213	Networks Tejarat Pars
214	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
215	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
216	P.T. SK Networks Indonesia
217	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
218	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
219	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
220	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
221	SK Networks Deutschland GmbH
222	SK Networks HongKong Ltd.
223	SK Networks Japan Co., Ltd.
224	SK Networks Middle East FZE
225	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
226	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
227	SK Networks Resources Pty Ltd.
228	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
229	SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
230	Springvale SK Kores Pty Ltd.
231	SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD
232	SK Magic Vietnam company limited
233	SK hynix America Inc. (SKHYA)
234	SK hynix Deutschland GmbH (SKHYD)
235	SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS)
236	SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. (SKHYH)
237	SK hynix Japan Inc. (SKHYJ)
238	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT)

239	SK hynix Semiconductor(China) Ltd. (SKHYCL)
240	SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. (SKHYCS)
241	SK hynix Semiconductor India Private Ltd. (SKHYIS)
242	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
243	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. (SKHYCW)
244	SK hynix Italy S.r.l (SKHYIT)
245	SK hynix memory solutions America Inc. (SKHMS America)
246	SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. (SKHMS Taiwan)
247	SK APTECH Ltd. (SKAPTECH)
248	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL)
249	SK hynix U.K. Ltd. (SKHYU)
250	SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. (SKHMS Eastern Europe)
251	SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures)
252	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
253	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
254	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd
255	SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
256	SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd.
257	SK INVESTMENT VINA I Pte., Ltd.
258	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
259	SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd
260	SKYHIGH MEMORY LIMITED
261	SKC Europe GmbH
262	SKC, Inc.
263	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
264	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
265	SKC PU Specialty Co., Ltd.
266	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
267	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
268	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
269	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
270	SKC PVB Film Co., Limited
271	ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.
272	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co
273	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co
274	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
275	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
276	MCNS Polyurethanes USA Inc.
277	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

278	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
279	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
280	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
281	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
282	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
283	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
284	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
285	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
286	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O
287	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
288	SK Telesys Corp.
289	TechDream Co. Limited
290	BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
291	SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD
292	SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
293	SOLMICS TAIWAN CO.,LTD.
294	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
295	Prism Energy International Pte., Ltd.
296	SK E&S Australia Pty Ltd.
297	SK E&S Americas, Inc.
298	SK E&S LNG, LLC
299	PT SK E&S Nusantara
300	DewBlaine Energy, LLC
301	CAILIP Gas Marketing, LLC
302	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
303	Fajar Energy International Pte., Ltd
304	SK E&S Dominicana S.R.L.
305	Prism Energy International Hong Kong Limited
306	SKEC(Thai) Limited
307	SK E&C BETEK Corp.
308	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
309	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
310	SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
311	SK E&C India Private Ltd.
312	BT RE Investments, LLC
313	Mesa Verde RE Ventures, LLC
314	SK E&C Saudi Company Limited
315	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
316	SKEC Anadolu LLC

317	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
318	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
319	Hi Vico Construction Company Limited
320	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
321	Sunlake Co., Ltd.
322	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
323	SK Holdco Pte. Ltd
324	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
325	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. (SK화공(청도))
326	SK Chemicals America
327	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd (SK화공(소주))
328	SK Chemicals GmbH
329	ST Green Energy Pte,Ltd
330	PT Sinar Timuran Green Energi
331	SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. (SK화공(상해))
332	SK Gas International Pte. Ltd.
333	SK Gas USA Inc.
334	SK Gas Trading LLC

바. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이스텍, SK하이닉스시스템아이씨, 행복모아, 행복나래]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획실에서는 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획실은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급 계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[계열회사: SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매 행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다.

사. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2019년 3월 31일)

겸직임원		겸직회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	
이 석 희	대표이사	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	대표이사	-

		SK hynix memory solutions America Inc.	이사	—
		SK China Company Ltd.	이사	—
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이사	—
박 정 호	기타비상무이사	SK텔레콤	대표이사	—
		SK브로드밴드	대표이사	—
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이사	—

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득 일자	출자목적 일자	최초취득 금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근 사업년도 재무현황	
				수량	지분율	장부가액	취득(처분 등)		평가 손익	수량	지분율	장부가액	(2018년말)	
							수량	금액					총자산	당기 순손익
에스케이하이메이주 주식회사	01.07.05	경영참가	7,399	500,689	100.00	7,521				500,689	100.00	7,521	94,515	16,874
에스케이하이시스템 주식회사	08.03.15	경영참가	5,840	277,203	100.00	6,760				277,203	100.00	6,760	75,953	7,931
행복모아 주식회사	16.10.12	경영참가	7,400	1,480,000	100.00	7,400				1,480,000	100.00	7,400	15,428	444
행복나래	18.12.28	경영참가	63,147	1,600,000	100.00	63,147				1,600,000	100.00	63,147	185,177	12,117
에스케이하이닉스시스템이씨	17.5.11	경영참가	343,295	24,823,982	100.00	404,928				24,823,982	100.00	404,928	550,323	60,649
SK hynix Semiconductor America Inc.(SKHYA)	83.03.15	경영참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31				6,285,587	97.74	31	3,013,637	30,800
SK hynix Semiconductor Deutschland GmbH(SKHYD)	89.03.01	경영참가	80,956	출자증서	100.00	22,011				출자증서	100.00	22,011	99,641	1,380
SK hynix UK Ltd.(SKHYU)	13.11.05	경영참가	1,775	186,240,200	100.00	1,775				186,240,200	100.00	1,775	536,208	1,005
SK hynix Semiconductor Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	91.09.12	경영참가	137,532	196,303,500	100.00	52,380				196,303,500	100.00	52,380	933,268	3,999
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SKHYH)	95.04.27	경영참가	223,233	170,693,661	100.00	32,623				170,693,661	100.00	32,623	347,109	11,486
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	06.06.29	경영참가	6,357	출자증서	100.00	4,938				출자증서	100.00	4,938	1,199,602	49,634
SK hynix Semiconductor Japan Inc.(SKHYJ)	96.09.16	경영참가	81,587	20,000	100.00	42,905				20,000	100.00	42,905	837,362	(410)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	96.09.16	경영참가	13,330	35,725,000	100.00	37,562				35,725,000	100.00	37,562	449,054	2,475
SK hynix Semiconductor Indian Subcontinent Private Ltd.(SKHYIS)	07.03.29	경영참가	5	270	1.00	5				270	1.00	5	1,042	163
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	05.06.30	경영참가	1,966,060	출자증서	100.00	3,533,222		335,400		출자증서	100.00	3,868,622	6,390,490	84,089
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	09.11.17	경영참가	90,150	출자증서	45.00	92,608				출자증서	45.00	92,608	587,539	27,438
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	10.07.29	경영참가	237	출자증서	100.00	237				출자증서	100.00	237	535,819	43,163
SK hynix Italy(SKHYIT)	12.05.11	경영참가	18	출자증서	100.00	18				출자증서	100.00	18	4,421	451
SK Hynix Memory Solutions Inc.(SKHMS)	12.08.20	경영참가	311,284	128	100.00	311,284				128	100.00	311,284	115,956	6,849
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan(SKHMS T)	13.08.29	경영참가	7,819	출자증서	100.00	7,819				출자증서	100.00	7,819	9,304	468
SK APtech	13.09.02	경영참가	262,500	347,000,000	100.00	373,300	60,000,000	67,470		407,000,000	100.00	440,770	368,505	(4,520)
SKHMS Eastern Europe(softeq)	14.06.03	경영참가	14,579	출자증서	99.93	14,579				출자증서	99.93	14,579	8,194	1,036
STRATIO, INC.	15.02.02	투자	2,194	1,136,013	9.12	2,194				1,136,013	9.12	2,194	1,020	(330)
SK SE ASIA INVESTMENT PTE. LTD	18.08.30	경영참가	110,880	출자증서	20.00	110,880		113,470		출자증서	20.00	224,350	559,050	
SK CHINA	17.08.18	경영참가	257,169	4,754,868	11.87	257,169				4,754,868	11.87	257,169	1,795,060	20,176
Keyssa, Inc.	16.02.25	투자	6,174	1,521,838	2.26	838				1,521,838	2.12	838	20,776	(13,687)
Exnodes, Inc.	16.03.17	투자	716	전환사채	전환사채	716				전환사채	0	716	2	(375)
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	16.03.09	투자	2,512	54,500,000	100.00	60,613				54,500,000	100.00	60,613	61,181	65
MEMS DRIVE, INC.	16.10.20	투자	2,246	188,451	2.86	919				188,451	3.09	919	2,193	(4,781)
RENO SUB-SYSTEM, INC	17.09.01	투자	2,246	1,190,476	2.68	226				1,190,476	2.68	226	6,283	(6,477)
특정증권선박(ProMOS)	08.11.17	투자	21,847	396,311	0.88	0				396,311	0.88	0		
TidalScale, Inc.	18.09.21	투자	3,360	3,247,561	4.26	3,360				3,247,561	4.00	3,360	15,227	(7,053)
GigaIO Networks, Inc.	18.08.03	투자	1,678	850,629	6.00	1,678				850,629	5.85	1,678	3,801	(4,369)
Aeye, Inc.	18.12.13	투자	2,819	403,727	1.50	2,819				403,727	1.30	2,819		
인텔렉추얼디스커버리	11.05.13	투자	4,000	160,000	7.05	1,376				160,000	7.05	1,376	33,923	783
TMC SPC1 LP투자	18.05.30	투자	2,637,097	출자증서	74.72	2,721,554		27,075	40,730	출자증서	74.72	2,789,359	4,015,519	243,012
TMC SPC2 CB투자	18.05.30	투자	1,278,893	전환사채	전환사채	1,461,451			21,723	전환사채	-	1,483,174	1,394,843	(839)
합 계			9,301,888			9,642,844		543,415	62,453			10,248,712		

* 최근 사업년도 재무현황은 2018년말 실적이며 특정증권선박은 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

※ '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 표기하지 않음

※ 당사는 2018년말 기준 투자지분에 대한 공정가치 평가를 진행하였으며, 이와 관련하여 상기 Keyssa. Inc., MEMS DRIVE, Inc., RENO SUB-SYSTEM, INC., 인텔렉추얼디스커버리, BCPE Pangea Intermediate

Holdings Cayman, L.P., BCPE Pangea Cayman2 Limited 투자 지분에 대한 장부가액 평가손익 및 손실을 반영

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

－ 해당 사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비고	처분손익
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2019년 1월	매각일자	3,017	매각	생산 효율화 목적	(33)
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) L	해외법인	2019년 1월	매각일자	17	매각	생산 효율화 목적	17
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2019년 2월	매각일자	4,520	매각	생산 효율화 목적	(494)
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) L	해외법인	2019년 2월	매각일자	3,175	매각	생산 효율화 목적	(4,780)
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2019년 3월	매각일자	8,575	매각	생산 효율화 목적	(2,136)
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) L	해외법인	2019년 3월	매각일자	2,472	매각	생산 효율화 목적	(3,081)
HITECH SEMICONDUCTOR(WUXI) CO., LTD	해외법인	2019년 3월	매각일자	113	매각	생산 효율화 목적	(284)
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2019년 2월	매입일자	669	매입	생산 효율화 목적	674

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 처분손익은 분기말 환율 적용(19년 1분기 : 168.74)

※ 법인간 매매금액 산정 기준

- FMV : 구매실에서 중고장비거래 업체(서플러스글로벌, 맥쿼리 등)에 시장가 문의
- 부대비용 + 운송비 + 보험료 : 구매, 물류팀 산정

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(단위 : 백만원)

계약 상대방	관계	거래일자	출자 및 출자지분 처분 내역					비고
			출자지분의 종류	거래내역				
				기초	증가	감소	기말	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	해외계열사	2019.01.08	출자증서	3,533,222	335,400	-	3,868,622	유상증자로 인한 증가
SK APtech	해외계열사	2019.02.12	보통주식	373,300	67,470	-	440,770	유상증자로 인한 증가
SK SE ASIA INVESTMENT PTE. LTD	해외계열사	2019.03.28	보통주식	110,880	113,470	-	224,350	유상증자로 인한 증가

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고 내용 / 신고사항의 진행사항
2015.08.25	장래사업 경영계획 (공정공시)	2014년 이후 10년간 금일 준공하는 이천 M14를 포함하여 신규 공장 세 개 건설함. 이천 M14 건설 및 장비투자에 총 15조원 투자할 계획임. 향후 이천/청주에 각각 1개씩 신규공장건설 및 장비투자에 추가로 31조원 투자할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정임.
2016.12.22	신규 시설투자 등 (자율공시)	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 공정 전환을 위해 지속적인 공간 확보 필요성이 대두되어, 우시FAB의 중장기 경쟁력 유지를 위한 클린룸 확장 투자를 2017년 7월부터 2019년 4월까지 약 9,500억 원을 집행. 2019년 4월 확장팩(C2F)을 준공하였음
2018.07.27	신규 시설투자 등	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 회사의 중장기 경쟁력 강화를 위해 2018년 12월부터 2020년 10월까지 이천에 신규 클린룸 건설을 위해 약 3.5조원을 투자할 계획임.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 71기 정기주주총회 (2019.03.22)	제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건(후보:오종훈)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:하영구)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인	
제 70기 정기주주총회 (2018.03.28)	제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보:박성욱)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:송호근)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:조현재)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	

	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인	
제 69기 정기주주총회 (2017.03.24)	제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건(후보:이석희)	원안대로 승인	
	기타비상무이사 선임의 건(후보:박정호)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
제 68기 정기주주총회 (2016.03.18)	제68기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건 (후보: 김준호)	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건 (후보: 박정호)	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	
제 67기 정기주주총회 (2015.03.20)	제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

(1) Netlist, Inc.("Netlist") 특허권 침해 소송

Netlist, Inc.는 당사와 SK hynix America Inc. 등 당사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 당사 및 당사의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여

중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본 결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다. Netlist, Inc.는 중국 특허심판원의 소송 특허 무효 결정에 대한 항소를 포기하여, 동 결정은 최종적으로 확정되었습니다.

2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 1월 31일 지배기업이 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2019년 3월 5일에 항소를 제기하였습니다.

(2) 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 당기말 현재 당사는 제기된 본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당기말 현재 당사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(4) 소송 및 특허 클레임 등

당기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만원)			
구 분	단 위	금 액	비 고
종업원	KRW	4	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)	USD	60	물품공급계약에 대한 지급보증

(*)연결실체는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금 1,000백만원을 담보로제공 받았습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

제재조치일		조치기관	조치대상자	조치내용		사유 및 근거 법령		조치에 대한 이행현황	제발방지를 위한대책
연도	날짜			내용	금액(만원)	사유	근거법령		

2016	3/30	고용노동부	사업주	과태료	320	관리책임자 업무수행(위험성평가) 총괄관리 미실시	산안법 제13조	안전보건관리책임자 직무 (정기위험성평가 보고/결재) 자료 제출	위험성평가 결재/보고 실시
	7/6	고용노동부	사업주	과태료	16	15년도 관리감독자 4명 교육 미실시	산안법 제31조 제1항	관리감독자 교육 미이수자 대상 교육 이수 완료	교육 미이수자 대상 교육 재실시
	9/19	고용노동부	사업주	과태료	400	PSM 이행상태 점검 (공정안전보고서 내용 미이행 7건)	산안법 제49조의 2 제7항	미이행 7개 항목 개선완료 후 자료 제출	PSM 자체감사 강화
	11/15	고용노동부	사업주	과태료	800	M14 Phase2 공사 발주 시 안전관리비 미계상	산안법 제30조의 제1항	발주서에 안전관리비 포함 및 과태료 납부	발주서에 안전관리비 포함
2017	3/8	수원지방법원	사업주	벌금	500	산업안전보건법 위반	산안법 제29조	벌금 납부	법령에 따른 안전관리 강화
	6/13	총대산업사고 예방센터 (충청권)	사업주	과태료	96	공정안전보고서 내용 (규칙/지침)이행 불일치	산안법 제49조	시정지시 조치결과서 제출 및 과태료 납부	법규/지침 이행여부 관리 강화
	11/13	충청북도청	사업주	과태료	80	대기배출원정보 입력 미실시 ('13.1.17 방지 시설 운영정보)	대기환경보전법 제31조 제2항	과태료 납부	대기배출원정보 입력/검증 강화
2019	3/12	고용노동부 경기지청	사업주	과태료	16	도급업체 SK건설에 대해 안전보건 관리계획서 작성을 지침대로 미 이 행	산안법 제49조의2 제 7항 및 8항 위반	당사 사규 [협력업체 SHE관 리 규칙]에 맞게 작성 및 경 토	적용범위 및 절차 구체화 추진

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

4. 녹색경영 현황

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 이에 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2018년 온실가스 배출량은 최종 3,719,595톤 CO2 eq.입니다.

5. 합병 등의 사후 정보

가. 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병

(1) 거래내역 : 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(2) 합병 비율 : 에스케이하이닉스시스템아이씨 주식회사 : (주)실리콘화일 = 1.00000000 : 0.00000000

- 신주발행 및 합병교부금 지급이 없으므로 합병비율을 1.00000000 : 0.00000000 으로 산출

(3) 목적 : 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(4) 진행 내역 :

- 합병기일 : 2018년 3월 1일

(5) 재무내용

- 2017 사업연도

[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)]

(단위 : 백만원)

자산총계	360,254	자본금	100,000
부채총계	77,958	매출액	231,537
자본총계	282,296	당기순이익	-7,716

[(주)실리콘화일]

(단위 : 백만원)

자산총계	34,438	자본금	4,222
부채총계	1,243	매출액	982
자본총계	33,195	당기순이익	1,710

-2018 사업연도

[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)]

(단위 : 백만원)

자산총계	550,323	자본금	124,119
부채총계	92,989	매출액	554,264
자본총계	457,334	당기순이익	60,649

※ 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)와 (주)실리콘화일은 에스케이하이닉스 주식회사의 100% 출자 자회사임.

상세한 내용은 2018년 1월 12일에 공시된 회사합병결정에 대한 공시를 참고하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음